

盛群半導體股份有限公司

一〇三年度年報

刊印日期：中華民國一〇四年四月三十日

臺灣證券交易所公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

本公司揭露年報相關資料之網址：<http://www.holtek.com.tw>

一、發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

姓 名：李佩縈

職 稱：資源管理中心副總經理

聯絡電話：(03)563-1999

電子郵件信箱：pattyli@holtek.com.tw

二、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

姓 名：蔡榮宗

職 稱：業務行銷中心協理

聯絡電話：(03)563-1999

電子郵件信箱：armstro@holtek.com.tw

三、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司地址：新竹科學園區研新二路 3 號

電 話：(03)563-1999

分公司地址：香港九龍長沙灣道 777-779 號天安工業大廈三字樓 A 座

Block A, 3/F Tin On Industrial Building

777-779 Cheung Sha Wan Rd.

Kowloon, Hong Kong

電 話：852-2745-8288

台北營業處：台北市南港區園區街 3 之 2 號 4 樓之 2

電 話：(02)2655-7070

大陸營業處：合泰半導體(中國)有限公司

中國東莞市松山湖新竹路 4 號新竹苑 10 幢(總部壹號 10 號樓)

電 話：86-769-2626-1300

四、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名 稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

地 址：台北市博愛路 17 號 3 樓

網 址：www.sinotrade.com.tw

電 話：(02)2381-6288

五、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：魏興海會計師、曾漢鈺會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地 址：台北市信義路五段 7 號 68 樓（台北 101 大樓）

網 址：www.kpmg.com.tw

電 話：(02)8101-6666

六、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式
無

七、公司網址

www.holtek.com.tw

盛群半導體股份有限公司

一〇三年度年報

目 錄

壹、致股東報告書-----	1
貳、公司簡介	
一、設立日期-----	3
二、公司沿革-----	3
參、公司治理報告	
一、組織系統-----	5
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構 主管資料-----	8
三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金-----	12
四、公司治理運作情形-----	20
五、會計師公費資訊-----	51
六、更換會計師資訊-----	51
七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近 一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之情形 -----	51
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股 比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形-----	52
九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親 等以內之親屬關係之資訊-----	53
十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之 事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例-----	54
肆、募資情形	
一、資本及股份-----	56
二、公司債-----	61
三、特別股-----	61
四、海外存託憑證-----	61
五、員工認股權憑證-----	61
六、限制員工權利新股-----	61
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形-----	61
八、資金運用計畫執行情形-----	61

伍、營運概況

一、業務內容-----	62
二、市場及產銷概況-----	77
三、從業員工-----	87
四、環保支出資訊-----	87
五、勞資關係-----	87
六、重要契約-----	89

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表-----	91
二、最近五年度財務分析-----	99
三、最近年度財務報告之監察人審查報告-----	104
四、最近年度財務報告-----	104
五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告-----	104
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響-----	104

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況-----	188
二、財務績效-----	189
三、現金流量-----	190
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響-----	190
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫-----	191
六、風險事項分析-----	191
七、其他重要事項-----	192

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料-----	193
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形-----	200
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形-----	200
四、其他必要補充說明事項-----	200
五、依證券交易法第 36 條第三項第二款規定應揭露事項-----	200

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

回顧 2014 年，全球各地區的經濟發展有起有落，與臺灣最有關連性的國家中不外是亞洲的中國、日本與韓國以及北美地區的美國，整體的經濟發展大致符合該國的目標，由於手機市場近年的蓬勃發展及電腦產業穩定帶動下，做為產業稻米的半導體自然也維持穩定的增長，加上新興 IoT 物聯網應用從 2014 年起萌芽發展並開始產生極大的產業變化，勢必將會推升半導體 IC 發展。隨著各種應用不斷推陳出新對 IC 晶片的需求逐步攀升，但競爭廠商前仆後繼也在不斷增加中，尤其地處全球製造中心的中國大陸市場，為強奪市場佔有率，歐美晶片大廠已經放下身段卯力競逐，大陸本土崛起的晶片廠商亦爭先恐後加入競爭行列，將使整個半導體 IC 產業競爭越來越激烈。

民國一〇三年度（2014 年）對盛群半導體（以下簡稱本公司）美中不足的是未能達成原先設定的營收成長目標，但在營收、獲利、每股盈餘等各項指標均能維持小幅成長，且在稅後淨利及每股盈餘都創下四年來新高，對經營團隊努力成果仍是值得肯定的一年。

以下就本公司整體營運概況，分別從產品開發狀況、市場經營與生產管理方面做摘要說明。

2014 年本公司合併營收為新台幣（以下同）39.3 億元，較 2013 年 38.9 億元成長 0.93%，合併稅後淨利 7.91 億元增加 6.3%，毛利率則由 46% 提升至 48%，每股稅後盈餘 3.5 元較上年度增加 5.4%，整體營運表現在 IC 設計行業中屬於平均水準以上；從產品銷售比重分析，微控制器 MCU IC 產品（含標準型及特殊應用型）已達到營收 70% 的最佳比重，2014 年 MCU IC 出貨量超過 4.6 億顆，年增率達 8.3%；顯示驅動與電源管理等其他週邊 IC 則佔整體營收 30%；另從產品應用領域分類，家電產品應用佔整體 MCU 營收 42%，其次為工業控制產品 12%，健康醫療產品 10%，電腦週邊產品應用 10%，e-Banking 7%，安全監控 6%，車用電子產品 2%，儀表應用 2%，以及其他領域產品應用 9%（包括教育玩具、通訊等應用）。2014 年 MCU 仍以家電產品應用比重為大宗，增加最多的部份則來自 e-Banking、安全監控及電競鍵盤/滑鼠應用，顯示家庭生活及安全應用、金融與休閒健康照護符合未來生活所需。

在產品開發方面，2014 年度本公司推出一系列的標準型（包括 ARM 32 位元 MCU、1.8V Flash MCU、高精準 24 位元 A/D MCU 等）及多款特殊應用 MCU（如觸控 MCU、充電管理 MCU、緊急照明 MCU、體脂秤 MCU、無線充電 MCU 等），並針對部份大陸及海外重點客戶開發專屬應用 MCU；除 MCU 外，也開發了多項電源管理相關 IC（AC-DC PWM 穩壓 IC、LED 照明驅動 IC 等），還有一項很重要的應用產品—光學指紋辨識模組的開發計劃，因應市場需要研發團隊直接進行 1.0 mm Hybrid 光學指紋感測器開發；以上各項產品的順利推出將是本公司未來營運成長的重要動能。

在市場業務經營方面，由於 2014 年中國大陸經濟成長趨緩與抑制房產市場，造成大陸華南地區以家電產業為主的營運受到影響下調，致未能達成本公司預期營收目標；除此之外，華東/華北/福建及四川等地區營收均能維持穩定的增長；本公司仍將加強北京、杭州、中山順德等地區的銷售與技術服務據點，增加在地資深業務及技術

幹部配置，對代理商與客戶提供直接有效率的全功能服務。

生產管理方面，2014 年晶圓代工產能持續吃緊，對本公司亦面臨很大的挑戰，本公司生產外包政策一向採取與上下游晶圓代工/封裝/測試等廠商長期合作的理念，所幸能讓產能不足的衝擊降至最低，大致上都能滿足客戶對產能與交期的需求，在成本控制針對各階委工項目及量產成本的持續降低也發揮極大的效益，使本公司的產品競爭力與獲利均能有突出的表現。

展望 2015 年營運

2015 年全球經濟預測穩定成長，國際油價下跌預期將促進經濟與消費增長，美國市場景氣持續看好，亞太區新興經濟體印尼與印度亦將會有較好的表現，但日本與歐盟量化寬鬆政策將引起貨幣貶值通縮的不利因素，因此本公司仍謹慎保守看待 2015 年，經營團隊需從新產品企劃開發、產品市場、客戶經營管理及上下游合作等面向更主動更積極進行各環節工作，2015 年產品開發重點將會在以下幾項：

1. 標準 MCU：內建高資源、高精準數位類比轉換/觸控 SoC MCU。
2. ASSP MCU：第二代移動電源 MCU/快充 Quick Charger 2.0/無線充電 MCU/鋰電充電管理 MCU/無刷直流馬達 BLDC MCU/健康醫療量測 MCU/LED 燈飾控制 MCU。
3. RF SoC MCU。
4. ARM 32 位元 MCU 系列完整性。
5. 電源管理/電源轉換 IC。
6. 指紋辨識模組。

在業務方面除更深入耕耘中國大陸地區外，並將著重在日/韓及新興地區東南亞/印度等市場的經營管理；2015 年上下游晶圓代工與封裝測試需求旺盛產能預期持續吃緊，本公司生產管理單位已積極擬定產能調配方案，因應來自業務單位及客戶的各種需求。

總之，2015 年半導體市場競爭依然激烈，新興物聯網 IoT 產業中個人穿戴與居家安全管理應用將不斷推升半導體 IC 的需求，對本公司以 MCU 為發展主軸仍是處在有利的市場利基點上；因此，本公司經營團隊將持續投入更多的人力與資金，除提升內部研發能力外，並積極從國外 IP 公司引進關鍵技術以迅速開發更多符合市場需求的產品，才能順利達成 2015 年所設定營收與獲利成長目標，讓所有長期支持本公司的股東及員工與客戶三方共享營運成果。

最後，衷心感謝全體股東對經營團隊不斷的鼓勵與支持，祝福各位股東和樂安康，財源廣進！

董事長 吳啟勇



總經理 高國棟



貳、公司簡介

一、 設立日期：民國八十七年十月一日。

二、 公司沿革

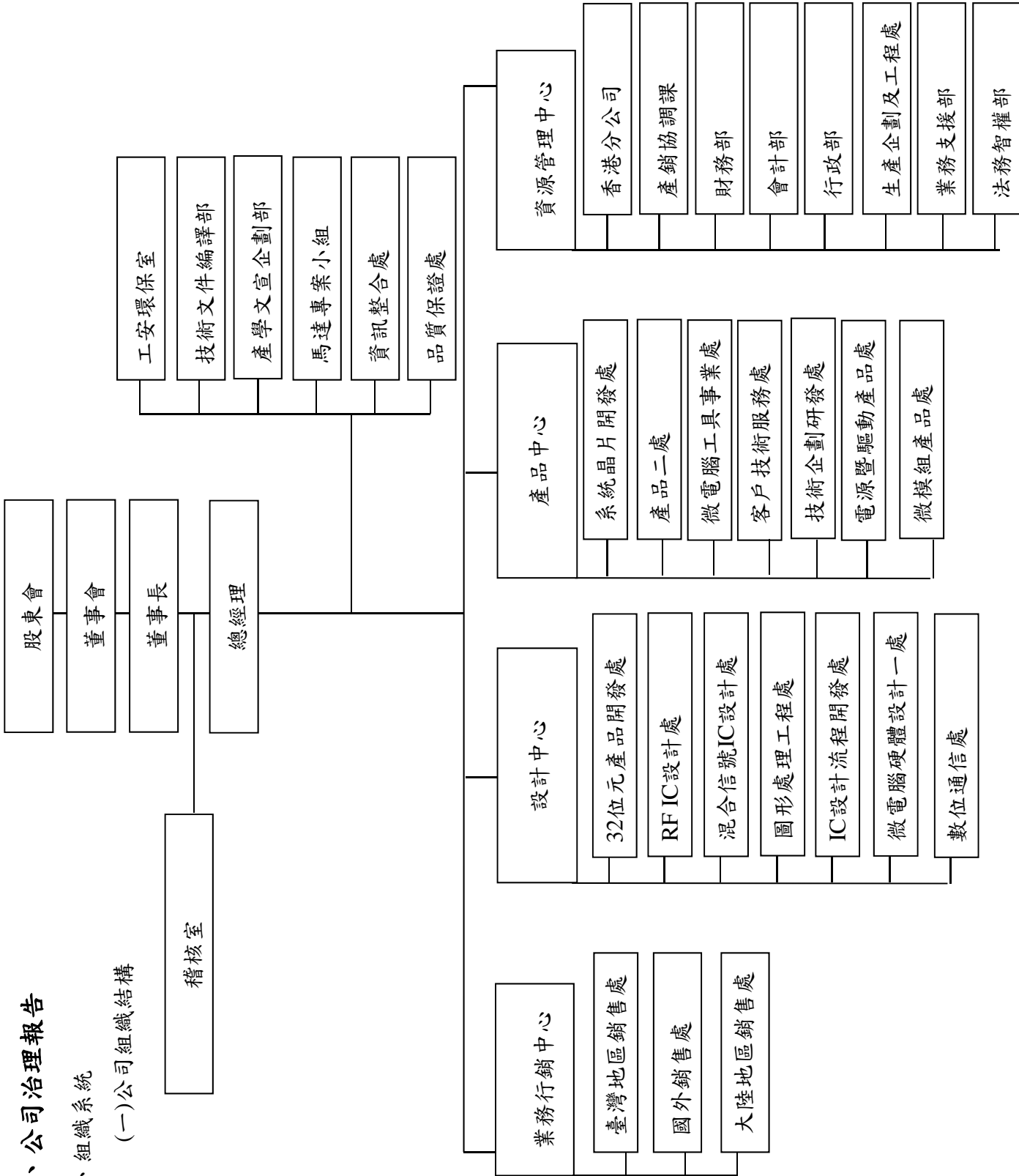
- | | | |
|--------|-----|---|
| 民國八十七年 | 十月 | 盛群半導體公司成立，設立實收資本額新台幣四億元。 |
| 民國八十八年 | 三月 | 現金增資新台幣六億元，實收資本額達新台幣十億元。 |
| 民國八十九年 | 三月 | 推出公司第一顆符合工業規格等級 8 位元 OTP MCU。 |
| | 四月 | 設立香港分公司，從事香港及部份海外地區發貨及倉儲作業。 |
| | 五月 | 經財政部證券暨期貨管理委員會核准股票公開發行。 |
| | | 通過國際 ISO 9001 品保認證。 |
| 民國九十年 | 三月 | 設立上海子公司（盛揚半導體（上海）有限公司），從事大陸地區 IC 銷售業務及提供技術支持與諮詢服務。 |
| | 五月 | 設立美國子公司（Holtek Semiconductor (USA), Inc.），從事北美地區 IC 銷售業務及提供技術支持與諮詢服務。 |
| 民國九十一年 | 八月 | 經財政部證券暨期貨管理委員會核准股票上櫃。 |
| | 十月 | 投資蘇州子公司（金科集成電路(蘇州)有限公司），負責大陸地區 IC 銷售業務及提供技術支持與諮詢服務。 |
| | 十一月 | 股票正式櫃檯買賣。 |
| 民國九十二年 | 七月 | 通過國際 ISO 14001 品保認證。 |
| | 八月 | 取得 SONY "Green Partner" 認證。 |
| | 九月 | 獲頒經濟部第十二屆國家發明獎。 |
| 民國九十三年 | 九月 | 股票正式上市買賣。 |
| | 十二月 | GSA 頒發 Outstanding Financial Performance Award。 |
| 民國九十四年 | 六月 | 取得華碩 "Green Partner" 認證。 |
| | 九月 | 取得經濟部核定在臺設立研發中心計劃。 |
| | 十月 | 取得三星電子 "ECO Partner" 認證。 |
| | 十一月 | 首屆盛群盃 MCU 校園競賽於臺灣地區舉行。 |
| | 十二月 | 取得經濟部核定在臺設立營運總部。 |
| 民國九十五年 | 五月 | 首屆盛群盃 MCU 校園競賽於大陸地區舉行。 |
| | 十一月 | 通過國際 OHSAS 18001 職業安全衛生管理認證。 |

- | | | |
|--------|-----|--|
| 民國九十六年 | 一月 | 推出公司第一顆符合工業規格等級 8 位元 Flash MCU。 |
| | 五月 | 通過 IECQ QC080000HSPM 國際認證。 |
| | 十二月 | Holtek 無線 USB 語音傳輸晶片 HT82A850R/HT82A851R 榮獲中國電子業界創新大獎。 |
| 民國九十七年 | 二月 | 投資廈門子公司（芯群集成電路（廈門）有限公司），負責大陸地區 IC 及微控制器應用工具技術支持與諮詢服務。 |
| 民國九十九年 | 一月 | 推出公司第一顆整合型 8 位元 Touch Flash MCU。 |
| 民國一〇〇年 | 五月 | 盛揚半導體（上海）有限公司遷移至深圳，更名為盛揚半導體（深圳）有限公司，從事大陸地區 IC 銷售及技術支持服務。 |
| | 六月 | 推出公司第一顆 ARM Cortex M3 32 位元 Flash MCU。 |
| | 七月 | 取得經濟部核定在臺設立營運總部。 |
| | 十月 | 推出 Touch Key Flash MCU with LED / LCD Driver。 |
| | 十二月 | 公司 8 位元 MCU 營收佔全球排名第 18 名。 |
| 民國一〇一年 | 六月 | 設立東莞子公司（合泰半導體（中國）有限公司），從事大陸地區 IC 銷售業務及提供技術支持與諮詢服務。 |
| | 十二月 | 公司 8 位元 MCU 營收佔全球排名第 14 名。
101 年度新推出產品：
1. Smoke Detector ASSP Flash MCU。
2. Power Bank ASSP Flash MCU。 |
| 民國一〇二年 | 十一月 | 通過 WPC 聯盟 Qi 標準。 |
| | 十二月 | 公司 8 位元 MCU 營收佔全球排名第 11 名。
102 年度新推出產品：
1. 20 位元 A/D + LCD Flash MCU。
2. Blood Pressure Meter ASSP Flash MCU。
3. Glucose Meter ASSP Flash MCU。 |
| 民國一〇三年 | 七月 | 推出全球最薄 6.5mm 及 4.9mm 光學式指紋辨識系列產品。
全球第五家擁有 UL 60730-1（家庭用電器用品安全機制）軟體認證的半導體公司。
取得經濟部核定在臺設立營運總部。 |
| | 十一月 | 無線充電微控制器 IC 取得 WPC 無線充電聯盟 Qi 規格認證。 |
| | 十二月 | 103 年度新推出產品：
1. 1.8V~5.5V Flash MCU。
2. 24 位元 A/D LCD Flash MCU。
3. Wireless Power Transmitter（Qi）ASSP Flash MCU。
4. Body Fat ASSP Flash MCU。 |
| 民國一〇四年 | 三月 | 獲選第三屆中堅企業潛力企業。 |

參、公司治理報告

一、組織系統

(一)公司組織結構



(二)各主要部門所營業務

部 門	主要職掌
稽核室	全公司業務及行政之稽核。
工安環保室	工安、消防安全、醫療保健及環境保護等相關事宜。
技術文件編譯部	撰寫 Holtek 產品 Datasheet、撰寫 Holtek 研發工具與 Demoboard 手冊、技術文件中英翻譯及英文文件支援。
產學文宣企劃部	媒體與文宣廣告活動、產學合作與推廣、技術資料處理及公司網站內容維護與發展。
馬達專案小組	(A)MCU 產品之市場企劃及技術企劃。 (B)MCU 產品之驗證及製作。 (C)開發平台底層軟體及 MCU 產品推廣。 (D)客戶產品技術交流及技術支援，解決產品應用問題。
資訊整合處	(A)規劃及維護公司網路資訊流動環境、硬體設施。 (B)研究開發並建立相關之資訊系統。
品質保證處	進出貨檢驗，外包廠品質監控、評鑑，品質活動推行，儀器校正作業，產品可靠度測試及客訴服務。
臺灣地區銷售處	產品推廣及銷售、Agent/Third party/客戶管理及技術服務。
國外銷售處	技術引進/情報收集、Agent/Third party/客戶管理、技術支援、產品推廣銷售與服務。
大陸地區銷售處	大陸地區市場開發、市場分析產品行銷及所屬代理商管理。
32 位元產品開發處	(A)32 位元微處理器之相關技術與 IP 之建立。 (B)32 位元微處理器之相關 IC 設計與整合。 (C)通訊與訊號處理相關之技術與 IP 之建立。 (D)通訊與訊號處理相關之 IC 設計與整合。
RF IC 設計處	(A)無線射頻接收機系統設計 RF Transceiver System Design。 (B)無線射頻接收機 IC 設計，整合和研發 RF Transceiver IC Design，Integrations and Developments。 (C)射頻 IC IP 研發 RF IC IP Developments。
混合信號 IC 設計處	(A)Analog IC/IP 技術評估及電路設計。 (B)Memory IC/IP 技術評估及電路設計。 (C)Digital Cell Library/IP 技術評估及電路設計。 (D)Special I/O 電路設計及 ESD/Latch up Cell 標準化。 (E)研發及委外生產技術之溝通協調、新製程引進之綜合評估及技術資料管理。
圖形處理工程處	(A)圖形處理自動化環境及圖形資料庫之建立。 (B)圖形佈局工作。
IC 設計流程開發處	(A)設計工具、設計流程及測試工程等研發環境整合與技術支援。 (B)研發及委外測試技術之協調，並將測試流程導入量產及管理。
微電腦硬體設計一處	MCU 產品設計技術之策略規劃及產品設計計劃管理。
數位通信處	數位信號處理器開發、數位信號處理演算法開發、通信系統架構分析與模擬、數位調變/解調技術開發、基頻資料封包處理/鏈結層控制器開發。
系統晶片開發處	(A)影像及音頻訊號處理的系統技術建立與 SoC 開發。 (B)影像及音頻訊號處理的資料儲存與傳輸的相關技術建立。

部 門	主要職掌
產品二處	負責 HT8 與 HT8051 8 位元 MCU 標準 MCU 與 ASSP MCU 之市場調查、規劃與開發管控、推廣及產品管理。
微電腦工具事業處	專案技術開發、新技術評估與導入、工具開發技術評估；客服問題處理、落實改善計畫；實驗室維護管理、零件採購與寄送。
客戶技術服務處	對客戶需求提供技術及產品應用整合工作。
技術企劃研發處	(A)統籌標準 MCU、嵌入式 MCU、特定產品專用 ASSP MCU 等相關 IC 產品開發技術相關事宜，包含產品系統技術分析、IC 市場 & 技術開發評估、IC 規格技術企劃、IC 應用驗證、產品系統驗證、產品應用開發、技術文件及後續產品推廣技術服務等事項。 (B)前瞻產品技術之搜尋，關鍵技術研究，關鍵性 IP 建立，提升產品層次及競爭力。
電源暨驅動產品處	(A)電源管理/白光 LED 背光/LED 照明/Motor Driver/ Display 相關產品市場企劃、系統規劃及新產品推廣。 (B)DC-DC PWM Buck Regulator、Boost Regulator、AC-DC Converter IC 設計開發及產品驗證。 (C)VFD/LED/LCD Display Controller/Driver IC 規格制定、設計開發、產品驗證及軟硬體技術支援。
微模組產品處	(A)產品企劃：市場訊息與相關 MCU 企劃及規格書產出。 (B)專案技術開發：新技術評估與導入、相關 MCU 產品應用驗證、產品應用工程、韌體撰寫與高階應用程式開發。 (C)生產工程：自動測試程序開發與料件規格制定。
香港分公司	從事香港及部份海外地區發貨及倉儲業務。
產銷協調課	(A)產銷協調，訂單交期及訂單監控。 (B)配貨出貨及貨源調配安排。 (C)PDB 系統 CID 及產品全碼維護。 (D)優方/盛通/金佶系統產銷存作業處理。
財務部	資金管理、客戶信用管理、進出口保稅業務、股務及投資人關係相關作業處理。
會計部	會計帳務處理、預算管理、轉投資管理及財務報表分析。
行政部	人事、教育訓練、總務、採購及員工福利等相關事務。
生產企劃及工程處	統籌委外採購及封裝/測試委工、倉儲/物流管理、工具製造、封裝/測試工程等作業事宜。
業務支援部	產品庫存之調節管理、業務資訊分析及產品訂價與成本管理。
法務智權部	法律事務、智慧財產權建立與維護及各項諮詢服務。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料

日期：104 年 4 月 11 日 單位：股

(一) 董事及監察人資料

職稱	國籍或註冊地	姓名	選就任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
						股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	吳啟勇	1020611	1020611~1050610	870907	7,655,809	3.41%	7,665,809	3.39%	2,745,598	1.21%	-	-	逢甲大學電子工程系 盛群公司董事長	盛群公司董事長 Holek Semiconductor Holding(BVI) Ltd、Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd、Bestcomm RF Electronics Inc.公司之法人董事代表人、盛凌投資、芯群集成電路(廈門)、合泰半導體(中國)、盛通科技之董事長	無	-	-
董事	中華民國	高國棟	1020611	1020611~1050610	870907	6,671,176	2.98%	6,701,176	2.96%	-	-	-	-	華夏工專電子工程科 盛群公司總經理	盛群公司總經理 Kingtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd、盛凌投資、芯群集成電路(廈門)、合泰半導體(中國)、盛通科技公司之法人董事代表人及金科集成電路(蘇州)有限公司董事長	無	-	-
董事	中華民國	張 治	1020611	1020611~1050610	930601	1,171,785	0.52%	1,156,785	0.51%	354,389	0.17%	-	-	成功大學電機所 盛群公司設計及產品中心執行副總	盛群公司設計及產品中心副總經理 金科集成電路(蘇州)、芯群集成電路(廈門)公司之法人董事代表人	無	-	-
董事	中華民國	林正鋒	1020611	1020611~1050610	870907	1,802,697	0.81%	1,842,697	0.81%	290,513	0.13%	-	-	逢甲大學電子系 盛群公司總經理室副總經理	盛群公司總經理室副總經理 Sigmos Holdings Ltd、MCU Holdings Ltd、香港新榮、新緯科技(深圳)公司之法人董事代表人	無	-	-
董事	中華民國	李佩榮	1020611	1020611~1050610	990615	996,843	0.45%	1,013,093	0.45%	630	0.00%	-	-	加州大學河濱分校企管所 盛群公司資源管理中心副總經理	盛群公司資源管理中心副總經理 Holek Semiconductor Holding(BVI) Ltd、Sigmos Holdings Ltd、MCU Holdings Ltd、盛凌投資、Santek Holdings Ltd、新永(廈門)電子、Newtek Electronics Ltd、新鼎電子(深圳)、滾達科技、Tuttek Technology Ltd、E-Micro Technology Holding Ltd、New Wave Electronics Holding Ltd、Crown Rich Technology Holding Ltd、Forc Electronics Holding Ltd、Qandeng Technology Holding Ltd、Imatek Electronics Inc、新碩電子(杭州)、Bestway Electronics Inc、香港新榮、振揚電子(青島)、金科集成電路(蘇州)、信霖電子商貿(上海)、諾華達電子(深圳)、華瑞昇電子(深圳)、華榮匯電子(北京)、全鼎電子(蘇州)、金濤高科、鈺威科技、欣宏電子、優方科技、金信科技、Bestcomm RF Electronics Inc、Best Solution Electronics Inc、MegaSky Electronics Inc、盛通科技及合泰半導體(中國)公司之法人董事代表人、芯群集成電路(廈門)、天字微機電專公司之法人監察人代表人、及金科集成電路(蘇州)有限公司總經理	無	-	-
獨立董事	中華民國	邢智田	1020611	1020611~1050610	930601	-	-	-	-	-	-	-	-	美國佛羅里達大學電機博士 廣達電腦(股)公司資深副總經理 廣達研究院院長	波若威科技(股)公司之獨立董事	無	-	-

職 稱	國籍 或 註冊地	姓 名	選就任 日 期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義持有 股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司 之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人		
						股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係
獨 立 董 事	中華民國	呂正樂	1020611	1020611~ 1050610	910417	-	-	-	-	-	-	-	-	東吳大學會計研究所 亞東聯合會計師事務所合夥會計師	亞東聯合會計師事務所合夥會計師 建漢科技股公司之獨立董事	無	-	-
監察人	中華民國	王仁宗	1020611	1020611~ 1050610	930601	3,635,209	1.63%	3,637,209	1.61%	-	-	-	-	清華大學科管系	松智科技股公司監察人、超豐電子(股)公司 之法人監察人代表人	無	-	-
監察人	中華民國	林嘉茂	1020611	1020611~ 1050610	870907	3,992,104	1.79%	3,992,104	1.77%	783,003	0.35%	-	-	輔仁大學數學系	無	無	-	-
監察人	中華民國	新耕投資 有限公司 代表人： 周玲娜	1020611	1020611~ 1050610	990615	368,884	0.16%	368,884	0.16%	-	-	-	-	東吳大學國貿系	優方科技股公司、欣宏電子(股)公司之法人 監察人代表人	無	-	-

(二)法人股東之主要股東

日期：104 年 4 月 11 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東(註)	法人股東之主要股 東其持股比例(%)
新耕投資有限公司	陳 芎	20.00
	張麗瓊	20.00
	許瑞茹	20.00
	李玉琴	20.00
	林正亮	20.00

註：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

(三)董事及監察人所具專業知識及獨立性情形

姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形（註）										兼任 其他 公開 發行 公司 獨立 董事 家數
		商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
吳啟勇			✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
高國棟			✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
張 治			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
林正鋒			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
李佩縈			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
呂正樂			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
邢智田			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
王仁宗			✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
林嘉茂			✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
新耕投資有限公司 代表人:周玲娜			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		0

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9)未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

(四)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

日期：104 年 4 月 11 日 單位：股

職 稱	國籍 或 註冊地	姓 名	選(就)任 日期	持有股份		配偶、未成年子 女持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司 之職務	具配偶或二親等 以內關係之經理 人		
				股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係
總經理	中華民國	高國棟	87/10/01	6,701,176	2.96%	-	-	-	-	華夏專電子工程科	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.、盛凌投資、芯群集成電路(廈門)、合泰半導體(中國)、盛通科技公司之法人董事代表人, 及金科集成電路(蘇州)有限公司董事長	無	-	-
設計及產品中心 行副總	中華民國	張 治	87/12/11	1,156,785	0.51%	354,389	0.16%	-	-	成功大學電機所	金科集成電路(蘇州)、芯群集成電路(廈門)公司之法人董事代表人	無	-	-
總經理室 副總經理	中華民國	林正鋒	87/12/11	1,842,697	0.81%	290,513	0.13%	-	-	逢甲大學電子系	Sigmos Holdings Ltd.、MCU Holdings Ltd.、香港新榮、新緯科技(深圳)公司之法人董事代表人	無	-	-
資源管理中心 副總經理	中華民國	李佩榮	92/01/06	1,013,093	0.45%	630	0.00%	-	-	加州大學河濱分校企 管所	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.、Sigmos Holdings Ltd.、MCU Holdings Ltd.、盛凌投資、Sanitek Holdings Ltd.、新禾(廈門)電子、Newtek Electronics Ltd.、新鼎電子(深圳)、凌達科技、Tinetek Technology Ltd.、E-Micro Technology Holding Ltd.、New Wave Electronics Holding Ltd.、Crown Rich Technology Holding Ltd.、Fortic Electronics Holding Ltd.、Quanting Technology Holding Ltd.、Innotek Electronics Inc.、新碩電子(杭州)、Bestway Electronics Inc.、香港新榮、振揚電子(青島)、金科集成電路(蘇州)、信霖電子商貿(上海)、諾華達電子(深圳)、華瑞昇電子(深圳)、華榮匯電子(北京)、全鼎電子(蘇州)、金濟高利、鉅威科技、欣宏電子、優方科技、金信科技、Bestcomm RF Electronics Inc.、Best Solution Electronics Inc.、MegaSky Electronics Inc.、盛通科技及合泰半導體(中國)公司之法人董事代表人, 芯群集成電路(廈門)、天字微機電等公司之法人監察人代表人, 及金科集成電路(蘇州)有限公司總經理	無	-	-
品質保證處協理	中華民國	吳紹藩	92/06/23	170,845	0.08%	10,080	0.00%	-	-	東海大學物理系	無	無	-	-
設計中心協理	中華民國	吳德傳	94/04/15	1,270,317	0.56%	-	-	-	-	成功大學電子研究所	無	無	-	-
產品中心協理	中華民國	王鈺鈿	98/07/01	185,393	0.08%	-	-	-	-	成功大學電機所	無	無	-	-
業務行銷中心 協理	中華民國	蔡榮宗	99/06/15	282,684	0.12%	206,580	0.09%	-	-	逢甲大學自動控制系	欣宏電子公司之法人董事代表人及合泰半導體(中國)公司之總經理	無	-	-
產品中心協理	中華民國	王明坤	100/04/01	193,349	0.09%	-	-	-	-	臺灣技術學院電子系	無	無	-	-
設計中心協理	中華民國	余國成	100/05/02	131,654	0.06%	29,839	0.01%	-	-	逢甲大學電子系	無	無	-	-
會計部門主管	中華民國	李文德	101/08/01	9,049	0.00%	-	-	-	-	中正大學國際經濟學系	無	無	-	-

三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一)董事(含獨立董事)之酬金

日期：103 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例(註 11)				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例(註 11)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註 12)
		報酬(A) (註 2)	退職退休金(B)	盈餘分配之酬勞(C)(註 3)	業務執行費用(D) (註 4)	薪資、獎金及特支費等(B)(註 5)	退職退休金(F)	盈餘分配員工紅利(G) (註 6)	員工認股權憑證得認購股數(H)(註 7) 單位：股數	取得限制員工權利新股股數(I)(註 13) 單位：股數	A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例(註 11)		本公司	財務報告內所有公司(註 8)	財務報告內所有公司(註 8)	
董事長	吳敏勇	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	
董事	高國棟	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	
董事	張治	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	
董事	林正鋒	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	
董事	李順榮	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	
獨立董事	呂正樂	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	
獨立董事	邢智田	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司(註 9)	財務報告內所有公司 (註 10)I	本公司(註 9)	財務報告內所有公司 (註 10)J
低於 2,000,000 元	吳啟勇、高國棟、張 治 林正鋒、李佩縈、呂正樂 邢智田	吳啟勇、高國棟、張 治 林正鋒、李佩縈、呂正樂 邢智田	呂正樂、邢智田	呂正樂、邢智田
2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	—	吳啟勇、高國棟	吳啟勇、高國棟
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	—	張 治、林正鋒、李佩縈	張 治、林正鋒、李佩縈
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—	—	—
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—	—	—
100,000,000 元以上	—	—	—	—
總計	7	7	7	7

註 1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者，應填列本表及下表。

註 2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3：係指最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。

註 4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者，應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列附表一之三。

註 7：係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權證得認購股數(不包括已執行部分)，除填列本表外，尚應填列附表十五。

註 8：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註 9：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 10：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 11：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 12：a. 本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b. 公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表之 J 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

註 13：係指截至年報刊印日止董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得限制員工權利新股股數，尚應填列附表十五之一。

(二)監察人之酬金

日期：103 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	監察人酬金						A、B 及 C 等三項總額占稅後純益之比例(註 8)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註 9)
		報酬(A)(註 2)		盈餘分配之酬勞(B)(註 3)		業務執行費用(C)(註 4)				
		本公司	財務報告內所有公司(註 5)	本公司	財務報告內所有公司(註 5)	本公司	財務報告內所有公司(註 5)	本公司	財務報告內所有公司(註 5)	
監察人	王仁宗	0	0	1,721	1,721	0	0	0.22%	0.22%	0
監察人	林嘉茂									
監察人	新耕投資有限公司 代表人：周玲娜									

酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司(註 6)	財務報告內所有公司(註 7)D
低於 2,000,000 元	王仁宗、林嘉茂 新耕投資有限公司代表人：周玲娜	王仁宗、林嘉茂 新耕投資有限公司代表人：周玲娜
2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	—
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	—
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	3	3

註 1：監察人姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：係指最近年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金獎勵金等等)。

註 3：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額。

註 4：係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。

如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司監察人各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 9：a.本欄應明確填列公司監察人領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司監察人如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司監察人於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表 D 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」

c.酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

(三)總經理及副總經理之酬金

日期：103 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)(註 2)		退職退休金 (B)		獎金及特支費 等等(C)(註 3)		盈餘分配之員工紅利金額(D)(註 4)				A、B、C 及 D 等 四項總額占稅後 純益之比例 (%)(註 9)		取得員工認股權憑 證數額 (註 5) 單位：股數		取得限制 員工權利 新股股數 (註 11)		有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金 (註 10)
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 6)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 6)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 6)	本公司	現金紅 利金額	股票紅 利金額	現金紅 利金額	本公司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 6)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 6)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 6)	
董事長	吳啟勇	10,350	10,350	0	0	2,500	2,500	6,059	0	6,059	0	2.39%	2.39%	0	0	0	0	0
總經理	高國棟																	
副總經理	張 治																	
副總經理	林正鋒	10,350	10,350	0	0	2,500	2,500	6,059	0	6,059	0	2.39%	2.39%	0	0	0	0	0
副總經理	李佩榮																	

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註 7)	財務報告內所有公司(註 8)E
低於 2,000,000 元	—	—
2,000,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	吳啟勇、高國棟、張 治 林正鋒、李佩縈	吳啟勇、高國棟、張 治 林正鋒、李佩縈
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	—	—
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	—	—
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	—	—
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	—	—
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	5	5

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 4：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利)，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列附表一之三。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 5：係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數 (不包括已執行部分)，除填列本表外，尚應填列附表十五。

註 6：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 7：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：應揭露 合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 9：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註10：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司 總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

註11：係指截至年報刊印日止董事兼任員工 (包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數，除填列本表外，尚應填列附表十五之一。

(四)配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

日期：103 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

	職稱 (註 1)	姓名 (註 1)	股票紅利金額	現金紅利金額	總計	總額占稅後純 益之比例(%)
經 理 人	董事長	吳啟勇	0	13,176	13,176	1.66%
	總經理	高國棟				
	設計中心副總 經理	張 治				
	總經理室副總 經理	林正鋒				
	資源管理中心 副總經理	李佩縈				
	品質保證處協 理	吳紹藩				
	設計中心協理	吳德傳				
	產品中心協理	王鈺鈿				
	業務行銷中心 協理	蔡榮宗				
	產品中心協理	王明坤				
	設計中心協理	余國成				
	會計部經理	李文德				

註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。

註 2：係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利)，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 3：經理人之適用範圍，依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定，其範圍如下：

- (1)總經理及相當等級者
- (2)副總經理及相當等級者
- (3)協理及相當等級者
- (4)財務部門主管
- (5)會計部門主管
- (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註 4：若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者，除填列附表一之二外，另應再填列表。

(五)比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析，並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

職 稱	支付酬金總額占個體財務報告稅後純益比例	
	103 年	102 年
董事	3.52%	3.58%
監察人	0.22%	0.22%
總經理及副總經理	2.39%	2.45%

1.董事及監察人酬金給付政策及訂定酬金之程序

依本公司章程規定，本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：

- (1)提繳稅捐。
- (2)彌補虧損。
- (3)提存百分之十為法定盈餘公積。
- (4)依證券交易法提列或迴轉特別盈餘公積。
- (5)員工紅利就依一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之十三·五。
- (6)董監事酬勞就一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之一·五。
- (7)扣除前各項餘額後，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派之。

由薪資報酬委員會討論依各董監事執行業務程度於上述金額內分配董事及監察人酬金。

2.總經理及副總經理酬金給付政策及訂定酬金之程序

本公司訂有人事薪資制度，總經理及副總經理之薪資依公司制度由人事單位予以考核，並送交總經理室會議中予以評定，並呈送薪資報酬委員會討論通過提交董事會決議，人事薪資制度參考因素主要為執行業務內容、經歷與績效及貢獻度，其中尤以績效及貢獻度為著；另依據本公司章程規定年度分派之盈餘中，員工紅利比例為依規定分配數額後剩餘之數提撥 13.5%，員工紅利之分配由人事單位制定之分配辦法作業，該辦法參考因素主要為職務內容、績效及未來貢獻度，尤以績效及未來貢獻度比重最大，送交總經理室會議中予以評定。上述之總經理、副總經理及協理級經理人之薪資及員工紅利於總經理室會議中予以核定後，呈薪資報酬委員會討論通過並提交董事會決議。

3.給付酬金與經營績效及未來風險之關聯性

- (1) 董事之酬金，係根據其在本公司擔任之職位及對本公司營運參與程度及貢獻之價值核發。
- (2) 總經理及副總經理之酬金，係根據職位、對公司的貢獻度及參考同業水準，依本公司人事規章辦理。

已將經營績效時所需考量未來風險發生之可能性及關聯性減至最低，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以落實風險與報酬之管理平衡。

四、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊：103 年度董事會開會 6 次，董事監察人出席情形如下

職稱	姓名(註 1)	實際出(列) 席次數	委託出 席次數	實際出(列)席 率(%)(註 2)	備 註
董 事 長	吳啟勇	6	0	100%	
董 事	高國棟	6	0	100%	
董 事	張 治	6	0	100%	
董 事	林正鋒	6	0	100%	
董 事	李佩縈	6	0	100%	
獨 立 董 事	呂正樂	5	1	83%	
獨 立 董 事	邢智田	5	1	83%	
監 察 人	王仁宗	6	0	100%	
監 察 人	林嘉茂	6	0	100%	
監 察 人	新耕投資有限公司 代表人：周玲娜	6	0	100%	

其他應記載事項：

- 一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無。
- 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
- 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：
 1. 本公司訂有「董事會議事規則」及設立獨立董事，以提升董事會運作效能。
 2. 獨立董事每月定期覆核內部稽核人員所編製之稽核報告，實際掌握公司運作情形。

註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(二)監察人參與董事會運作情形：103 年度董事會開會 6 次，監察人出席情形如下

職稱	姓名	實際列席次數	實際出席率(%)(註)	備 註
監 察 人	王仁宗	6	100%	
監 察 人	林嘉茂	6	100%	
監 察 人	新耕投資有限公司 代表人：周玲娜	6	100%	

其他應記載事項：

一、監察人之組成與職責：

(一) 監察人與公司員工及股東之溝通情形：本公司監察人如認為有必要時，可隨時與員工及股東直接溝通。

(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：本公司監察人經常列席董事會監督公司經營狀況，每月定期覆核內部稽核人員所編製之稽核報告，實際掌握公司運作情形，並於每季審閱經會計師查核或核閱之簽證報告。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。

註：

- (1) 年度終了日前有監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間實際出席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，有監察人改選者，應將新、舊任監察人均予以填列，並於備註欄註明該監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間實際出席次數計算之。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已訂定「公司治理守則」，並隨時注意國內與國際公司治理制度之發展，據以檢討改進公司所建置之公司治理制度，以提昇公司治理成效。	與公司治理實務守則相符。
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		<p>(一)</p> <p>1. 本公司依照公司法及相關法令規定召集股東會，並制定完備的股東會議事規則，給予股東適當的發言機會，股東對議案有異議時可充分表達意見，並採取票決方式決議。</p> <p>2. 本公司重視股東知的權利，除確實遵守資訊公開之相關規定，將公司財務、業務及內部人持股情形，即時以公開資訊觀測站之資訊系統提供訊息予股東。</p> <p>3. 為確保股東權益，本公司設有發言人制度及專責投資人關係人員處理股東建議、疑義及糾紛事項，並於本公司外部網頁充分揭露聯繫方式，股東均可反應意見，並獲妥善處理。</p> <p>4. 為降低公司訴訟風險及成本，並確保股東權益，本公司內部設有專職法務單位，並聘請外部專業法律顧問，依內部處理程序處理法務訴訟相關事宜。</p>	(一)與公司治理實務守則相符。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及	V		(二)本公司依證交法第25條規定，對內部人(董事、	(二)與公司治理實務守則相符。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	
主要股東之最終控制者名單？			監察人、經理人及持有股份超過總額10%之股東)所持股權之變動情形，按月申報公開資訊觀測站，以掌握實際控制公司的主要股東及主要股東之最終控制者名單，以確保經營之穩定。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三)與公司治理實務守則相符。 1. 本公司內部控制涵蓋企業層級之風險管理及作業層級之營運活動，並訂有「對子公司之監理辦法」，落實對子公司風險控管機制。 2. 本公司訂有「關係人、特定公司及集團企業交易處理辦法」，與關係企業間之人員、資產及財務管理權責均清楚劃分，有業務往來者，本於公平合理原則，並建立健全之財務、業務及會計管理制度，往來之客戶及廠商妥適進行風險評估，實施必要的控管機制，建立適當的防火牆，及訂定相關的內部控制制度。 3. 本公司設有專責單位每月定期檢查及監督各關係企業的營運循環及財務作業，確認關係企業運作正常且風險皆在本公司可控制範圍。 (四)本公司依據證交法及其他法令規定，已訂定「誠信經營守則」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四)與公司治理實務守則相符。
三、董事會之組成及職責			

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	V		<p>(一)</p> <p>1. 本公司董事會考量公司經營發展規模及主要股東持股情形，衡酌實務運作需要設置董事七~九人之適當董事席次，其中二席為獨立董事並具備財務及產業相關專業資格。</p> <p>2. 本公司董事成員除二席獨立董事具有電子產業專業及財金專業外，其他五席董事亦為在電子產業擁有二十年以上專業，分別針對產品開發、市場推廣、供應鏈管理、財務會計、內部控制等，分別擬訂公司目標及計劃，並每月/每季檢查是否落實計畫目標。</p> <p>3. 本公司董事均慎盡職守、忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權，對於公司業務之執行，除依法律或公司章程規定應由股東會決議之事項外，確實依董事會決議為之。</p>	(一)與公司治理實務守則相符。
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		<p>(二)</p> <p>1. 本公司已設置第二屆薪資酬勞委員會，任期自102/06/11至105/06/10日。</p> <p>2. 本公司為健全監督功能及強化管理機能，必要時將設置其他各類功能性委員會。</p>	(二)與公司治理實務守則相符。
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？	V		<p>(三)</p> <p>1. 本公司訂定「薪資報酬委員會組織規程」，每季定期召開一次。</p>	(三)與公司治理實務守則相符。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	<p>2.履行職權如下：</p> <p>(1) 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。</p> <p>(2) 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。</p> <p>(四)</p> <p>1. 本公司每年定期依據「會計師職業道德規範第十號公報」及「上市上櫃公司治理實務守則」之規範，審酌簽證會計師之專業資格及獨立性，連同會計師出具未違反獨立性之聲明函，提報董事會評估之。</p> <p>2. 本公司所聘任之會計師未擔任本公司之董事、經理人或重大影響之職務，亦非利害關係人，且無直接及間接利益衝突情事，經審核皆符合其獨立性無虞。</p>	(四)與公司治理實務守則相符。

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、公司是否建立與利害關係人溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		<p>1. 本公司與股東、往來銀行、員工、客戶、供應商或利益相關者，保持暢通之溝通管道，並尊重及維護其應有的合法權益。</p> <p>2. 本公司設有投資人關係專責單位，提供股東及投資人公司相關資訊及溝通管道。</p> <p>3. 本公司對於往來銀行提供充足的資訊及財務報表，以便其瞭解公司的經營及財務狀況。</p> <p>4. 本公司透過各種管道鼓勵員工與管理階層溝通，適度反映員工對公司之意見。</p> <p>5. 本公司與客戶及供應商保持長期良好的合作關係，每月定期檢討往來情況，增進合作默契。</p> <p>6. 本公司致力於經營發展及實現股東利益最大化，並關注消費者權益、社區環保及公益等議題，並投入人力經費以加強產學合作及社會職能訓練，重視公司之社會責任。</p>	與公司治理實務守則相符。
五、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理股東會相關事務。	與公司治理實務守則相符。
六、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		(一)本公司設有中/英文網站(www.holtek.com.tw)，定期揭露及更新公司財務業務、公司治理、與投資人相關資訊。	(一)與公司治理實務守則相符。
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放	V		<p>(二)</p> <p>1. 本公司定期更新公開資訊之網路申報作業系統，指定專人負責公司資訊的蒐集及揭露工</p>	(二)與公司治理實務守則相符。

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
置公司網站等)？			<p>作，並建立發言人制度，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，能夠及時允當揭露。</p> <p>2. 本公司設有投資人關係專責人員負責公司資訊之蒐集及揭露，且依規定設有發言人及代理發言人，並已將相關財務資訊、重要新聞訊息與「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「薪資酬勞委員會組織章程」、「公司治理守則」、「誠信經營守則」及「企業社會責任實務守則」等資訊於公司外部網站揭露。</p> <p>3. 本公司每季定期召開法人說明會，並將相關資料及法說會現場影片放置於公開資訊觀測站及公司網站中，並提供投資人查詢公司營運及財務資訊。</p>	
七、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		<p>1. 員工權益：本公司設有行政人事專責單位，制定各項符合勞工法令規定之制度與措施，並輔導員工在工作上遇到的困難，以保障員工各項權益。</p> <p>2. 僱員關懷：本公司除設有職工福利委員會定期舉辦活動及提供婚喪住院補助外，設有醫務休息室、餐廳、員工休閒活動區，並舉辦員工及眷屬團體保險，並聘僱專業之護理人員負責員工健康檢查與追蹤管理及健康講座等活動。</p> <p>3. 投資者關係：本公司注重各股東應有之權益，依法充分揭露公司營運各項訊息，設有發言人制度</p>	與公司治理實務守則相符。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明
			<p>及專責投資人員處理股東權益之各項事務，並以提升營運績效及股東權益報酬率為長期目標。</p> <p>4. 供應商關係：</p> <p>(1) 本公司之主要供應商均為國內外知名大廠，往來信用良好，並重視與供應商建立長久之合作關係。</p> <p>(2) 本公司亦注重供應商本身是否符合國際環保規定及勞工安全衛生規範，致力於綠色供應鏈之建立。</p> <p>5. 利害關係人之權利：本公司對利害關係人之權利，保持良好之溝通管道，並尊重維護其應有之合法權益。</p> <p>6. 董事及監察人進修之情形：本公司每年規劃相關課程，提供董事、監察人進修，以加強專業知識及實務運作，董監事進修情形請參閱第44頁。</p> <p>7. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：</p> <p>本公司訂定內部控制制度並有效執行，其中，財務風險管理：(1)信用風險：主要往來銀行、客戶及供應商適時辦理風險評估，以降低信用風險；(2)流動性風險：企業剩餘資金之運用，首重金融投資商品是否為低風險性及高流動性，其次方追求合理之收益率。另，有關營運風險管理：(1)銷售分散：透過銷售分散可防止客戶因惡性破產</p>

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明
			<p>而受影響；(2)智慧財產權保護：有關專利之文件均依「機密文件」管理規定，不得擅自攜帶外出或轉借；調閱時須經過調閱及保管部門主管核准後始得調卷。資訊安全風險管理：(1)各項重要資料、檔案皆定期資料備份，且電腦程式設計測試、使用及維護均制定嚴密之作業管制流程；(2)對外營運之資訊系統已建構完善安全防護系統防範駭客非法攻擊，並建置多組輔助及替換電腦設備，以降低資訊系統中斷風險。</p> <p>8. 客戶政策之執行情形：</p> <p>(1) 本公司以長期穩健經營為原則，重視國內外客戶之長期合作關係，提供最具競爭力的產品及服務予客戶，重視客戶應有之權益，並定期審視客戶與本公司間之往來業務及信用狀況，創造雙贏局面。</p> <p>(2) 本公司配合客戶需求，提供各式環保標章證明及勞安衛證書，並協助客戶取得市場推廣所需認證及供貨保障。</p> <p>9. 公司為董事及監察人購買責任保險之情形：</p> <p>本公司董事及監察人之選任資格皆符合公司法等相關法令規定，皆為具有豐富商務、財務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗或專業資格之人士，目前雖未有購董事及監察人之責任保險，但每月定期評估公司營運狀況及風險，因公</p>

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	
八、公司是否有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告？（若有，請敘明其董事會意見、自評或委外評鑑結果、主要缺失或建議事項及改善情形）（註2）	V	<p>司營運正常且資金充裕，並未有對外融資之情形，另聘請法律顧問提供法務協助，未來將視實際情況或依相關法令規定辦理。</p> <p>1. 本公司依規定至證基會網站完成第一屆公司治理評鑑系統-自評作業。</p> <p>2. 本公司除確實辦理內部控制制度之自行檢查作業外，董事會及管理階層均至少每季檢討各部門自行檢查結果及稽核單位之稽核報告，並由監察人關注及監督之。</p> <p>3. 針對自評作業未能達成之項目，本公司已進行持續改善中，期許自評成績逐年進步。</p>	與公司治理實務守則相符。

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

註2：所稱公司治理自評報告，係指依據公司治理自評項目，由公司自行評估並說明，各自評項目中目前公司運作及執行情形之報告。

(四)薪酬報酬委員會之組成、職責及運作情形

(1)薪資報酬委員會成員資料

身份別 (註1)	姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形 (註2)								兼任其他 公開發行公 司薪資報酬 委員會成員 家數	備註 (註3)
		商務、法 務、會計 或公司業 務所需相 關料系之 公私立大 專院校講 師以上	法官、檢察 官、律師、會 計師或其他 與公司業務 所需之國家 考試及格 領有證書之 專門職業及 技術人員	具有商務、法 務、會計 或公司業 務所需之工 作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8		
獨立 董事	呂正樂		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	
獨立 董事	邢智田			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	
其他	蔡英雄			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	

註1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
- (8)未有公司法第30條各款情事之一。

註3：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第6條第5項之規定。

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
2. 本屆委員任期：102 年 6 月 11 日至 105 年 6 月 10 日，103 年度薪資報酬委員會開會 4 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席次 數	實際出席率(%) (註)	備註
召集人	邢智田	3	1	75%	
委員	呂正樂	4	0	100%	
委員	蔡英雄	4	0	100%	

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無，董事會全數採納薪資報酬委員會之建議。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無，薪資報酬委員會之各項決議事項，所有委員全數通過。

註：

- (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(五)履行社會責任情形

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、落實公司治理 (一)公司是否訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效？	V		(一)與企業社會責任實務守則相符。
(二)公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？	V		(二)與企業社會責任實務守則相符。
(三)公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？	V		(三)與企業社會責任實務守則相符。
(四)公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，及設立明確有效之獎勵與懲戒制度？	V		(四)與企業社會責任實務守則相符。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
二、發展永續環境 (一)公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(一)與企業社會責任實務守則相符。
(二)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		(二)與企業社會責任實務守則相符。
(三)公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響，並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略？	V		(三)與企業社會責任實務守則相符。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>三、維護社會公益</p> <p>(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	V	<p>(一)</p> <p>1.本公司依照勞動及相關法規制定各項符合法規之制度與措施，以保障員工之各項權益。</p> <p>2.本公司遵守安衛法令規章要求，落實安全衛生作業準則。</p> <p>3.本公司確保員工職場安全衛生，提供安全衛生設施環境。</p> <p>4.本公司實施安衛訓練溝通宣導，推行全員預防認知責任。</p> <p>5.本公司建立安衛稽核審查制度，承諾推行持續改善活動。</p> <p>6.本公司重視員工權益，除設有職工福利委員會定期舉辦各項活動及提供各項補助外，同時設有醫務休息室、餐廳、員工休閒活動區，辦理員工及眷屬團體保險，聘僱專業醫護人員定期舉辦員工健康檢查及提供即時醫療服務等相關福利措施。</p>	(一)與企業社會責任實務守則相符。
<p>(二)公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適處理？</p>	V	<p>(二)</p> <p>1.本公司設有內部電子信箱、部門會議等管道供同仁們與公司各級主管做雙向的意見表達及溝通，並設置行政部專職人員，提供員工暢通的申訴管道。</p> <p>2.本公司發現或接獲檢舉本公司人員涉有不誠信或違反兩性工作平等法等違法行為時，應即刻查</p>	(二)與企業社會責任實務守則相符。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V	<p>明相關事實，如經證實確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，立即要求行為人停止相關行為，並為適當之處置，且於必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。</p> <p>3.本公司對於已發生之不誠信或違法行為，將責成相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。</p> <p>4.本公司專責單位將不誠信或違法行為、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。</p> <p>5.本公司人員遇有他人對公司從事不誠信或違法行為，其行為如涉有法律情事，公司將相關事實通知司法及檢察機關；如涉及有公務機關或公務人員者，並通知政府廉政機關。</p> <p>(三)</p> <p>1.本公司於2006年導入國際安全衛生標準OHSAS18001，並推動各項員工安全衛生業務的持續改善活動，包括安全衛生相關訓練，創造優良的工作環境，並保護員工身心健康與安全。</p> <p>2.本公司每年定期委託醫療機構特別至公司安排員工各項身體健康檢查，並設有專門之醫護人員提供醫護服務，以及每二個月安排專業醫師至公司看診及舉辦健康講座，注重員工身心健康。</p>	(三)與企業社會責任實務守則相符。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
(四)公司是否建立員工定期溝通之機制,並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動?	V	(四) 1. 本公司設有內部電子信箱、部門會議等管道供同仁們與公司各級主管做雙向的意見表達及溝通,並設計相關訓練課程,提供員工自我成長。 2. 公司管理制度或營運模式有重大變動時,公司將召開說明會向員工說明,並設置專職單位回答員工之疑問,讓員工充分瞭解公司制度規章。	(四)與企業社會責任實務守則相符。
(五)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	V	(五)本公司對人才的培育一直不遺餘力,除編列預算供員工在外進修外,並由教育訓練委員會、行政部及部門主管針對公司發展目標及部門需求設計內部訓練課程,讓每位員工在完整的工作生涯培訓體系下成長: 1. 職前訓練(新人訓練):說明公司文化、提昇工作上專業訓練。 2. 在職訓練:部門自辦訓練、公司內部訓練、線上學習課程、公司外部訓練。 3. 在職進修:資深工程師可申請國內大學在職進修計劃,增進其專業研究發展技術與管理能力以配合公司未來發展與永續經營的需要。 4. 自我發展:除培養員工之專業能力,使其能在技術上建立自信心,進而訓練成計劃主持人,在計劃管理上感受團隊合作經驗及建立;另外培養資深員工為公司中堅幹部,依職級需求參與基層、中階、高階主管管理訓練,以提升經營管理能力及績效。	(五)與企業社會責任實務守則相符。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
(六)公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？	V	(六) 1.本公司重視產品品質，並訂有「客戶滿意度作業規範」、「客戶抱怨處理規範」及「客戶退貨處理規範」等作業程序，並且在公司網站設置客戶服務專區，達到盡速解決並處理客戶申訴問題之目標。 2.為符合國際規範，本公司於研發、採購及生產流程均嚴格遵守相關安全、環保及勞工保護規範，以確保本公司出貨的產品，維護客戶的權益。	(六)與企業社會責任實務守則相符。
(七)對產品與服務之行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則？	V	(七)本公司產品遵循國際環保法規，符合歐盟ROHS與REACH的要求，並在產品包裝上有明確標示，以確保產品不含有傷害人體的有害物質。	(七)與企業社會責任實務守則相符。
(八)公司與供應商來往前，是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄？	V	(八) 1.本公司與他人建立商業關係前，應先行瞭解代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。 2.本公司人員於從事商業行為過程中，應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑提供或收受不正當利益。	(八)與企業社會責任實務守則相符。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
(九)公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款？	V	<p>3.本公司人員應避免與不誠信經營之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。</p> <p>4.本公司嚴格要求往來的供應商亦需取得相關品保及環境標準規定，並定期稽核所有供應商是否持續落實相關規定。</p> <p>(九)本公司與主力供應商合作通過第三方SGS的社會責任要求稽核，並定期與供應商開會檢討要求符合環保規定之材料及工廠推行勞工衛生安全管理。</p>	(九)與企業社會責任實務守則相符。
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊？	V	(一)本公司網站上詳細說明品質與環安衛政策，並將推動企業社會責任列為公司經營理念之重要環節。	(一)與企業社會責任實務守則相符。
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司為善盡企業社會責任，並促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展，訂有「企業社會責任實務守則」，主要運作重點內容如下：	<p>(一)落實推動公司治理：依據公司治理守則及誠信經營守則辦理各項工作。</p> <p>(二)發展永續環境：注重生態環境保護與資源有效利用，並落實於實際運作上。</p> <p>(三)維護社會公益：保障員工權益與創造良好的工作環境，並關心社區發展與消費者權益。</p> <p>(四)加強企業社會責任資訊揭露：充份揭露相關資訊於年報及公司網站。</p>		
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：			

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>(一)本公司為IC設計公司，並無製程或生產設備，故無空氣污染及廢水問題；至於一般事業廢棄物之處理，本公司設有資源回收專區，並交由合格廠商回收；對於有害之事業廢棄物，本公司亦設有專區處理，再委託合格之甲級清除商代為處理。</p> <p>(二)本公司委託晶圓代工及封裝測試業務之供應商，均有要求必須通過ISO9001、ISO14000及OHSAS08000之相關規範及認證，並定期檢視是否持續進行與改善。</p> <p>(三)本公司注重員工之工作環境安全及身心健康，並保障員工之工作權益，以及重視員工工作技能之訓練與提昇能力，提供員工安心工作健康無虞的環境。</p>			
<p>七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：</p> <p>本公司已於2007年通過Philips委託SGS的EICC系統稽核(電子工業行為準則)，內容包括企業社會責任、工業安全衛生與環保等相關稽核事項。</p>			

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

註2：公司已編製企業社會責任報告書者，摘要說明得以註明查閱企業社會責任報告書方式及索引頁次替代之。

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施：

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		(一)與公司誠信經營守則相符。
(二)公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？	V		(二)與公司誠信經營守則相符。

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？	V		<p>3.本公司透過內部稽核制度，並於每月定期審核所有業務/財務/人事資訊，建立嚴謹的防範制度，防止不誠信行為發生。</p> <p>(三)</p> <p>1.本公司之帳戶進出均有專人隨時監控，不會有外帳或保留秘密帳戶，亦俾確保公司內部有牽涉行賄及收賄、提供非法政治獻金等措施之情形時，利用糾正或檢舉違反廉潔守則情事，維護同仁、公司及股東權益之行為。</p> <p>2.收受不正當利益之處理程序：本公司人員遇有他人直接或間接提供或承諾給予金錢、餽贈、服務、優待、款待、應酬及其他利益時，若有前條各款所訂情形外，應依下列程序辦理：</p> <p>(1)提供或承諾之人與其無職務上利害關係者，應於收受之日起三日內，陳報其直屬主管，並知會行政部。</p> <p>(2)提供或承諾之人與其職務有利害關係者，應予退還或拒絕，並陳報其直屬主管及知會行政部；無法退還時，應於收受之日起三日內，交行政部處理。行政部應視第一項財物之性質及價值，提出退還、付費收受、歸公、轉贈慈善機構或其他適當建議，呈總經理核准後執行。</p> <p>3.合法政治獻金之處理程序：</p> <p>(1)應確認係符合政治獻金收受者所在國家之政治獻金相關法規，包括提供政治獻金之上限及形式等。</p>	(三)與公司誠信經營守則相符。

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>(2)政治獻金應依法規及會計相關處理程序予以入帳。</p> <p>(3)提供政治獻金時，應避免與政府相關單位從事商業往來、申請許可或辦理其他涉及公司利益之事項。</p> <p>4.本公司每月定期檢查相關資訊，除嚴格落實防範措施外，其立即矯正可能產生漏洞之作業程序。</p>	
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p>	V		<p>(一)</p> <p>1.本公司與往來銀行、代理商、供應商或利益相關者，均由專案人員定期審視其信用狀況，可即時避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，且與代理商/經銷商等簽訂之「產品代理/經銷/銷售契約」針對銷售價格、智慧財產權及保密責任進行規範。</p> <p>2.與供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序：</p> <p>(1)本公司與他人建立商業關係前，應先行瞭解代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。</p> <p>(2)本公司人員於從事商業行為過程中，應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑提供或收受不正當利益。</p>	(一)與公司誠信經營守則相符。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形？	V		(3)本公司人員應避免與不誠信經營之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。 (二)本公司針對較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，由公司內部稽核人員定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。 (二)與公司誠信經營守則相符。
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		(三)與公司誠信經營守則相符。
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？	V		1.本公司遵守公司法、證券交易法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。 2.本公司之董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。 3.本公司為健全誠信經營之管理，由專責單位負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並定期向董事會報告。 (四)本公司已建立完整的會計制度、內部控制制度，由內部稽核人員及外部專業人員(如會計師)持續稽查違反誠信經營之情事，截至今日並無違反誠信經營之情事。 (四)與公司誠信經營守則相符。

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五) 1.本公司定期對董監事、經理人、受僱人及實質控制者舉辦誠信經營之教育訓練與宣導。 2.本公司安排董監事進修課程，著重於有關誠信經營相關內部作業之建立及檢查機制之訓練，加強董監事及經營階層對於誠信經營之重視。	(五)與公司誠信經營守則相符。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		(一) 1.本公司同仁若發現有舞弊或洩漏機密而違反誠信經營規定時，可透過部門主管或行政部予以檢舉，並指派專責人員受理，調查相關事實證明，若確實違反廉潔守則，除所獲取之各項不正當利益，均應追繳發還被索取人或公司外，並依情節之大小，予以下列不等之處分，或合併處分： (1) 扣發績效獎金、年終獎金、紅利。 (2) 降等。 (3) 免職。 (4) 採取法律行動。 2.檢舉事項若能有效改善及防止營運損失者，公司對於檢舉人將發信感謝並於績效考核及獎金發放給予適時獎勵。	(一)與公司誠信經營守則相符。
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？	V		(二) 1.本公司發現或接獲檢舉本公司人員涉有不誠信之行為時，即刻查明相關事實，如經證實確有違反相關法	(二)與公司誠信經營守則相符。

評 估 項 目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則 差異情形及原因
	是	否	
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？ 四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		令或本公司誠信經營政策與規定者，將立即要求行為人停止相關行為，並為適當之處置，且於必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。 2.本公司對於已發生之不誠信行為，責成相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。 3.本公司專責單位將不誠信行為、其處理方式及後續檢討改善措施，向公司經營階層及董事會報告。 4.本公司人員遇有他人對公司從事不誠信行為，其行為如涉有不法情事，公司應將相關事實通知司法及檢察機關；如涉有公務機關或公務人員者，並應通知政府廉政機關。 (三)本公司提供正當且獨立之檢舉管道，並對檢舉人身份及檢舉內容確實保密，以維護檢舉人之人身安全。
	V		(一)與公司誠信經營守則相符。
			(三)與公司誠信經營守則相符。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司訂有「誠信經營守則」，並隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，提昇誠信經營成效，目前運作情形良好。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） (一)本公司定期對董事、監察人、經理人、受僱人及實質控制者舉辦誠信經營之教育訓練與宣導，其若發現有違本守則嫌疑之情事，均向其主管或檢舉管道負責單位舉報之責任與義務。並將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。			

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則 差異情形及原因
	是	否	
<p>(二)本公司提供正當且獨立之檢舉管道，並對檢舉人身分及檢舉內容確實保密，以維護檢舉人之人身安全。</p> <p>(三)本公司明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並將即時於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。</p> <p>(四)截止目前為止，公司無發生重大違反誠信經營規定，影響公司營運之情事。</p>			

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

本公司已訂定公司治理實務守則，並陸續依『上市上櫃公司治理實務守則』建置相關辦法有『股東會議事規則』、『董事會議事規則』、『董事及監察人選舉辦法』、『內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序』。另本公司已將『公司章程』、『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人作業程序』、『背書保證作業程序』、『薪資酬勞委員會組織章程』、『公司治理守則』、『誠信經營守則』及『企業社會責任實務守則』等資訊揭露於公司外部網站。

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

董事/監察人、經理人及稽核主管之進修情形：

職稱	姓名	就任日期	進修期間	主辦單位	課程名稱	時數
董事長	吳啟勇	102/06/11	103/11/05	社團法人中華公司治理協會	經營階層之商業判斷 vs. 證券詐欺、資訊不實與掏空資產	3.0
董事	高國棟	102/06/11	103/11/05	社團法人中華公司治理協會	經營階層之商業判斷 vs. 證券詐欺、資訊不實與掏空資產	3.0
董事	張 治	102/06/11	103/11/05	社團法人中華公司治理協會	經營階層之商業判斷 vs. 證券詐欺、資訊不實與掏空資產	3.0
董事	林正鋒	102/06/11	103/11/05	社團法人中華公司治理協會	經營階層之商業判斷 vs. 證券詐欺、資訊不實與掏空資產	3.0
董事	李佩縈	102/06/11	103/11/05	社團法人中華公司治理協會	經營階層之商業判斷 vs. 證券詐欺、資訊不實與掏空資產	3.0
獨立董事	呂正樂	102/06/11	103/07/10	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	103 年度上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0
獨立董事	邢智田	102/06/11	103/11/05	社團法人中華公司治理協會	經營階層之商業判斷 vs. 證券詐欺、資訊不實與掏空資產	3.0
監察人	王仁宗	102/06/11	103/11/05	社團法人中華公司治理協會	經營階層之商業判斷 vs. 證券詐欺、資訊不實與掏空資產	3.0
監察人	林嘉茂	102/06/11	103/11/05	社團法人中華公司治理協會	經營階層之商業判斷 vs. 證券詐欺、資訊不實與掏空資產	3.0
監察人	新耕投資 有限公司 代表人： 周玲娜	102/06/11	103/11/05	社團法人中華公司治理協會	經營階層之商業判斷 vs. 證券詐欺、資訊不實與掏空資產	3.0
會計 主管	李文德	101/08/01	103/05/22 ~ 103/05/23	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12.0
稽核 主管	廖明通	103/02/01	103/05/26 ~ 103/05/28	財團法人證券暨期貨發展基金會	企業初任內部稽核人員職前訓練研習班	18.0

(九)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書

盛群半導體股份有限公司

內部控制制度聲明書



日期：一〇四年三月十八日

本公司民國一〇三年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估及回應 3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國一〇三年十二月三十一日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一〇四年三月十八日董事會通過，出席董事六人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

盛群半導體股份有限公司

董事長：吳啟勇



總經理：高國棟



2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

(十一)最近年度及截至年報報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

日 期	會 別	重 要 決 議 事 項
103.06.11	股東常會	1.通過本公司民國一〇二年度營業報告 2.通過監察人查核本公司民國一〇二年度決算報告 3.通過本公司「公司治理守則」訂定案 4.通過本公司「誠信經營守則」訂定案 5.通過本公司「企業社會責任實務守則」訂定案 6.通過本公司民國一〇二年度營業報告書及財務報表 7.通過本公司民國一〇二年度盈餘分派案 8.通過本公司法定盈餘公積配發股東現金案 9.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
103.07.24	董事會	1.通過訂定本公司一〇二年度盈餘分派之配息基準日案 2.通過訂定本公司法定盈餘公積發放現金基準日案 3.通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」部份條文修訂案 4.通過本公司董事及監察人酬勞與經理人績效津貼及員工紅利案
103.10.28	董事會	1.通過本公司「一〇四年稽核作業風險評估報告及年度稽核計劃」案 2.通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」部份條文修訂案 3.通過本公司經理人績效津貼案
103.12.24	董事會	1.通過本公司一〇四年營運計劃書
104.01.26	董事會	1.通過本公司民國一〇三年合併財務報告及個體財務報告 2.通過本公司董監事及經理人薪資報酬案 3.通過 MCU Holdings Ltd.轉投資 MegaSky Electronics Holding Ltd. 案 4.通過 MegaSky Electronics Holding Ltd.轉投資兆暉科電子(佛山)有限公司案(名稱暫定)
104.03.18	董事會	1.通過本公司民國一〇三年度營業報告書 2.通過本公司民國一〇三年度盈餘分派案 3.通過本公司法定盈餘公積配發股東現金案 4.通過本公司「公司章程」修訂案 5.通過本公司「股東會議事規則」修訂案 6.通過討論解除董事競業禁止案 7.通過本公司一〇四年股東常會召開日期案 8.通過本公司出具內部控制聲明書案
104.04.27	董事會	1.通過本公司評估簽證會計師獨立性及適任性案 2.通過本公司經理人績效津貼案

(十二)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者：無。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士(包括公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等)辭職解任情形：無。

五、會計師公費資訊

(一) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備 註
安侯建業聯合會計師事務所	魏興海	曾漢鈺	103/01/01~103/12/31	--

金額單位：新台幣仟元

金額級距 \ 公費項目		審計公費	非審計公費	合 計
1	低於 2,000 千元	—	—	—
2	2,000 千元(含)~4,000 千元	3,480	—	3,480
3	4,000 千元(含)~6,000 千元	—	—	—
4	6,000 千元(含)~8,000 千元	—	—	—
5	8,000 千元(含)~10,000 千元	—	—	—
6	10,000 千元(含)以上	—	—	—

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。

(三) 審計公費較前一年度減少百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

六、更換會計師資訊：無。

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	103 年度		當年度截至 104 年 4 月 11 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	吳啟勇	—	—	—	—
董事兼總經理	高國棟	—	—	—	—
董事兼副總經理	張 治	(37,000)	—	—	—
董事兼副總經理	林正鋒	—	—	—	—
董事兼副總經理	李佩縈	—	—	—	—
獨立董事	呂正樂	—	—	—	—
獨立董事	邢智田	—	—	—	—
監察人	王仁宗	—	—	—	—
監察人	林嘉茂	—	—	—	—
監察人	新耕投資有限公司 代表人：周玲娜	—	—	—	—
協 理	吳紹菡	—	—	—	—
協 理	吳德傳	—	—	—	—
協 理	王鈺鈿	—	—	(4,000)	—
協 理	蔡榮宗	—	—	—	—
協 理	王明坤	(44,000)	—	—	—
協 理	余國成	—	—	—	—
會計主管	李文德	(8,000)	—	(8,000)	—
大股東	聯華電子(股)公司	(3,626,000)	—	—	—

註 1：持有公司股份總額超過百分之十股東應註明為大股東，並分別列示。

註 2：股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，尚應填列下表。

(二)股權移轉資訊

本公司董事、監察人、經理人及持股比例 10% 以上股東並無辦理股權移轉予關係人之情事。

(三)股權質押資訊

本公司董事、監察人、經理人及持股比例 10% 以上股東並無辦理股票質押予關係人之情事。

九、持股比例占前十名之股東，其相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

104 年 4 月 11 日 ；單位：股

姓名（註 1）	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。 （註 3）		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱	關係	
聯華電子股份有限公司 洪嘉聰	25,944,257	11.47%	—	—	—	—	無	無	
富邦人壽保險股份有限公司 鄭本源	13,400,000	5.92%	—	—	—	—	無	無	
吳啟勇	7,665,809	3.39%	2,745,598	1.21%	—	—	無	無	
高國棟	6,701,176	2.96%	—	—	—	—	無	無	
南山人壽保險股份有限公司 郭文德	5,522,000	2.44%	—	—	—	—	無	無	
新光人壽保險股份有限公司 吳東進	5,404,000	2.39%	—	—	—	—	無	無	
啟盛投資股份有限公司 陳佳宏	5,172,703	2.29%	—	—	—	—	無	無	
匯豐託管景順基金—景順亞洲平衡基金 戴福來及黃思遠	4,227,000	1.87%	—	—	—	—	無	無	
財團法人國家文化藝術基金會 施振榮	4,011,000	1.77%	—	—	—	—	無	無	
林嘉茂	3,992,104	1.77%	783,003	0.35%	—	—	無	無	

註 1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註 2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比例。

註 3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

日期：103 年 12 月 31 日 單位：仟股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	15,253	100%	—	—	15,253	100%
盛揚半導體(深圳)有限公司(註 1)	—	—	—	—	—	—
芯群集成電路(廈門)有限公司(註 1)	—	100%	—	—	—	100%
合泰半導體(中國)有限公司(註 1)	—	100%	—	—	—	100%
Sigmos Holdings Ltd.	200	100%	—	—	200	100%
Holtek Semiconductor (USA) Inc. (註 2)	2,000	100%	—	—	2,000	100%
MCU Holdings Ltd.	2,277	100%	—	—	2,277	100%
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	2,000	100%	—	—	2,000	100%
金科集成電路(蘇州)有限公司(註 3)	—	100%	—	—	—	100%
盛凌投資股份有限公司	40,000	100%	—	—	40,000	100%
Bestway Electronic Inc. (註 4)	800	40%	—	—	800	40%
新棠(香港)有限公司(註 5、註 19)	—	40%	—	—	—	40%
新緯科技(深圳)有限公司(註 6)	—	40%	—	—	—	40%
Santek Holdings Ltd. (註 4)	180	40%	—	—	180	40%
新禾(廈門)電子有限公司(註 7)	—	40%	—	—	—	40%
New Wave Electronics Holding Ltd. (註 4)	800	40%	—	—	800	40%
諾華達電子(深圳)有限公司(註 8)	—	40%	—	—	—	40%
金濤高科有限公司(註 4)	—	40%	—	—	—	40%
泓達科技有限公司(註 4)	—	33%	—	—	—	33%
Innotek Electronics Inc. (註 4)	320	40%	—	—	320	40%
新碩電子科技(杭州)有限公司(註 9)	—	40%	—	—	—	40%
ForIC Electronics Holding Ltd. (註 4)	300	40%	—	—	300	40%
華榮匯電子科技(北京)有限公司(註 10)	—	40%	—	—	—	40%
E-Micro Technology Holding Ltd. (註 10、註 20)	300	40%	—	—	300	40%
振揚電子(青島)有限公司(註 11)	—	40%	—	—	—	40%
Newtek Electronics Ltd. (註 4)	1,501	41%	—	—	1,501	41%
新鼎(深圳)電子有限公司(註 12)	—	41%	—	—	—	41%
Truetek Technology Ltd. (註 4)	920	40%	—	—	920	40%
信霖電子商貿(上海)有限公司(註 13)	—	40%	—	—	—	40%
Crown Rich Technology Holding Ltd. (註 4)	80	40%	—	—	80	40%
華瑞昇電子(深圳)有限公司(註 14)	—	40%	—	—	—	40%
Quanding Technology Holding Ltd. (註 4)	60	40%	—	—	60	40%
全鼎電子(蘇州)有限公司(註 15)	—	40%	—	—	—	40%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
欣宏電子股份有限公司(註 16)	6,345	40%	10	0%	6,355	40%
A-ONE WIRELESS TECHNOLOGY CORP.(註 17)	2,000	40%	—	—	2,000	40%
群鋒(深圳)有限公司(註 18)	—	40%	—	—	—	40%
鈺威股份有限公司(註 16)	5,641	22%	—	—	5,641	22%
高聖科技股份有限公司(註 16)	235	39%	115	19%	350	58%
優方科技股份有限公司(註 16)	1,600	55%	500	13%	2,100	69%
BEST SOLUTION ELECTRONIC INC. (註 21)	400	55%	—	—	400	55%
天宇微機電股份有限公司(註 16)	380	20%	—	—	380	20%
金佶科技股份有限公司(註 16)	846	32%	—	—	846	32%
Gingy Technology Inc.(註 22)	2	32%			2	32%
盛通科技股份有限公司(註 16)	2,000	100%			2,000	100%
BestComm RF Electronics Inc.(註 23)	18	100%			18	100%

註 1：係 Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.轉投資。

註 2：係 Sigmos Holdings Ltd.轉投資。

註 3：係 Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.轉投資。

註 4：係 MCU Holdings Ltd.轉投資。

註 5：係 Bestway Electronic Inc.轉投資。

註 6：係新棠(香港)有限公司轉投資。

註 7：係 Santek Holdings Ltd.轉投資。

註 8：係 New Wave Electronics Holding Ltd.轉投資。

註 9：係 Innotek Electronics Inc.轉投資。

註 10：係 ForIC Electronics Holding Ltd.轉投資。

註 11：係 E-Micro Technology Holding Ltd.轉投資。

註 12：係 Newtek Electronics Ltd.轉投資。

註 13：係 Truetek Technology Ltd.轉投資。

註 14：係 Crown Rich Technology Holding Ltd.轉投資。

註 15：係 Quanding Technology Holding Ltd.轉投資。

註 16：係盛凌投資股份有限公司轉投資。

註 17：係欣宏電子股份有限公司轉投資。

註 18：係 A-ONE WIRELESS TECHNOLOGY CORP.轉投資。

註 19：由新棠(香港)有限公司之股東設立，並全數收購新棠(香港)有限公司原股東之股權，於完成股權移轉後，MCU Holding Ltd.持有 Bestway 40%之股權。

註 20：由 ForIC Electronics Holding Ltd.全數收購 E-Micro Technology Holding Ltd. (BVI)原股東之股權，完成股權移轉後，ForIC Electronics Holding Ltd.持有 E-Micro Technology Holding Ltd. (BVI) 100%之股權。

註 21：係優方科技股份有限公司轉投資。

註 22：係金佶科技股份有限公司轉投資。

註 23：係盛通科技股份有限公司轉投資。

註 24：上述轉投資事業均係公司採用權益法之投資。

肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

年 月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其 他
87/10	10	100,000	1,000,000	40,000	400,000	公司發起設立現金增資 340,000 仟元	技術股作價 60,000 仟元	--
88/04	10	100,000	1,000,000	100,000	1,000,000	現金增資 600,000 仟元	無	--
89/05	10	180,000	1,800,000	122,000	1,220,000	盈餘轉增資 220,000 仟元	無	註 1
90/04	10	180,000	1,800,000	153,380	1,533,800	盈餘轉增資 313,800 仟元	無	註 2
91/06	10	180,000	1,800,000	175,118.7	1,751,187	盈餘轉增資 217,387 仟元	無	註 3
92/06	10	260,000	2,600,000	183,400	1,834,000	盈餘轉增資 82,813 仟元	無	註 4
93/07	10	270,000	2,700,000	194,100	1,941,000	盈餘轉增資 107,000 仟元	無	註 5
94/06	10	290,000	2,900,000	205,409.5	2,054,095	盈餘轉增資 113,095 仟元	無	註 6
94/08	10	290,000	2,900,000	206,614.5	2,066,145	認股權憑證轉換 12,050 仟元	無	註 7
94/10	10	290,000	2,900,000	206,695	2,066,950	認股權憑證轉換 805 仟元	無	註 7
95/01	10	290,000	2,900,000	207,244.5	2,072,445	認股權憑證轉換 5,495 仟元	無	註 7、8
95/04	10	290,000	2,900,000	207,451.5	2,074,515	認股權憑證轉換 2,070 仟元	無	註 7、8
95/08	10	290,000	2,900,000	211,126.1	2,111,261	盈餘轉增資 36,746 仟元	無	註 9
95/08	10	290,000	2,900,000	212,100.1	2,121,001	認股權憑證轉換 9,740 仟元	無	註 7、8、10
95/10	10	290,000	2,900,000	212,210.35	2,122,103.5	認股權憑證轉換 1,102.5 仟元	無	註 7、8、10
96/01	10	290,000	2,900,000	212,470.1	2,124,701	認股權憑證轉換 2,597.5 仟元	無	註 7、8、10
96/04	10	290,000	2,900,000	212,759.35	2,127,593.5	認股權憑證轉換 2,892.5 仟元	無	註 7、8、10
96/08	10	290,000	2,900,000	216,487.05	2,164,870.5	盈餘轉增資 37,277 仟元	無	註 11
96/08	10	290,000	2,900,000	217,550.8	2,175,508	認股權憑證轉換 10,637.5 仟元	無	註 7、8、10
96/11	10	290,000	2,900,000	217,843.3	2,178,433	認股權憑證轉換 2,925 仟元	無	註 7、8、10
97/02	10	290,000	2,900,000	218,005.3	2,180,053	認股權憑證轉換 1,620 仟元	無	註 7、8、10
97/04	10	290,000	2,900,000	218,297.3	2,182,973	認股權憑證轉換 2,920 仟元	無	註 7、8、10
97/09	10	300,000	3,000,000	220,470.4	2,204,704	盈餘轉增資 21,731 仟元	無	註 12
97/09	10	300,000	3,000,000	220,910.4	2,209,104	認股權憑證轉換 4,400 仟元	無	註 7、8、10
97/11	10	300,000	3,000,000	220,955.15	2,209,551.5	認股權憑證轉換 447.5 仟元	無	註 7、8、10
98/03	10	300,000	3,000,000	220,997.4	2,209,974	認股權憑證轉換 422.5 仟元	無	註 7、8、10
98/04	10	300,000	3,000,000	221,180.9	2,211,809	認股權憑證轉換 1,835 仟元	無	註 7、8、10
98/08	10	300,000	3,000,000	222,087.7	2,220,877	盈餘轉增資 9,068 仟元	無	註 13
98/08	10	300,000	3,000,000	222,217.45	2,222,174.5	認股權憑證轉換 1,297.5 仟元	無	註 8
98/11	10	300,000	3,000,000	222,301.45	2,223,014.5	認股權憑證轉換 840 仟元	無	註 8

年 月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其 他
99/02	10	300,000	3,000,000	222,347.45	2,223,474.5	認股權憑證轉換 460 仟元	無	註 8
99/04	10	300,000	3,000,000	222,556.2	2,225,562	認股權憑證轉換 2,087.5 仟元	無	註 8、14
99/08	10	300,000	3,000,000	222,666.2	2,226,662	認股權憑證轉換 1,100 仟元	無	註 14、15
99/11	10	300,000	3,000,000	222,798.7	2,227,987	認股權憑證轉換 1,325 仟元	無	註 14、15
100/02	10	300,000	3,000,000	223,044.2	2,230,442	認股權憑證轉換 2,455 仟元	無	註 14、15
100/05	10	300,000	3,000,000	223,339.7	2,233,397	認股權憑證轉換 2,955 仟元	無	註 14、15
100/08	10	300,000	3,000,000	223,598.45	2,235,984.5	認股權憑證轉換 2,587.5 仟元	無	註 14、15
102/08	10	300,000	3,000,000	223,680.45	2,236,804.5	認股權憑證轉換 820 仟元	無	註 15
102/11	10	300,000	3,000,000	224,941.2	2,249,412	認股權憑證轉換 12,607.5 仟元	無	註 15
103/01	10	300,000	3,000,000	226,168.2	2,261,682	認股權憑證轉換 12,270 仟元	無	註 15

註 1：財政部證券暨期貨管理委員會 89 年 5 月 15 日(89)台財證(一)第 36989 號函核准。

註 2：財政部證券暨期貨管理委員會 90 年 4 月 3 日(90)台財證(一)第 116941 號函核准。

註 3：財政部證券暨期貨管理委員會 91 年 5 月 17 日(91)台財證(一)第 126989 號函核准。

註 4：財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 6 月 27 日(92)台財證(一)第 0920128586 號函核准。

註 5：金融監督管理委員會證券期貨局 93 年 6 月 25 日(93)台財證(一)第 0930128187 號函核准。

註 6：金融監督管理委員會證券期貨局 94 年 6 月 24 日(94)金管證(一)第 0940125322 號函核准。

註 7：財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 4 月 1 日(92)台財證(一)第 0920110590 號函核准。

註 8：財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 8 月 22 日(92)台財證(一)第 0920138382 號函核准。

註 9：金融監督管理委員會證券期貨局 95 年 6 月 29 日(95)金管證(一)第 0950127323 號函核准。

註 10：財政部證券暨期貨管理委員會 93 年 6 月 25 日(93)台財證(一)第 0930128187 號函核准。

註 11：金融監督管理委員會 96 年 6 月 25 日(96)金管證(一)第 0960031838 號函核准。

註 12：金融監督管理委員會 97 年 7 月 9 日(97)金管證(一)第 0970034273 號函核准。

註 13：金融監督管理委員會 98 年 6 月 23 日金管證發字第 0980031086 號函核准。

註 14：行政院金融監督管理委員會 94 年 8 月 26 日金管證一字第 0940135791 號函核准。

註 15：行政院金融監督管理委員會 96 年 12 月 31 日金管證一字第 0960073308 號函核准。

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未發行股份	合 計	
普 通 股	226,168,200 股	73,831,800 股	300,000,000 股	屬上市公司股票

總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)股東結構

104 年 4 月 11 日

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個 人	外國機構 及外國人	合計
人 數	1	17	86	17,277	122	17,503
持有股數	66,000	31,420,580	41,418,551	116,434,824	36,828,245	226,168,200
持股比率(%)	0.03%	13.89%	18.31%	51.49%	16.28%	100%

(三)股權分散情形

1.普通股

104年4月11日

持股分級	股東人數	持有股數	持股比率%
1 至 999	5,177	279,135	0.12
1,000 至 5,000	9,508	18,466,394	8.16
5,001 至 10,000	1,389	10,775,371	4.76
10,001 至 15,000	434	5,371,667	2.38
15,001 至 20,000	265	4,871,926	2.15
20,001 至 30,000	222	5,563,918	2.46
30,001 至 50,000	187	7,419,206	3.28
50,001 至 100,000	137	9,634,815	4.26
100,001 至 200,000	78	11,163,464	4.94
200,001 至 400,000	43	11,982,815	5.30
400,001 至 600,000	16	8,260,512	3.65
600,001 至 800,000	12	8,231,072	3.64
800,001 至 1,000,000	4	3,607,296	1.59
1,000,001 股以上	31	120,540,609	53.31
合 計	17,503	226,168,200	100.00

2.特別股：無。

(四)主要股東名單：股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱，
持股數額及比例

104年4月11日；單位：股

股 份 主要股東名稱	持有股數	持股比率%
聯華電子股份有限公司	25,944,257	11.47%
富邦人壽保險股份有限公司	13,400,000	5.92%
吳啟勇	7,665,809	3.39%
高國棟	6,701,176	2.96%
南山人壽保險股份有限公司	5,522,000	2.44%
新光人壽保險股份有限公司	5,404,000	2.39%
啟盛投資股份有限公司	5,172,703	2.29%
匯豐託管景順基金－景順亞洲平衡基金	4,227,000	1.87%
財團法人國家文化藝術基金會	4,011,000	1.77%
林嘉茂	3,992,104	1.77%

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣元

項 目 \ 年 度		102 年	103 年	當年度截至 104 年 3 月 31 日
每 股 市 價 (註 1)	最 高	49.90	71.60	61.90
	最 低	29.60	44.70	56.30
	平 均	37.61	57.15	59.05
每 股 淨 值 (註 2)	分配前	17.73	17.94	18.64
	分配後	14.22	註 8	註 8
每 股 盈 餘	加權平均股數(仟股)	224,158	226,168	226,168
	每股盈餘(註 3)	3.32	3.50	0.71
每 股 股 利	現金股利	3.30	註 8	—
	無 償 配 股	盈餘配股	註 8	—
		資本公積配股	註 8	—
	累積未付股利(註 4)		—	—
投 資 報 酬 分 析	本益比(註 5)	11.33	16.33	—
	本利比(註 6)	11.40	註 8	—
	現金股利殖利率(註 7)	8.77%	註 8	—

註 1：列示各年度普通股最高及最低市價，並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。

註 2：請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。

註 3：如有因無償配股等情形而須追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。

註 4：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。

註 5：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。

註 6：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。

註 7：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

註 8：103 年度盈餘分派案尚未經股東常會決議，故相關比率暫不列示。

(六)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策

本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：

- (1)提繳稅捐。
- (2)彌補虧損。
- (3)提存百分之十為法定盈餘公積。
- (4)依證券交易法提列或迴轉特別盈餘公積。
- (5)員工紅利就依一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之十三·五。
- (6)董監事酬勞就一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之一·五。
- (7)扣除前各項餘額後，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派之。

上述股東股利部份，其中現金股利不低於當年度發放股東現金股利及股東股票股利合計數之百分之五十。

2.本次股東會擬議股利分配之情形

本次股東會股利分配情形經董事會擬議如下：

本公司擬自 103 年度盈餘分配中，提撥新台幣 715,143,848 元為股東股利，全數以現金發放，每股擬配發現金股利 3.162 元，以法定盈餘公積分配，法定盈餘 76,444,852 元按配息基準日之股東名簿所記載之股東持股數，每股配發現金 0.338 元，合計每股配發現金 3.50 元。

另提撥新台幣 96,174,085 元為員工紅利，全數以現金發放。

本公司若因法令變更或主管機關核定變更或遇買入庫藏股轉讓予員工，或遇有可轉換公司債行使轉換為普通股，或員工認股權憑證行使認股權而發行新股時，則股東之配息比例，提請股東會授權董事會按除息基準日流通在外股數，依比例再調整，並全權處理相關事項。

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無。

(八)員工分紅及董事、監察人酬勞：

1.公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍

本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：

- (1)提繳稅捐。
- (2)彌補虧損。
- (3)提存百分之十為法定盈餘公積。
- (4)依證券交易法提列或迴轉特別盈餘公積。
- (5)員工紅利就依一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之十三·五。
- (6)董監事酬勞就一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之一·五。
- (7)扣除前各項餘額後，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派之。

2.103 年度估列員工紅利及董事、監察人配發金額之估列基礎與會計處理：

本公司依上述公司章程規定比例提供員工紅利及董監事酬勞，帳列當期費用項下，若董事會或股東會決議與估列金額有差異時，於決議年度將差異金額帳列當期費用項下調整之。

3.董事會通過 103 年度盈餘擬議配發員工分紅等資訊：

(1)配發員工現金紅利及董事、監察人酬勞金額

員工現金紅利：96,174,085 元

董監事酬勞：10,686,009 元

(2)擬議配發員工股票紅利股數及其占盈餘轉增資之比例：無

(3)考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘 3.50 元

4.上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形

本公司 102 年度盈餘實際配發員工紅利及董監事酬勞之相關資訊如下：

單位：新台幣元

	股東會決議 實際配發數	原董事會通過 擬議配發數	差異數	差異原因
員工現金紅利	90,510,842	90,510,842	—	無
員工股票紅利	—	—	—	無
董監事酬勞	10,056,760	10,056,760	—	無

(九)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債(含海外公司債)辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、參與發行海外存託憑證之辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響：無。

(二)累積至年報刊印日止，取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購(含合併、收購及分割)或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形

(一)計畫內容：前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：無。

(二)執行情形：前各次發行或私募有價證券截至年報刊印日前一季止之執行情形及與原預計效益之比較：無。

伍、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容

本公司以各種積體電路之設計服務與自有產品之開發、製造及行銷為主要業務，其整體產品開發與相關設計服務皆以客戶及市場需求為導向。

2. 主要產品之營業比重

產品別 \ 年度	103 年度
微控制器 IC	70%
週邊 IC	30%
合 計	100%

3. 目前產品及服務項目

在自有產品的開發部分，本公司之產品重心係以微控制器(MCU)暨其週邊 IC 為技術核心，主要應用範圍包含各式標準型及嵌入式 MCU、螢幕顯示 IC 產品、電源管理 IC 產品、電腦週邊 IC 產品、通訊 IC 產品、記憶體 IC 產品、類比 IC 產品、觸控開關 IC 產品、金融產品、物聯網產品等，其產品走向不但要求符合全球性的應用領域，亦十分重視區域性特殊需求的滿足。另外本公司也針對個別客戶之需求，提供專屬 ASIC MCU 之委託設計服務，以及針對特殊應用領域開發 ASSP MCU，以充分滿足各類市場的需求。

4. 計劃開發之新產品及服務

為了提供客戶完整的產品及技術服務，本公司將產品應用範圍擴及 4C 領域，同時提供包含多種設計形式之專業服務，以滿足客戶對產品功能、成本、推出時效或產品保護等多樣要求。茲分述主要產品內容如下：

- (1) 工作電壓 1.8V~5.5V A/D 型及 LCD 型 Flash MCU。
- (2) 高壓 12V A/D 型系列 Flash MCU，內含 LDO 穩壓電路及高壓輸出。
- (3) 24 位元 Delta Sigma A/D with LCD 型 Flash MCU。
- (4) 8051 核心 Flash MCU。
- (5) 整合電容式感應觸控按鍵+大功率功放語音 Flash MCU 系列。
- (6) 整合人機界面操作電容感應式觸控 Flash MCU 系列性解決方案。
- (7) 各種醫療量測 MCU 及解決方案。
- (8) 小家電電源專用 MCU 及解決方案。
- (9) 移動電源充放電管理專用 MCU 及解決方案。
- (10) 無線充電器專用 MCU 及解決方案。

- (11) 鋰電池充放電與太陽能電池管理及解決方案。
- (12) 安防產品(例：煙感器) MCU 內建 OPA 及解決方案。
- (13) E-Banking MCU。
- (14) 超聲波流量計 ASSP MCU。
- (15) 超音波測距/倒車雷達專用 MCU。
- (16) NFC 介面 IC 及 MCU。
- (17) 監控攝影機 MCU 及解決方案。
- (18) 語音 Flash MCU。
- (19) Audio MCU。
- (20) RF 315/433 Mhz/2.4G MCU 與解決方案。
- (21) FRS Audio processor 專用式 Flash MCU 整合 SoC 方案。
- (22) RF Sub 1GHz 及 OOK 超再生接收 I/O+A/D Flash MCU 解決方案。
- (23) RF Sub 1GHz 及 OOK+FSK 無線發射 Flash MCU SoC 方案
- (24) USB Full speed Flash MCU 系列。
- (25) USB Low speed Flash MCU 系列。
- (26) USB Bridge 系列 IC。
- (27) USB Fingerprint ASSP MCU。
- (28) USB 調色鍵盤 ASSP MCU。
- (29) 32 位元 MCU 之物聯網應用開發平台及解決方案。
- (30) 32 位元 MCU 之低功耗藍牙應用開發平台及解決方案。
- (31) 32 位元 MCU 產品朝向更高的效能(96MHz)和更高的 C/P 值發展。
- (32) 電錶專用 LCD 液晶顯示驅動 IC。
- (33) LED 照明驅動 IC。
- (34) 標準 OPA 產品開發。
- (35) Class D Amp 產品開發。
- (36) 電源管理 IC(LDO/DC-DC/AC-DC)。
- (37) 高壓總線傳輸 IC。
- (38) 高速 CIS/CCD 類比前置處理器(AFE)及其 LVDS 介面。
- (39) 高速貨幣序號(冠字碼)讀出暨影像辨識處理器及解決方案。
- (40) 精準 RTC 計時 IC。
- (41) 霍爾(Hall)元件 SoC 整合 IC。
- (42) 模組產品類：結合各類感測器的應用，並具有需求高精度、需複雜的量產特性校正、特殊小尺寸或應用技術門檻高等性質的應用產品，如焦電型紅外線感知器(PIR)模組、溫濕度感知器模組等。

(二) 產業概況：

1. 產業之現況與發展

依據臺灣半導體協會委託工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)，於日前公佈的臺灣半導體產業回顧與展望報告：2014 年第四季臺灣整體 IC 產業產值(含 IC 設計、IC 製造、IC 封裝、IC 測試)達新台幣 5,902 億元(USD\$19.4B)，較上季(14Q3)成長 0.3%，較去年同期(13Q4)成長 20.4%。其中 IC 設計業產值為新台幣 1,505 億元(USD\$5.0B)，較上季(14Q3)衰退 2.8%，較去年同期(13Q4)成長 16.5%；IC 製造業為新台幣 3,277 億元(USD\$10.8B)，較上季(14Q3)成長 5.2%，較去年同期(13Q4)成長 28.5%，其中晶圓代工為新台幣 2,680 億元(USD\$8.8B)，較上季(14Q3)成長 9.9%，較去年同期(13Q4)成長 44.2%，記憶體製造為新台幣 597 億元(USD\$2.0B)，較上季(14Q3)衰退 11.9%，較去年同期(13Q4)衰退 13.9%；IC 封裝業為新台幣 790 億元(USD\$2.6B)，較上季(14Q3)衰退 6.5%，較去年同期(13Q4)成長 7.5%；IC 測試業為新台幣 330 億元(USD\$1.1B)，較上季(14Q3)衰退 11.5%，較去年同期(13Q4)成長 1.5%(新台幣對美元匯率以 30.4 計算)。

工研院 IEK 統計 2014 年臺灣 IC 產業產值達新台幣 22,033 億元(USD\$72.5B)，較 2013 年成長 16.7%。其中 IC 設計業產值為新台幣 5,763 億元(USD\$19.0B)，較 2013 年成長 19.8%；IC 製造業為新台幣 11,731 億元(USD\$38.6B)，較 2013 年成長 17.7%，其中晶圓代工為新台幣 9,140 億元(USD\$30.1B)，較 2013 年成長 20.4%，記憶體製造為新台幣 2,591 億元 (USD\$8.5B)，較 2013 年成長 9.2%；IC 封裝業為新台幣 3,160 億元(USD\$10.4B)，較 2013 年成長 11.1%；IC 測試業為新台幣 1,379 億元(USD\$4.5B)，較 2013 年成長 8.9%。

2014 年臺灣 IC 產業產值統計結果

億新台幣	14Q1	季 成長	年 成長	14Q2	季 成長	年 成長	14Q3	季 成長	年 成長	14Q4	季 成長	年 成長	2014 年	年 成長
IC 產業產值	4,736	-3.4%	15.3%	5,512	16.4%	14.8%	5,883	6.7%	15.9%	5,902	0.3%	20.4%	22,033	16.7%
IC 設計業	1,253	-3.0%	23.8%	1,456	16.2%	19.7%	1,549	6.4%	20.0%	1,505	-2.8%	16.5%	5,763	19.8%
IC 製造業	2,458	-3.6%	13.1%	2,880	17.2%	13.5%	3,116	8.2%	15.3%	3,277	5.2%	28.5%	11,731	17.7%
晶圓代工	1,807	-2.7%	6.2%	2,215	22.6%	12.3%	2,438	10.1%	18.3%	2,680	9.9%	44.2%	9,140	20.4%
記憶體製造	651	-6.1%	37.6%	665	2.2%	17.7%	678	2.0%	5.6%	597	-11.9%	-13.9%	2,591	9.2%
IC 封裝業	710	-3.4%	11.8%	815	14.8%	12.6%	845	3.7%	12.7%	790	-6.5%	7.5%	3,160	11.1%
IC 測試業	315	-3.1%	9.8%	361	14.6%	12.1%	373	3.3%	12.3%	330	-11.5%	1.5%	1,379	8.9%
IC 產品產值	1,904	-4.1%	28.2%	2,121	11.4%	19.1%	2,227	5.0%	15.2%	2,102	-5.6%	5.9%	8,354	16.3%
全球半導體成長率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.9%

資料來源：TSIA；工研院 IEK(2015/02)

2010 年~2014 年臺灣 IC 產業產值

億新台幣	2010 年	2010 年 成長率	2011 年	2011 年 成長率	2012 年	2012 年 成長率	2013 年	2013 年 成長率	2014 年	2014 年 成長率
IC 產業產值	17,693	38.3%	15,627	-11.7%	16,342	4.6%	18,886	15.6%	22,033	16.7%
IC 設計業	4,548	17.9%	3,856	-15.2%	4,115	6.7%	4,811	16.9%	5,763	19.8%
IC 製造業	8,997	56.0%	7,867	-12.6%	8,292	5.4%	9,965	20.2%	11,731	17.7%
晶圓代工	5,830	42.8%	5,729	-1.7%	6,483	13.2%	7,592	17.1%	9,140	20.4%
記憶體製造	3,167	88.1%	2,138	-32.5%	1,809	-15.4%	2,373	31.2%	2,591	9.2%
IC 封裝業	2,870	30.6%	2,696	-6.1%	2,720	0.9%	2,844	4.6%	3,160	11.1%
IC 測試業	1,278	32.3%	1,208	-5.5%	1,215	0.6%	1,266	4.2%	1,379	8.9%
IC 產品產值	7,715	39.2%	5,994	-22.3%	5,924	-1.2%	7,184	21.3%	8,354	16.3%
全球半導體成長率	-	31.8%	-	0.4%	-	-2.7%	-	4.8%	-	9.9%

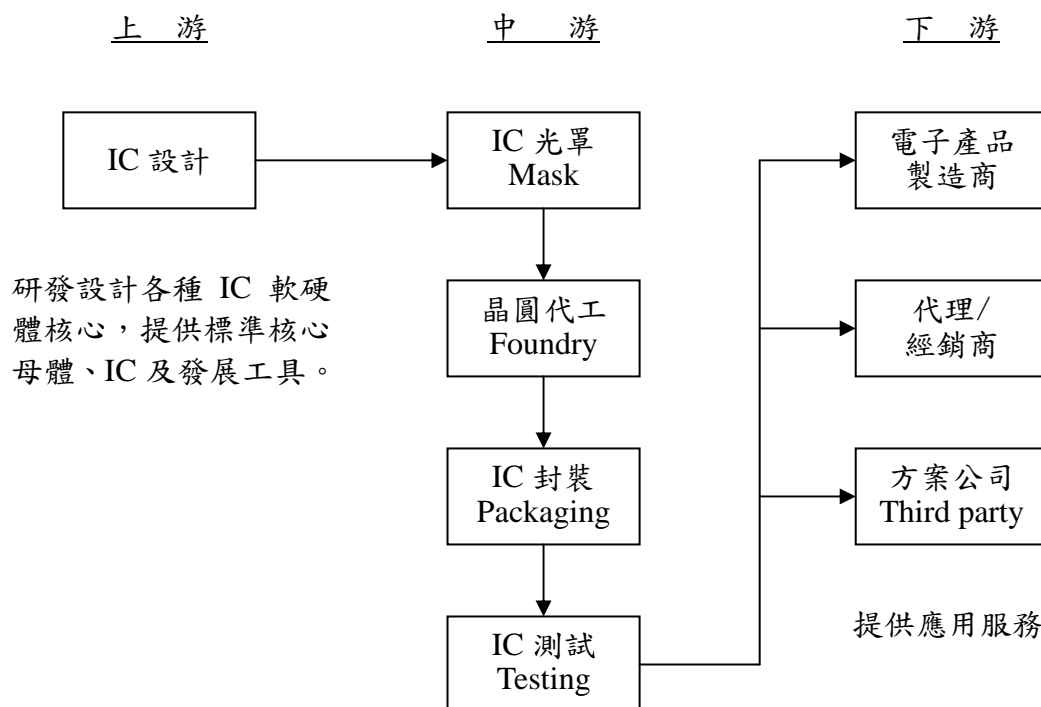
資料來源：TSIA；工研院 IEK(2015/02)

IEK 指出，2014 全年臺灣 IC 產業呈現第一季觸底，第二季為高峰，全年產值為 2 兆 2,033 億元，首度突破 2 兆元大關，並較 2013 年成長 16.7%。IEK 預估，2015 年臺灣 IC 產業將稍微回溫，預估產值為 2 兆 3,330 億元，較 2014 年成長 6.1%。

另外，據調研機構 IC Insights 估計，去年全球 MCU 出貨量達 186 億套，年增 16%，並刷新 2012 年創下的 173 億套最高紀錄；去年 MCU 產值約 159 億美元，年增 5%。在物聯網及穿戴裝置等新應用驅動下，2015 年微控制器(MCU)出貨量則可望首度突破 200 億套關卡，產值達 168 億美元，將創歷史新高紀錄。IC Insights 預期，在物聯網及穿戴裝置等新應用驅動下，今年 MCU 出貨量可望達 209 億套規模，較去年再成長 12%；預估至 2019 年 MCU 出貨量將達 273 億套，2014 至 2019 年年複合成長率將約 7.9%。IC Insights 指出，2014 年約有 3.06 億套 8 位元、16 位元及 32 位元 MCU 應用於物聯網領域，預期 2019 年應用於物聯網領域的 MCU 可望達 14 億套規模。

2. 產業上、中、下游之關聯性

IC 設計產業結構圖



3. 產品之各種發展趨勢

本公司設計之 IC 產品系列齊全，所涵蓋的應用領域非常廣泛，包括電腦、通訊、消費、家電、工業設備、醫療保健與車用電子等領域使用：

主要產品	用 途
RF SoC 微控制器(MCU)產品	無線對講機、電動機車報警、電動腳踏車防盜、智能家居無線防盜。
家電/車載產品類	智能家電、觸控+大功率 A/B 類語音放大器整合觸控 Flash MCU、語音車載後裝。
微控制器(MCU)產品	1. ARM Cortex-M3 為核心之系列 32 位元 MCU。 2. 8051 Code 為核心之系列 MCU。 3. 各式小家電微控制器、家電面板顯示控制 MCU、太陽能溫控器、各類家電觸控按鍵 MCU、汽車防盜器專用 MCU、加解密 MCU、各類 IR 遙控器及拷備型遙控器專用 MCU。 4. 醫療量測類：如血壓計、血糖儀、血氧儀、體溫計、電子體重秤、計價秤、體脂秤、耳溫槍、額溫槍等。 5. 各式紅外線感應器具：如感應水龍頭、給紙機、給皂機、小便斗、垃圾筒等。

主要產品	用 途
電腦產品類	鍵盤、滑鼠、電競鍵盤、USB Bridge 與 USB Fingerprint 等。
顯示器產品類	電錶顯示器、影音&家電顯示器、車用顯示器、電子貨架標籤顯示器、穿戴式產品顯示器。
電源管理產品類	家電電源板卡、充電器、煙感器、行動電源、無線充電、智能電錶、鋰電池個人護理產品(剃鬚刀、鼻毛刀、潔面儀、電推剪)及手電筒等 ASSP MCU。
記憶體產品類	產品應用領域如高解析度電視(HDTV)、數位電視、機上盒(STB)、筆記型電腦、主機板、平板電腦、無線滑鼠、無線網路卡、ADSL、網通產品及各類消費性產品。
智能錶產品類	應用於燃氣錶、水錶及熱能錶量測氣體或液體的流速量測計量 IC、智能電錶主控 MCU 及自動抄錶總線傳輸 IC 等。
金融產品類	動態密碼產生器、挑戰應答動態密碼產生器、智能卡讀卡器、基於貨幣、信用卡、身份證等有掃描辨識需求之相關金融機具，如點驗鈔機、清分機、ATM 機、身份證鑑別儀等，提供高速雙面 CIS 類比前置處理器(AFE)、含 AFE 及影像處理器(ISP)之高速整合型雙面 CIS 處理器、高速貨幣序號(冠字碼)讀出處理器及後台處理器(含網路、SD 卡、USB2.0 Host 等功能)等產品。
物聯網產品類	1. NFC 介面 IC 及 MCU：應用於物聯網，提供電子無線通訊介面，整合手機平板 APP 程式，以便利使用者使用。 2. 基於 WiFi 及 BLE(低功耗藍牙)的物聯網技術，以 32 位元 MCU 提供小家電、健康監控、醫療照護、智慧手環及其他物聯網相關產品完整的解決方案。

(1) RF SoC 微控制器(MCU)：

本公司自行開發的各系列高效能 RF 標準型 SoC Flash MCU，除規劃 Sub 1GHz 於全球 ISM 頻段應用的完整、發射/接收特性穩定外，更整合 Flash MCU 性能、特性與 HOLTEK 標準 MCU 一樣，達到工業規格需求外，獲得國內外多家設計公司及開發採用，無論是在安全防盜、智能家居、後裝電動機車、電動腳踏車及消費性產品應用均獲得很高的評價。因應終端客戶的需求也持續在開發更多種的 RF Flash type 高整合 MCU 產品，無論是發射、接收都提供高傳輸速度、高階靈敏度的特性，並提供參考的整合開發展示板、全方面的客戶方案支持、簡易工程師開發時程與滿足市場與終端客戶的需求。

(2) 家電/車載多媒體產品：

本公司基於語音產品的經驗基礎，持續開發觸摸+大功率 A/B 類語音放大器 SoC Flash MCU 產品，讓外部電路應用器件精簡化及成本最低。並成功發展語音 MCU 開發式平台，讓程式開發者以最簡易的軟體開發平台，快速建立語音錄音、撥放的高效能終端應用。HT66FVXXX/BS66FVXXX 一系列產品，除適合智能語音家電、語音遙控、Baby Monitor、語音車載後裝多媒體等產品應用，

更整合 HOLTEK 第三代的觸控 IC 模組，建立智能電器人機界面最佳選擇 IC。

(3) 微控制器(MCU)產品：

本公司自行研發各系列高效能標準型 MCU，除產品系列規劃齊全。OTP 及 Flash MCU 性能已完全達到工業規格需求，並獲得國內外多家知名廠商採用，經量產證明在穩定性及品質可靠性上均獲得極高的評價，近期更積極開發各種嵌入式 ASSP MCU 產品，以進一步滿足特殊市場各專有應用領域之需求，例如推出移動電源專用 MCU，成功整合所有控制訊號並將充放電路徑結合為一，以及小家電專用 MCU，成功整合小家電電源、控制與顯示功能；此外，逐步提升標準型 MCU 規格，以符合車用電子之需求。

本公司以設計世界級標準型 MCU 及嵌入式 MCU 為目標，除 8 位元 MCU 外，32 位元 MCU 之研究開發，已有初步的成果，目前已有標準型系列產品及應用在馬達控制、指紋辨識及 POS 機等領域產品，並陸續獲得多家公司的採用，應用於遊戲鍵盤/滑鼠、虛擬鍵盤、洗衣機、LED 顯示、電磁爐、電動腳踏車、Barcode Reader、冷凍櫃、安防、醫療、玩具等產品。另外，將新增語音、Crystal-less USB 與外接各種 8080/6800 標準匯流排元件的介面(可外接 Ethernet、SRAM、NOR Flash、LCD Display 等各種 Memory Mapped 的元件)，滿足客戶開發更複雜的系統之需求，未來亦將持續研究開發，以期可應用於更高端的各式產品上。物聯網和穿戴式應用也是本公司關注的項目與目標。

(4) 電腦產品類：

在網際網路和多媒體的推波助瀾下，具備網路電話通訊功能的 USB Audio，以及具備指紋辨識 NB 或 PC 週邊裝置將會逐漸開始蓬勃發展。在與 PC 做資料傳輸應用上，開發 USB to UART/SPI/I²C USB Bridge 系列產品。在居家、商場以及公共場所的安全防護方面，監視攝影 CCTV 有明顯的成長趨勢，另外，汽車安全系統由被動式進展到主動式安全系統，如：車道維持輔助、車道偏移警示、盲點偵測、停車/倒車輔助、車內監視等，在可預期的未來，CCTV 技術將會大量被採用到各式的產品。在 PC 週邊方面，電競鍵盤與滑鼠也有穩定的需求和成長。

(5) 顯示器產品：

本公司的 LCD/VFD 顯示器控制及驅動 IC，在業界具有高品質及領先技術。LCD 顯示器在 2014 年獲大陸及歐美多家電錶客戶認可採用；LCD 新產品新完成加強抗雜訊能力、低耗電、整合多種功能的新 IC，可提供客戶單一完整的方案，並協助客戶降低成本。隨著車廠對車用安全配備的要求提升，車用抬頭顯示器(HUD)未來需求日漸增加，本公司開發使用於車用抬頭顯示器(HUD)的 VFD 顯示器驅動 IC 也完成量產；120V 高壓 VFD 驅動 IC 完成開發並導入量產；加上開發 OLED 多工複合控制 IC，協助客戶提升顯示效果，應用於車載音響及行車資訊顯示板。

(6) 電源管理產品：

本公司基於家電市場應用經驗，開發高壓電源板 ASSP MCU 的產品需求，推出高壓電源板 ASSP MCU。

家電產品普遍以 AC 電源為供電來源，產品設計需轉換 AC 電源(大陸市場以 220V 為標準)到內部元件 DC 低壓電源(通常是 5V)。現今家電普遍為智能系統，大量引入 MCU 控制功能零件。然而，功能實現(如：加熱、風扇開關、聲響警報、轉盤驅動、刀具轉動等)實際是以高壓驅動，由於設計考量在電源板上架構，最為合理，形成高壓電源板 ASSP MCU 開發。

在市售家電產品，如：電磁爐、電飯煲、電陶爐、壓力鍋等眾多產品，都是引用電源板做法。藉由電源板專門控制產品主體功能，可簡化產品組件，更可以共用組件，提高開發效率。

無論電子資訊產品、相關週邊產品、數位技術之進步及網路系統整合如何發展，電源管理始終是此類商品重要的核心之一，終端商品不斷要求以最精簡的電路，產出最高效率電源，正是電源管理 IC 不容易被淘汰，也無法被取代的利基之一，電源管理 IC 未來仍是半導體產業中穩定成長的明星產業。

隨著對環保與節能議題的關注，節能科技已成為世界焦點，未來產業無法置外於此議題，以臺灣傳統類比 IC 廠商多集中於 DC/DC，本公司另闢 AC/DC 領域，即看好此一節能應用。在全面改用太陽能、風力等綠能之前，改善目前傳統電力的耗費及節能，更能直接有效降低地球溫度，除低耗電、極低的靜態消耗電流等需求外，低耗電使用無鹵封裝製程亦是世界各國對環保、低耗能等綠色概念的要求重點，而電源管理 IC 同時也必須考量未來環保法規帶來的限制，所以符合環保及綠色能源將成為電源控制與管理 IC 設計的重要方向。

(7) 記憶體產品：

記憶體為 IC 產業上重要的一環，其中非揮發性記憶體成長迅速，本公司專業以非揮發性的 EEPROM 為主力產品，EEPROM 從 1~256K bit，應用於一般電腦、通訊和消費性產品上。

(8) 智能錶產品類：

超聲波流量計 ASSP MCU：本公司基於 MCU 計量錶應用經驗，開發超聲波流量量測 ASSP MCU；除提供超聲波流體量測技術，更整合 MCU 控制及運算功能，開發出智能錶標準 MCU。應用於燃氣錶、水錶及熱能錶。藉以超聲波量測氣體及液體的流速，精準計算出使用燃氣、水與熱量的使用量，提供可靠的量測數據。超聲波在流體流速量測上，屬於電子式，無機械裝置，沒有機件耗損及退化問題，能有較高的使用壽命，與更精準及可信賴的量測結果，更適合以 IC 整合方式來呈現。本公司推出的超聲波流量計 ASSP MCU 秉承前述重點，更在可靠度及穩定度上累積經驗及技術，所推出的 IC 更在功耗上精益求精，無不以超越標準使用年限來開發，形成更具競爭力的成本優勢。

高壓總線傳輸 IC：本公司基於智能錶市場的應用經驗，瞭解總線(BUS)系統的重要性。由於各國政府在公共事業上的發展迅速，家用民生必需資源(如：水、電、燃氣及熱能)快速膨脹，帶動民生必需資源量測的進步。以往人工抄錶的佈建，慢慢被電子抄錶系統取代；電子抄錶系統以有線傳輸最為可靠，而總線系統是有線傳輸的基礎；最具代表性的系統為 MBus，因其僅利用兩線傳輸電力與訊號，且無極性問題，是相當優良的設計。本公司基於 MBus 的架構，發展高壓總線傳輸 IC，普遍應用於：煙感器、水錶、熱能錶、燃氣錶等。

(9) 金融產品：

在金融產品方面，使用於網路銀行的 e-Banking 產品，如動態密碼產生器、挑戰應答動態密碼產生器、智能卡讀卡器的需求將穩定成長。金融機具包括“現金流”和“票據流”兩類，前者如 ATM 機、清分機等，後者如支付密碼器等。從中國市場來看，基於國家安全的考量，國有化的替代進程正在加速，未來相關產品將有爆發式的增長。如目前 ATM 機超過 50 萬台，每年市場容量約 100 億人民幣，預計未來三年的需求仍保持 20%~30% 的增速，以替代目前外資品牌的 60% 佔有率來看，替代市場將釋放巨大的需求。

本公司基於貨幣、身份證等有掃描辨識或貨幣序號讀出需求之相關金融機具，如點驗鈔機、清分機、ATM 機、身份證鑑別儀等，除提供高速的 CIS 類比前置處理器(AFE)外，並整合時序控制、傳感校正及支援平滑去噪、線平均、直方圖等影像處理功能，大幅降低產品成本，而且將進一步提供高速貨幣序號(冠字碼)讀出暨影像辨識的專用處理器與含網路、SD 卡、USB2.0 Host 等功能的後台處理器。

(10) 物聯網產品：

本公司基於物聯網市場應用經驗，瞭解 NFC 無線介面 IC 產品需要，推出 NFC 介面 IC 及 MCU。藉由 NFC 無線介面，可使手機或平板的 APP 直接存取並設置及控制電子裝置(如：音響、微波爐、烤箱、洗衣機等)，特別是修改控制程序配合系統運作(如：WiFi)，達到智慧控制及操作。

根據 2014 年 IDC 物聯網趨勢分析指出，2016 年物聯網市場規模將達 2.9 兆美元，超越傳統嵌入式(Traditional Embedded System)和智慧型系統(Intelligent Systems)的市場規模，並預期 2020 年後，物聯網裝置的總數將達 250 億個。

本公司基於 WiFi 及 BLE(低功耗藍牙)的物聯網技術，以 32 位元 MCU 提供小家電、健康監控、醫療照護、智慧手環及其他各種物聯網相關產品完整的解決方案，並協助客戶提升物聯網服務的價值。

4. 競爭情形

臺灣 IC 設計業適逢天時、地利、人和之有利因素，大大小小總計成立超過 400 多家公司，分別在不同領域發揮其所長。然而由於技術背景相似、市場目標雷同、產品重疊性高等因素，致使同業間之空前激烈競爭。

另外不容忽視的超級競爭對手—大陸 IC 設計業者，在中國政府支持發展下也在迅速地茁壯，未來臺灣業者如無法持續將現有產品進行轉型/技術提升或提供更具有競爭的產品與方案，那麼將難逃被淘汰之命運。

此外東歐與其他東南亞等開發中國家也看好此一產業，紛紛由政府大力獎勵與支援，以培植重點產業之型態持續努力中，亦十分值得留意。

(三) 技術及研發概況

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年度	103 年度	104 年第一季
研發費用	658,023	150,778
營業收入	3,930,519	878,241
研發費用佔營業收入比率(%)	17%	17%

註 1：當年度截至 104 年 3 月 31 日之財報資料為經會計師核閱之合併財務資料

2. 開發成功之技術或產品

本公司以每年約營業額的 15%~20% 投入新產品與新技術研發，藉由新產品的加入來維持公司營業額的成長與利潤的提升。

一〇三年度主要的研發成果以微控制器為核心，搭配週邊 IC 系列，提供完整解決方案暨滿意之整體服務。依應用分類概述於下：

(1) 新一代 8 位元 MCU

- A. 1.8V~5.5V 低工作電壓 Flash 型系列：支援更低的工作電壓，內建 AD 及 LCD 功能，適用電池類產品。
- B. 內建多級放大器、比較器及穩壓器 MCU：節省 PCB 板的空間並簡化電路架構，縮小應用產品體積，具有節省成本及生產方便等優勢，適合各種需要信號放大的產品應用，例如遙控器、倒車雷達、測距儀、玩具、機器人、量測儀器等。
- C. 觸控按鍵微控制器系列：觸控按鍵微控制器系列，搭上觸控產品熱潮，適合各式觸控產品使用，除已經推出的 OTP MCU 系列外，另開發出 Flash MCU 系列，可多次 ICP(In Circuit Programming)燒寫，並內建 EEPROM，便於修改程序、參數調整與設定更改，提供客戶最方便的開發平台與最具競爭力產品。
- D. 低耗電標準型系列(TinyPower™ MCU)：本系列產品具備與國際大廠同等級之低耗電能力，符合環保潮流，適合於各種採用電池電源之可攜式產品。
- E. A/D Flash MCU with EEPROM 系列：繼推出 I/O Flash MCU 與 A/D Flash MCU，繼續開發出 AD with LCD MCU，擴展至有顯示的應用領域，產品具有廣泛應用之功能。程式記憶體可重複燒錄次數高達 10 萬次，內建的 EEPROM 資料記憶體更高達 100 萬次。

- F. 醫療保健產品，鎖定血壓、血糖、血氧、體溫、體重與體脂肪等醫療、保健與照護等相關產品，陸續開發出專用 MCU，除高度集成現有外部元器件外，並提供更高解析度的 24 位元 ADC 與先進 USB 與語音介面，簡化對於遠距照護產品的設計，提高老年人口使用方便性。
- G. 完成伺服馬達(Servo Motor，或稱為舵機)專用 MCU 開發，應用於航空模型、小型機器人等產品。
- H. 完成無刷直流馬達(BLDC - Brushless DC Motor)控制 MCU，應用於節能風扇上，達到節能、線性控速與低噪音效果。
- I. 完成 OCDS(On Chip Debug System)開發，使客戶產品開發更方便，貼近實際量產狀況。

以上各系列 MCU 最低均達工業等級規格(工作溫度範圍達到-40℃~+85℃)，抗雜訊能力與歐美日領導廠商之產品品質同級，產品品質已獲得廣泛客戶的認可。

(2) 消費性產品

- A. Flash Type Voice MCU：整合 16 位元 ADC/DAC 等類比 IP 並提供 SPI 介面，內建硬體語音壓縮等相關技術，減化客戶應用技術門檻，提高產品的便利性。
- B. Touch + Voice Flash MCU：整合 16 位元 ADC/DAC 等類比 IP 並提供 SPI 介面，軟體語音解壓縮技術，並內置 HOLTEK 第三代電容式觸控按鍵使用，及軟體 LCD 功能。減化客戶應用技術門檻及整合多項分離 IC 器件應用，提高產品的便利性及完整性。
- C. Touch + LCD/LED Flash MCU：結合第三代電容式觸控按鍵，直接驅動 LCD 及大電流 LED，內置 UART 串列式通信界面、RTC 實時時鐘功能與高精度 12bits 的模數轉換，除一般消費性產品使用外，並適用於工業用溫控器等工業產品。
- D. 電源管理產品：
 - (A) $\pm 3\%$ 精準度 30mA/100mA/250mA/300mA/500mA 低功耗穩壓 IC：廣泛使用於各類型電子產品，如：可攜式或插電式省電型產品等，可延長電池壽命及達到綠色節能效果。
 - (B) $\pm 1\%$ 精準度 30mA/100mA 低功耗穩壓 IC：提供高輸入耐壓及低功耗電源穩壓 IC，精準的輸出電壓可提升系統產品特性，適合用於更高階電子產品。
 - (C) 100mA/200mA/300mA/350mA 同步整流直流升壓轉換：使用於可攜式高效率需求產品。
 - (D) 2A/3A 非同步 Step-Down DC-DC：使用於直流降壓大電流輸出產品，如網通、數位相框、LCD TV、USB 充電等產品。
 - (E) AC-DC Converter IC：應用在市電(交流電)轉換成直流電的家電產品，包括電磁爐、電陶爐、咖啡機、電飯煲電源等。
 - (F) LED 照明驅動 IC：使用於一般 LED 照明，可應用在 T8 燈管、E27 球泡燈等。

- E. Real Time Clock IC：可使用在各種需要計數時間的產品，例如：電錶、水錶、煤氣錶、考勤及門禁設備、計費電話、收銀機、MP3、數位相框、辦公室自動化產品、家電產品、電腦產品等。
- F. Remote Control Encoder IC：可使用在汽車防盜、機車/電動車防盜、家庭防盜及大門、窗簾、門鈴、家電之遙控。
- G. 超聲波流量計 ASSP MCU：整合 TDC 等類比 IP 並提供通訊介面(SPI/UART/I²C)，內建流量演算法及溫度量測等相關技術。降低客戶應用技術門檻，提高產品的便利性。
- H. 高壓總線傳輸 IC：整合電壓調變資料輸入及電流調變資料輸出等類比 IP，提供解調輸入資料及調變資料輸出功能；符合總線資料傳輸應用，提高產品的便利性及完整性。
- I. 高壓電源板 ASSP MCU：整合高壓 LDO 及高壓 IO 驅動電路等類比 IP，內建安全規範處理程式，執行短路保護及系統異常處置；提供 UART/I²C 介面，與控制面板溝通；簡化客戶應用介面，以模組化降低開發複雜度，提高產品便利性及完整度。
- J. NFC 介面 IC 及 MCU：整合 NFC AFE 介面等 IP，內建 ISO 14443 及 NFC 標準，開發系列產品，從單介面 NFC TAG，到多介面 TAG，乃至加密功能。提供便利功能，強化產品競爭力。

(3) 電腦週邊產品

- A. USB 2.0 Full Speed MCU 系列。
- B. USB Bridge 系列 IC。
- C. 多媒體產品：
 - (A)USB Speaker：USB 2.0 full speed 支援立體聲喇叭。
 - (B)Wireless USB Audio：USB 2.0 full speed 內建 ADPCM 硬體壓縮電路，支援 2.4G 無線通信介面。
- D. 高速 CIS 類比前置處理器(AFE)。
- E. 內含計算機鍵盤控制器：支援 USB 暨計算機之功能。
- F. 指紋辨識 MCU。
- G. USB 2.0 Full Speed MCU 系列。
- H. USB Bridge 系列 IC。
- I. 高清(960H)CCD 監控攝影機 MCU。
- J. 高速 CIS 類比前置處理器(AFE)。

(4) 無線產品

- A. 無線對講機控制器：內建 DSP 與音頻類比電路之 SoC Flash MCU，適用於類比式專用及 FRS 對講機。
- B. 無線遙控器：整合 315M/433M/868M/915MHz ISM 頻段之 RF 發射電路與編碼器，ASK/OOK/FSK/GFSK 調制方式之遙控器，並內置高性能 Flash MCU，結合 RF 及 MCU 控制為一體的 SoC IC。
- C. 無線控制器：315M/433M/868M/915MHz RF 接收超再生及超外差模式電路，解調 OOK/FSK 接收及 Flash MCU 應用合一，適合搭配無線發射遙控器產品，作為整合性單向、雙向控制應用。

D. 2.4GHz 無線 MCU：整合 2.4G RF 電路之 Flash MCU，適用於具備抗干擾能力、雙向傳輸等應用。

- (5) 32 位元標準型 MCU 系列：新增 External Bus Interface (EBI)、I²S 界面與 CRC-16/32，EBI 可提供客戶系統的擴充性如外擴 NOR Flash、SRAM、LCD Panel 8080/6800 Modes 及各種 Memory Mapped 的元件。I²S 方便客戶開發多媒體語音應用相關產品，CRC-16/32 則可加速客戶開發的產品取得歐盟家電產品安規認證；新增 Crystal-less USB 的功能可降低客戶開發產品成本。

(四) 長短期業務發展計畫

1. 短期發展計畫

(1)行銷與營運策略

本公司自 1983 年投入半導體 IC 設計領域以來，所成立的團隊以及多年累積的豐富智財權、專利，並擁有數家前段晶圓廠及後段封裝測試廠的全力支援下，同時在臺灣/中國/美國建立當地銷售及技術服務據點。因此，本公司足以提供客戶：

- A. 最好的產品品質(高品質靜電破壞保護及抗雜訊能力)。
- B. 最短的產品交期。
- C. 最佳性價比產品。
- D. 提供一次寫入式(OTP)與多次寫入式(Flash)微控制器產品。
- E. 最快速的在地化技術服務。
- F. 彈性的 ASSP & ASIC 微控制器開發服務。
- G. 專業開發工具與高效 C 語言編譯器。

本公司將持續專注於 MCU 及其週邊 IC 開發，目標設定為世界級的 MCU 供應領導廠商，其中 MCU 業績比重目標佔總營業額之七成，此目標已於 2014 年達到，2014 年的 8 位元 MCU 世界排名也連續三年上升至 11 名，為兩岸三地第一品牌。

(2)生產策略：

- A. 維繫與主要晶圓代工廠、封裝廠、測試廠等外包廠商之合作關係，以爭取充足之產能及成本之競爭力。
- B. 建立與合作廠商之生產相關資訊，以便即時掌控生產的進度及數量，達到降低庫存與有效備貨的目標。

(3)產品策略：

- A. 本公司產品發展定位在以 8/32 位元微控制器 IC 為主，加上微控制器週邊 IC 為輔的架構上，提供客戶多元化的彈性選擇。一次購足的便利性以及優異的性能與價格比，使客戶的產品具有強大之市場競爭力。
- B. 維持與客戶合作開發未來產品，領先同業推出具競爭力之方案。

(4)研發策略：

本公司將 MCU 核心架構在不同製程平台，並搭配特殊 IP 技術，達到小型化 SoC，在整合過程加強抗雜訊能力與靜電防護能力，達到美、日、歐 MCU 供應商相同工規的技術水準。

2. 長期發展計畫

(1)行銷與營運策略

公司發展策略鎖定以家電、醫療、金融與汽車領域為發展市場，並經由專注研發高品質微控制器開拓國際市場，優異的產品品質與快速的在地服務，不但滿足全球客戶的需求，亦已成功將 HOLTEK 微控制器順利導入全球著名家電大廠，建立起 HOLTEK 全球化的專業品牌形象。除了於家電積極拓展市場成績斐然之外，醫療、金融與汽車領域皆將依循此模式發展。公司在 8 位元 MCU 已獲得大廠的認同並導入量產，除了持續精進 8 位元 MCU 產品外，長期亦將持續導入 32 位元 MCU，持續將市佔率擴大，期許能進入 MCU 全球排名前十大廠商。

(2)生產策略：

- A. 針對產業淡旺季循環做及早的因應，降低其衝擊。
- B. 持續使用先進製程，降低成本，建立成本優勢。

(3)產品策略：

- A. 鎖定國內外大廠與具有潛力的市場，進行產品推廣及服務。
- B. 切入更高階之應用領域，如高階大小家電、醫療保健、家用三錶、工業設備、安全防護、車用電子、金融加密產品等設備領域。

(4)研發策略：

提升產品設計能力，建立規格化與模組化之開發技術，減少開發時程與開發成本，加速新產品上市之時間並提高價格競爭力。

(5)產品發展項目：

- A. 發展 ASSP MCU 專用型系列：依產品專用需求規格設計 MCU。
- B. 發展全系列 1.8V~5.5V A/D 型及 LCD 型 Flash MCU，擴充更寬廣的電壓應用領域。
- C. 發展全系列 Tiny Power MCU：整合 Tiny Power 技術於各式 MCU 中降低功耗，達成節能效益。
- D. 發展全系列 Flash MCU：如 I/O、A/D、LCD、A/D with LCD、Tiny Power MCU，提供客戶多樣選擇。
- E. 發展更多應用在醫療量測領域的專用 MCU：如血糖儀、血壓計、體脂計、血氧計等應用。
- F. 發展觸控面板專用 MCU，擴大觸控應用領域。

- G. 發展更高階 IP 整合之 MCU:邁向更高階解析度類比數位轉換(24 位元 Delta Sigma AD Converter)。
- H. 發展局部鎖住(Partial Lock)標準型 MCU:局部鎖住 MCU 提供方案公司彈性的智慧財產保護機制，滿足多方分工但各自保密需求，保護具特殊專才供應商智慧財產，刺激產業正面發展，產品應用多樣化，進而擴大市場需求。
- I. 發展 PC 週邊 USB 產品：除了持續發展 PC 週邊 Keyboard/Mouse 外，規劃 USB Full Speed 系列 MCU，並擴大 USB 產品應用，如 USB Speaker/USB Phone/Fingerprint/USB Charger/USB Gaming MS & KB/USB Bridge 等。
- J. 發展更具競爭力 Voice MCU：提供更多播放/錄音功能的 Voice MCU，方便客戶開發更高品質的消費性商品，含高功率 1.2W 以上 A/B 類功放整合 Voice 控制及帶電容式觸控 MCU 產品。
- K. 發展更具競爭力 Music MCU：提供更多通道的 Music MCU，方便客戶開發更高品質的 Music 產品。
- L. 發展全系列高壓 12V A/D 型 Flash MCU：內含 LDO 穩壓電路及高壓輸出，可直接推動繼電器等控制元件。
- M.發展整合型 Sub1GHz RF SoC Flash MCU 產品。
- N. 發展適用於各項通訊技術之 MCU：如通用型 2.4GHz、電力線傳輸、FRS、Zigbee、UHF 頻段無線通訊等技術以衍生出各式各樣的應用產品，開發適用於此類 SoC 應用產品的 MCU 為未來之發展方向之一。
- O. 發展更高容量程式記憶體標準型 MCU。
- P. 發展 32 位元多腳位標準型 MCU 系列：新增 External Bus Interface，方便客戶系統的擴充性如外擴 NOR Flash、SRAM、LCD Panel 8080/6800 Modes 及各種 Memory Mapped 的元件。
- Q. 發展新一代 32 位元馬達控制及指紋辨識系列 MCU：提升運行速度至 96MHz，系統記憶體 Flash 與 SRAM 都加大一倍，以擴大市場的覆蓋率。另外，新增 AES 加解密功能、CRC 運算功能及 I²S 語音應用界面與 SDIO 及 EBI 界面，可方便客戶開發各種具語音多媒體功能與有線/無線資料傳輸等功能的相關產品。
- R. 發展 32 位元低功耗標準型 MCU 系列並結合各項無線傳輸技術：目標是應用在物聯網與穿戴式設備。
- S. 開發電子貨架標籤(ESL)面板顯示驅動 IC：配合電子紙及 LCD 客戶開發專用 IC。
- T. 發展 CCTV 完整方案：開發系列 Vertical Driver/AFE/Back-end 等 IC，提供客戶完整方案。
- U. 發展更高規格的 LDO 產品：如更大電流 250mA 輸出與帶有過流、過溫以及逆向電流保護機制之 LDO 系列 IC。

- V. 發展高輸出電流之 DC/DC 同步升壓轉換器：採用散熱極佳之封裝技術，高度整合外部功率元件，高效率、低功耗與極少的外部元件特色，十分適用於體積限制之行動裝置，如行動電源等產品。
- W. 發展 AC-DC 電源管理產品線：整合 PWM 及 PFC 的高效率 AC-DC 轉換器。
- X. 發展小瓦數低成本的 AC-DC 電源管理產品線：整合高壓 MOS(700V) 節省整體電路元件及提供系統可靠度的 IC，目標是應用在小瓦數充電器、手持式裝置充電器以及小瓦數家電。
- Y. 開發下一代移動電源專用管理 IC，搭配硬體電路達成更快速的負載動態響應變化，整合更多的外部電路零件，如提供內部 1% 精準電壓源等，使產品整體電路更精簡，達到產品成本降低，效能提升的高競爭力產品。
- Z. 發展更低功耗的產品延伸：適合目前越來越多流行商品以電池為電源之可攜式產品使用。
- AA. 發展中、低功率鋰電池充、放電管理及驅動控制之整合型 ASSP MCU：內置多路 PWM 控制，可驅動 DC/DC 升壓/降壓電路及負載驅動，內建硬體 OCP 過流保護及 OVP 過壓保護，有效保護鋰電池充、放電的安全性；適用各種鋰電池驅動產品，如個人護理(剃鬚刀、鼻毛刀、潔面儀、電推剪)及手電筒等產品。
- BB. 發展電動工具電源管理 ASSP MCU：包括多串(6 串)鋰電池充電管理 ASSP MCU、電動工具調速開關 ASSP MCU 等產品。
- CC. 開發無線充電 ASSP MCU：現已取得 WPC Qi 認證，並持續研發符合 A4WP 磁共振式無線充電技術的 ASSP MCU。
- DD. 開發各類傳感器量測 ASSP MCU：如胎壓計、溫度計、濕度計等產品。
- EE. 開發高速的貨幣序號讀出暨影像辨識方案：整合高速雙面 CIS 類比前端處理器(AFE)、CIS 模組時序控制及傳感校正等電路，並支援平滑去噪、線平均及直方圖等影像處理的功能，以取代原本的 FPGA，並大幅降低產品成本，且產品的電路更為精簡，適合點驗鈔機、清分機、ATM 機等需要高速貨幣序號讀出的應用。
- FF. 開發 32 位元 MCU 之物聯網應用平台：基於智能家庭及生活應用，整合物聯網核心軟體、各式感測器及控制介面，提供完整的物聯網應用方案。
- GG. 發展 32 位元 MCU 之低功耗藍牙應用平台：基於健康醫療及穿戴式設備，整合低功耗藍牙軟體、各式感測器及控制介面，提供完整的低功耗藍牙方案。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要產品之銷售地區

本公司 103 年度銷售地區分佈如下表所示：

單位：新台幣仟元

區域 \ 年度	103 年度	
	銷售額	%
臺灣地區	538,807	14
中國地區	2,695,798	68
其他海外地區	695,914	18
合計	3,930,519	100

2. 市場佔有率

本公司專注於微控制器(MCU)與週邊半導體器件產品之開發，相關產品之應用涵蓋範圍廣大，除了消費(Consumer)、通訊(Communication)、電腦(Computer)及汽車(Car)等 4C 相關領域之外，尚包含非揮發性記憶體 IC、顯示驅動 IC、電源管理 IC、類比 IC、ASSP/ASIC MCU 等，每一類型均已佔有市場一席之地。根據 Gartner(2014)調研報告指出，本公司 2013 年於全球 8 位元 MCU 廠商營收排名第十一名，亦為兩岸三地品牌的第一名，前面 10 名皆為國際大廠。本公司在 2014 年成功取代美系、韓系、日系 MCU 廠，於大陸 8 位元 MCU 市場市佔提升，並成功切入 32 位元 MCU 市場。

自三星退出 8 位元、瑞薩退出 4 位元的 MCU 市場後，本公司與各國國際大廠在大陸競爭低位元數的 MCU 市場，本公司以高性價比的 8 位元 MCU 取代國際廠商，順利擴大在大陸的市佔率。本公司 2014 年 MCU 總出貨量較前一年約成長 13%，依據業內估算，本公司在全球市佔率在 2014 年將首度突破 5%，並在 2015 年持續推升，目標於 2015 全年出貨量將挑戰 5 億顆的門檻，持續增加相關國際大廠既有的市佔率。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

(1) 供需狀況

工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)指出，在行動裝置的需求推升下，2015 年臺灣半導體業產值可望較今年成長 6.1%。物聯網將是下一個驅動半導體業快速成長的主要動力，商機可望於三到五年內普及於各領域。工研院產經中心(IEK)分析，未來十年物聯網在九大領域有龐大市場潛力，分別是能源、車載、物流、安全監控、零售、醫療衛生、建築及消費電子等。

IEK 指出，搭上物聯網順風車的半導體廠，應可維持快速成長，且超越整體半導體業，整體物聯網產品數量在 2020 年將高達 330 億個，將創造出下一波半導體市場需求的成長。就產品面來說，臺灣 IC 業者除已在智慧手持裝置晶片、網通晶片等市場獲得不錯成果，面對未來物聯網與情境感知應用的逐漸發酵，不僅對臺灣 IC 龍頭大廠，也預期將對臺灣中小型或新創 IC 業者創造更多的市場契機。

就供給面而言，資策會 MIC 統計，2014 年臺灣 IC 製造產業產值可達新台

幣 11,550 億元，較 2013 年成長 19%。資策會 MIC 表示，臺灣晶圓代工產業受惠於行動通訊產品需求，28 奈米以下先進製程產值持續成長，且面板驅動 IC、指紋辨識等應用帶動成熟製程市場發展，主要業者產能均達滿載，以及記憶體供需趨於均衡，價格恢復穩定，帶動臺灣 IC 製造業產值大幅成長。展望 2015 年，臺灣晶圓代工市場在 20 奈米以下製程比重將持續提升，預期仍維持兩位數的成長表現。在記憶體產業方面，因供需趨於平衡，價格回穩，產值恐有下滑空間。整體而言，2015 年臺灣 IC 製造產業產值預估可達新台幣 12,236 億元，其中，晶圓代工產業的成長幅度可達將近 10%。

在封測產業方面，2014 年臺灣 IC 封測產業在通訊晶片及消費性電子產品之需求帶動下，整體封測產值呈現成長態勢。其中，4K2K 大電視帶動面板驅動 IC 使用數量增加，指紋辨識、MEMS 感測器等新產品，則帶動高階封裝製程需求增加。資策會 MIC 預估，2014 年臺灣封測產業產值約新台幣 4,070 億元，較 2013 年成長 11%。

在 Apple Watch、物聯網等新產品、新應用的帶動下，預期 2015 年全球半導體市場規模約可達 3,363 億美元，較 2014 年成長 3.1%。臺灣半導體產業方面，在中低階智慧型手機需求持續增長下，以及新款智慧型手持產品與穿戴裝置帶動臺灣供應鏈出貨，預期 2015 年臺灣半導體產業產值將達 2 兆 3330 億元新台幣，成長率約 6%，優於全球平均水準。整體觀察，2015 全球半導體產業可較去年成長 5% 左右，後段封測產業年成長幅度，在 7% 到 8% 之間。2015 年封測台廠可望在先進封裝以及物聯網和穿戴裝置應用帶動下，表現可優於半導體產業平均水準，呈現逐季升溫態勢。

(2) 未來成長性

若以全球 MCU 出貨量觀察，IC Insights 指出，2014 年相較於 2013 年衰退 7%，2014 年 MCU 出貨的動能則來自電子銀行、ATM、大眾運輸、以及安全應用的需求揚升，帶動智慧卡相關的 8 位元、32 位元 MCU 出貨反彈。面對未來物聯網、智慧家居、健康照護、節能環保、穿戴式裝置、行動支付等產業發展趨勢，本公司透過新晶片為營運成長增添動能，包括有高整合性的 Touch Key，其整合觸控感測、MCU、ADC、放大器，還有周邊元件 LDO 等的整合型 MCU，另外，還有已通過無線充電聯盟 Qi 認證的無線充電專用的 MCU 模組、醫療專用 MCU 以及強調節能環保的無刷直流馬達專用 MCU。2014 年本公司全年 MCU 出貨量達 4.66 億顆，較前一年度成長約 8%，再創年出貨量歷史新高，其中仍以 8 位元產品為主。展望 2015 年，隨著物聯網新應用市場需求在今年明顯增溫，加上去年完成卡位的安防、銀行金融等應用市場穩定成長，本公司年度 MCU 的年出貨量目標朝向 5 億顆的門檻挑戰。

物聯網市場對 MCU 而言是一塊新興且巨大的藍海市場，但反應在業績上，因需要佈局的市場廣泛，不會迅速大爆發，而是逐步墊高成長。以 2015 年來看，本公司將會在穿戴式裝置及智慧家居這兩個市場收成，其中智慧家居因為陸系家電廠商積極佈局，也將有助於本公司在 32 位元 MCU 市場上挑戰

國際大廠。

在物聯網、穿戴裝置等應用為 MCU 開闢全新出海口的帶動下，電子裝置中勢必需要更多的 MCU 來做運算與控制。另外智慧家居及安全防護也是重點領域之一，包括煙感器/指紋辨識，也是 MCU 重點發展的方向之一。隨著醫療電子、安防電子以及各個行業的資訊化建設的持續深入，應用於這些行業的積體電路產品所占的市場比重將會越來越多。

4. 競爭利基

IC 設計業為高度智慧型、腦力密集且技術層次高的行業，充足的研發人才、電腦輔助設計和測試設備成為 IC 設計業的基本重要條件。

本公司歷經多年的經營，累積豐富的人才、技術研發和產品應用經驗，具體掌握核心技術，產品系列完整且多樣化且不斷推出新創意，新產品均以擁有更強功能、更高品質、更低價格、符合客戶的需求和具備市場競爭力為整體發展目標。

(1) 研發能力強，產品領先群倫：

長期積極開發人力資源，延攬國內外優秀設計人員，並透過教育訓練，傳授技巧累積經驗，分工合作建立有效率的研發團隊，延續並發揚技術之優勢，開發更新更有競爭力的 IC。

(2) 更新輔助設計器材與測試設備：

藉由精密的儀器設備，提升人員的工作效率，產品的穩定性和可靠性，並藉由客戶和市場之互動，開發出符合市場之高技術的應用 IC。

(3) 完整的全球行銷網路：

擁有臺灣、香港、深圳、東莞、廈門、上海、蘇州、杭州、北京、成都、青島、美國和東北亞、東南亞、南美洲、歐洲等世界各地的代理或經銷網，可迅速的蒐集市場訊息，掌握先機，並透過國內外銷售據點，做到快速的銷售和售後服務與技術支援。

(4) 上游工廠關係穩固：

與上游晶圓代工、封裝、測試工廠關係良好，除了確保貨源穩定供應不缺外，更能以長期合作、大量生產獲得較低的價格優勢，提高本公司之長期競爭力。

(5) 管理制度良好：

本公司取得 ISO9001 及 ISO14001 品質認證，所有作業系統流程都有標準化和規格化的管理，產品品質穩定深受客戶滿意。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

大部份 IC 設計業均以特定產業或專業產品來經營市場，由於資源集中且經驗累積迅速，在專業產品上較具優勢，但是面對強力競爭者挑戰或市場大變動時，其穩健度與反應能力就遠不及能提供不同應用及不同客戶需求的設計公司。因此，本公司即以提供各項產品應用與全方位服務為發展目標，目

前掌握之競爭優勢如下：

A. 領先且完整的產品系列

- (A) 由於自有 IP 日益豐富與設計能力提升，可按客戶需求快速提供 ASSP/ASIC MCU 等集成度高的 IC，並提供參考設計的完整解決方案，增加 IC 功能與客戶產品的競爭力。
- (B) 產品橫跨多種產業，可有效降低市場風險。
- (C) 公司的營業成長目標較具空間與彈性。

B. 全球行銷網的建立

- (A) 有效建立區域行銷據點，以提供及時且在地化的產品技術服務，更能正確反應市場需求；在地化服務包含發展工具、FAE、安規驗證、軟體服務等。
- (B) 長期建立的經銷體系已遍佈全球，順暢的行銷管道有助於整體產品的推展與營業額的擴張，並已獲美/歐/日/韓等國際大廠認證並採用。
- (C) 持續重視客戶的開發與維護，以奠定穩健的市場基石。
- (D) 產銷的結合，積極與客戶培養長期性互惠支援關係。
- (E) 與上下游產業結盟以強化依存性及競爭力。
- (F) 藉電腦化支援系統，使預估銷售需求、生產下線排程、庫存、委外加工等作業皆能充分發揮產銷協調之功能，有效的產品速動管制作業使達到成本最低化、產值最大化、服務最佳化成果。

C. 產品開發能力

- (A) 多年經驗累積之優良研發技術。
- (B) 強大的研發團隊。
- (C) 藉由策略性合作、產學合作等方式引進新技術，加速產品及技術升級。

D. 整體環境支援

- (A) 產業支援集中，可增強經營效益。
- (B) 產業專業分工，可增高合作及依存性。
- (C) 產業整合度高且競爭性強，可提升產品優勢。

(2) 不利因素及因應之道

- A. 國內外產品相似性太高，造成惡性競爭而獲利降低，必須提升產品技術層次及產品品質以避開衝突，並開發系列性產品及 ASSP 產品以滿足各種客戶需求，以取得獨特優勢。
- B. 歐美大廠產品壓低售價的競爭，將以優勢的性價比，並配合以更好更迅速的服務及提供完整的設計方案，取得客戶的認同與採用。
- C. 產品生命週期縮短，開發費用增高，所以開發環境的改善及市場資訊的蒐集務求又快又準，以取得先機。
- D. 面對整合元件廠的強力競爭，必須與晶圓代工廠及封裝測試廠商策略聯盟以取得必要之競爭能力。
- E. 在智慧財產權保護聲浪高漲下，IC 設計業生存空間縮小，必須持續增加智

財權實力，努力提升產品之主導性。

- F. 面臨大陸設計業的蓬勃，加上蓄意對智財權的忽視，臺灣 IC 設計同業均已受到威脅與影響，本公司除更積極於產品的發展動作，以產品轉型、多樣化及提升更高品質來鞏固市場外，更透過法律途徑保障本公司權益。
- G. 部份客戶對臺灣品牌初期採用的信心度可能較低，本公司選擇合適之客戶進行長期合作，達到量產階段，以提升本公司在此產業之知名度。另外產品組合不足部份，短期作法為積極尋求產品有互補性之廠商進行策略聯盟，共同推廣市場；長期則將透過技術引進等作法，來增加產品範圍之完整性與廣度。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

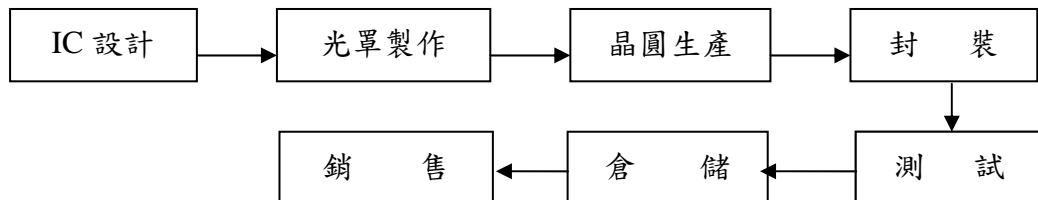
1. 主要產品之重要用途

主要產品	用 途
微控制器 MCU 產品	應用於家電產品、醫療保健產品、汽機車、工業儀表控制、量測、消費性電子、觸控產品、通訊產品及電腦產品。
顯示驅動產品	應用於家電產品、教育、育樂產品、儀器、觸控產品、居家安全、防盜器、健康醫療器材及汽車應用等顯示驅動產品，含 LCD、VFD 及 OLED。
電源管理產品	應用在各式電腦及消費性產品電源管理應用，含穩壓、偵壓、DC-DC 及 AC-DC 轉換應用。
記憶體產品	使用於電腦、通訊、消費電子、育樂產品及智慧型金融卡等。

2. 產品產製過程

(1) 產品製造過程

本公司以設計及行銷為主，產品之前後段製造皆以委外生產為輔。



(2) 晶圓代工資源

本公司產品之晶圓代工資源，均為國內外知名大廠如聯電、台積電、漢磊、旺宏等，並建立長久之產品開發與生產合作關係。

(3) 封裝

與多家廠商以產能分工之長期合作模式進行如超豐、華泰、日月光等，確

保封裝產能無虞。

(4) 測試

與多家測試廠合作，如超豐、久元等提供本公司需要之測試技術與設備，並可提供充份之產能。

(5) 倉儲作業

A. 主要儲存物品：

(A) 種類分為：晶圓/晶粒/封裝 IC/半成品/物料。

(B) 測試狀態分為：已測/未測。

(C) 依可用性分為：良品/不良品/報廢品。

B. 良好的倉儲規劃及管理與品質保證：

(A) 自動倉儲作業。

(B) 儲存物品之品質維護。

(C) 貨物進出的管理與正確性。

(D) 主動追蹤貨品週轉效率。

(三) 主要原料之供應狀況

本公司產品為高精密度積體電路，主要原材料為矽晶圓，主要原料供應廠商均為國內外之世界知名大廠，品質佳且來源穩定，其中更與聯電、台積電、漢磊、旺宏建立長期及良好之生產合作關係，保持晶圓代工資源之優勢，並更積極尋求其他國內外之晶圓代工廠之支援，以支應公司成長之需求。

(四) 最近二年度任一年度佔進銷貨總額百分之十以上之客戶名單

1.最近二年度任一年度佔進銷貨總額百分之十以上客戶名單

單位：新台幣仟元

	102 年度				103 年度				當年度截至 104 年 3 月 31 日止(註 2)			
項目	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係	名稱	金額	占當年度截至 前一季度進貨 淨額比率(%)	與發行人 之關係
1	A	752,193	36	無	A	845,496	41	無	A	207,609	42	無
2	B	351,049	17	無	B	268,248	13	無	B	45,273	9	無
3	C	292,990	14	無	C	277,049	13	無	C	54,094	11	無
4	其他	679,356	33	無	其他	697,099	33	無	其他	187,031	38	無
	進貨淨額	2,075,588	100		進貨淨額	2,087,892	100		進貨淨額	494,007	100	

註 1：列明最近二年度進銷貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進銷金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註 2：當年度截至 104 年 3 月 31 日之財務資料為經會計師核閱之合併財務資料。

主要進貨客戶變動原因：

本公司與上、下游廠商皆維持良好默契與關係，近二年度主要產能因市場供需狀況及成本因素，致各廠商進銷貨金額有增減外，尚無明顯之重大變化。

2. 最近二年度任一年度佔銷貨總額百分之十以上客戶名單

單位：新台幣仟元

項目	102 年度				103 年度				當年度截至 104 年 3 月 31 日止(註 2)			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	欣宏	482,797	12	本公司子公司採權益法評價之被投資公司	欣宏	470,973	12	本公司子公司採權益法評價之被投資公司	欣宏	117,402	13	本公司子公司採權益法評價之被投資公司
2	其他	3,411,564	88		其他	3,459,546	88		其他	760,839	87	
	銷貨淨額	3,894,361	100		銷貨淨額	3,930,519	100		銷貨淨額	878,241	100	

註 1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註 2：當年度截至 104 年 3 月 31 日之財報資料為經會計師核閱之合併財務資料。

主要銷貨客戶變動原因：

本公司與客戶均保持良好的合作關係，且透過香港分公司直接出貨拓展海外銷售外，與其他客戶銷貨集中度不大，主要客戶會隨著市場開拓及景氣供需影響銷貨產生增減變動。

(二)最近二年度生產量值表

單位：仟粒/新台幣仟元

生產 量值 主要商品	年 度	102 年度			103 年度		
		產能	產量	產值	產能	產量	產值
微控制器 IC		--	441,039	1,402,980	--	469,559	1,451,282
週邊 IC		--	381,821	696,442	--	325,967	565,223
開發工具及設計收入		--	62	8,564	--	38	8,938
總 計		--	822,922	2,107,986	--	795,564	2,025,443

註 1：本公司所研發設計之產品，主要係委託晶圓代工廠製造，再委外測試、封裝，並無自有產能限制。

註 2：本公司產品之生產全部委外製造，包括晶圓代工及後段封裝測試，生產量的多寡全部依據當年度之銷售預估，產值與銷售金額成正比。

(六) 最近二年度銷售量值表

單位：仟粒/新台幣仟元

銷售 量值 主要商品	年 度	102 年度				103 年度			
		內 銷		外 銷		內 銷		外 銷	
		量	值	量	值	量	值	量	值
微控制器 IC		45,848	319,946	383,985	2,255,762	48,194	367,352	417,973	2,375,583
週邊 IC		57,980	222,643	317,299	1,078,745	44,070	168,399	291,954	1,003,572
開發工具及設計收入		8	1,888	10	15,377	8	3,056	43	12,557
總 計		103,836	544,477	701,294	3,349,884	92,272	538,807	709,970	3,391,712

三、從業員工

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

日期：104 年 3 月 31 日

年度		102 年底	103 年底	當年度截至 104 年 3 月 31 日
員工 人數	工程人員	471	466	477
	管理人員	126	125	129
	生產測試人員	28	28	33
	合計	625	619	639
平均年歲		34.51	35.64	35.39
平均服務年資		5.24 年	6.78 年	6.08 年
學歷 分佈 比率	博 士	0.6%	0.8%	0.6%
	碩 士	28.7%	27.1%	27.6%
	大 專	61.3%	63.2%	63.6%
	高中(含以下)	9.4%	8.9%	8.2%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失及處分之總額，其未來因應對策及可能之支出：無。

五、勞資關係

揭露員工之進修及訓練情形(例如：員工訓練的支出、員工進修及訓練辦法的訂定等)為評鑑基礎。

(一) 員工福利措施

1. 員工認股及分紅

為使全體員工皆能同心協力、共創將來，故公司在現金增資時依法提撥予員工認股，並在會計年度結算後，如有盈餘，除提繳稅捐及彌補歷年虧損並依法提撥 10% 的法定公積外，再從提撥後餘額提撥 13.5% 紅利以現金或股票方式作為全體員工分紅。為提升公司業績及營運效率，本公司設置營運獎金激勵員工；另為吸引優秀人才及留住績優員工，本公司選擇適當時機發行員工認股權憑證，以提高員工對公司的向心力及歸屬感。

2. 進修與教育訓練

本公司對人才的培育一直不遺餘力，除編列預算供員工在外進修外，並由教育訓練委員會、行政部及部門主管針對公司發展目標及各部門需求設計內部訓練課程，讓每位員工在完整的工作生涯培訓體系下成長：

(1) 職前訓練(新人訓練)：

A. 公司文化融入與陶冶：公司統一有新進人員訓練，讓新人了解熟悉本公司組織概況、人事規章、品質政策、工業安全與衛生、人物與環境而實施之

訓練。

B.工作上專業訓練：新進人員有資深工程師擔任指導員，針對相關工作職務規劃完整的培訓課程，幫助基礎設計技術建立及設計環境熟練。

(2) 在職訓練：

A.部門自辦訓練：各部門會針對其專業需求，要求工程師參與部門自辦專長訓練。

B.公司內部訓練：內部設有教育訓練委員會依據各部門專業需求，聘請專業講師至公司進行長期的專業訓練課程，包括專業技術培訓課程、管理技能培訓課程、品質培訓課程、工安衛生培訓課程、法務智權培訓課程及電腦培訓等多元而充實的訓練課程。

C.線上學習課程：建立教育訓練平台，整合所有課程訊息、訓練系統及資料查詢，發展 e-learning 及知識管理系統，建立網路教學滿意度調查機制。

D.公司外部訓練：每人每年固定提供培訓課程經費，可依個人計劃需求安排參與其他外部專業訓練。

E.103 年員工教育訓練實際執行情形：

(A)一般管理類

課程名稱	總時數	參加人數
營業秘密之保護主管班(一)	2	36
研發中心目標管理(一)	2	37
營業秘密之保護 主管班(二)	2	52
研發中心目標管理(二)	2	56
簡報技巧訓練課程	3	21
個人資料保護法	2	13

(B)專業技術類

課程名稱	總時數	參加人數
標準規格的使用(共六場)	12	64
產品線規格 CHECK LIST&電路圖 零件庫訓練	4	32
NFC/RF 技術	3	25
I-Plan 系統操作(一)(二)	6	34
I-Plan 電路設計(上下集)	6	28
HOLTEK 前段設計流程	2	18
晶片防護與加解密 IC 專題演講(共 4 場)	12	20

(3) 在職進修：

資深工程師可申請國內大學在職進修計劃，增進其專業研究發展技術與管理能力以配合公司未來發展與永續經營的需要。

(4) 自我發展：

除培養員工之專業能力，使其能在技術上建立自信心，進而訓練成計劃主持人，在計劃管理上感受團隊合作經驗及建立；另外培養資深員工為公司中堅幹部，依職級需求參與基層、中階、高階主管管理訓練，以提升經營管理能力及績效。

3. 溝通管道

本公司設有內部電子信箱、部門會議等管道供同仁們與公司各級主管做雙向的意見表達及溝通。

4. 福委會概況

福委會每年定期舉辦員工旅遊，各項遊戲競賽、年終聚餐等活動。除此之外，對於婚、喪、生育、住院皆有補助。

5. 本公司設有餐廳、員工休閒活動區、圖書室等設施，並舉辦團體保險、員工健康檢查等活動，並設有專業醫護人員，提供員工健康管理及健保服務。

(二) 退休制度與其實施情形

本公司訂有退休辦法並設置勞工之退休準備金監督委員會，依勞動基準法暨勞工退休準備金提撥及管理辦法規定，每月以實際職工薪資總額之百分之二提撥退休基金，並以專戶存於臺灣銀行。

本公司另依勞工退休金條例之規定，對適用勞工退休金條例之員工以每月工資百分之六之提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。

本公司之香港分公司依當地法令規定按月依薪資總額一定比率提撥退休金，以員工名義專戶儲存於信託機構，並以實際提撥數認列職工退休金。

(三) 勞資間之協議情形

本公司勞資間關係良好，雇主與員工之間互動密切。

(四) 各項員工權益的維護措施

本公司設有行政人事專責單位制定各項符合相關勞基法令規定之制度及措施，保障員工之各項權益，若員工有任何意見，均可透過各種溝通管道向各級主管及行政單位反應及爭取權益。

(五) 最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

六、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
土地租賃	新竹科學工業園區管理局	90/03/15~109/12/31	租賃自建廠房用土地	限自建廠房用
技術開發	財團法人工業技術研究院	94/11/30~106/11/29	從事 Surveillance Camera DSP IP 技術開發計畫	不得違反相關法令之規定

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
技術授權	財團法人工業技術研究院	95/10/01~105/09/30	「微機械系統應用」專案之技術授權	不得違反相關法令之規定
技術授權	ARM Limited	96/06/25~永久	ARM Cortex-M3 技術授權	不得違反相關法令之規定
技術授權	ARM Limited	102/09/24~永久	ARM Cortex-M0+技術授權	不得違反相關法令之規定

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

(一) 國際財務報導準則-合併資訊

1.簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目		最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)					當 年 度 截 至 104 年 3 月 31 日 財 務 資 料 (註 2)
		99 年	100 年	101 年	102 年	103 年	
流 動 資 產		不 <					

註1：財務報表均經會計師查核簽證。

註2：當年度截至104年3月31日財務資料為經會計師核閱之合併財務季報告。

2.簡明綜合損益表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)					當 年 度 截 至 104 年 3 月 31 日 財 務 資 料 (註 2)
	99 年	100 年	101 年	102 年	103 年	
營 業 收 入	不 適 用		3,555,952	3,894,361	3,930,519	878,241
營 業 毛 利			1,569,012	1,823,338	1,888,747	434,589
營 業 損 益			582,312	755,589	817,495	180,088
營業外收入及支出			65,560	126,443	121,024	9,937
稅 前 淨 利			647,872	882,032	938,519	190,025
繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利			561,049	747,800	798,584	161,707
停 業 單 位 損 失			—	—	—	—
本 期 淨 利 (損)			561,049	747,800	798,584	161,707
本 期 其 他 綜 合 損 益 (稅 後 淨 額)			(4,607)	36,453	30,596	(4,446)
本 期 綜 合 損 益 總 額			556,442	784,253	829,180	157,261
淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主			560,194	744,945	791,556	160,549
淨利歸屬於非控制權益			855	2,855	7,028	1,158
綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 母 公 司 業 主			555,656	781,291	822,225	156,103
綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 非 控 制 權 益			786	2,962	6,955	1,158
每 股 盈 餘			2.51	3.32	3.50	0.71

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

註 2：當年度截至 104 年 3 月 31 日財務資料為經會計師核閱之合併財務季報告。

(二) 國際財務報導準則-個體資訊

1.簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目		最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)					當 年 度 截 至 104 年 3 月 31 日 財 務 資 料
		99 年	100 年	101 年	102 年	103 年	
流 動 資 產		不 <					

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

2.簡明綜合損益表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	最近五年度財務資料(註1)					當年度截至 104年3月31日 財務資料
	99年	100年	101年	102年	103年	
營業收入	不 適 用		3,365,511	3,599,332	3,605,717	不 適 用
營業毛利			1,489,273	1,632,693	1,685,380	
營業損益			602,338	730,155	794,650	
營業外收入及支出			43,575	147,616	132,769	
稅前淨利			645,913	877,771	927,419	
繼續營業單位 本期淨利			560,194	744,945	791,556	
停業單位損失			—	—	—	
本期淨利(損)			560,194	744,945	791,556	
本期其他綜合損益 (稅後淨額)			(4,538)	36,346	30,669	
本期綜合損益總額			555,656	781,291	822,225	
淨利歸屬於 母公司業主			560,194	744,945	791,556	
淨利歸屬於非控制權益			—	—	—	
綜合損益總額歸屬於母 公司業主			555,656	781,291	822,225	
綜合損益總額歸屬於非 控制權益			—	—	—	
每股盈餘			2.51	3.32	3.50	

註1：財務報表均經會計師查核簽證。

(三) 我國財務會計準則-合併資訊

1.簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目		最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)				
		99 年	100 年	101 年	102 年	103 年
流 動 資 產		3,954,930	3,464,859	3,391,453	不 適 用	不 適 用
基 金 及 投 資		546,215	607,735	609,217		
固 定 資 產		205,864	321,971	499,430		
無 形 資 產		—	—	—		
其 他 資 產		123,133	87,375	64,393		
資 產 總 額		4,830,142	4,481,940	4,564,493		
流 動 負 債	分配前	988,769	771,654	796,785		
	分配後	1,696,276	1,285,931	1,355,781		
長 期 負 債		—	—	—		
其 他 負 債		72,693	74,679	100,544		
負 債 總 額	分配前	1,061,462	846,333	897,329		
	分配後	1,768,969	1,360,610	1,456,325		
股 本		2,237,681	2,235,985	2,235,985		
資 本 公 積		59,711	83,257	83,257		
保 留 盈 餘	分配前	1,471,231	1,290,499	1,336,416		
	分配後	763,724	776,222	777,420		
金 融 商 品 未 實 現 損 益		—	—	—		
累 積 換 算 調 整 數		57	18,008	2,862		
非 控 制 權 益		—	7,858	8,644		
未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失		—	—	—		
股 東 權 益 總 額	分配前	3,768,680	3,635,607	3,667,164		
	分配後	3,061,173	3,121,330	3,108,168		

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

2.簡明損益表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	最 近 五 年 度 財 務 資 料(註 1)				
	99 年	100 年	101 年	102 年	103 年
營 業 收 入	4,047,743	3,519,371	3,555,952	不 適 用	不 適 用
營 業 毛 利	1,841,395	1,525,635	1,566,333		
營 業 損 益	748,017	539,900	582,312		
營 業 外 收 入 及 利 益	119,086	108,715	83,208		
營 業 外 費 用 及 損 失	24,817	15,071	17,648		
繼 續 營 業 部 門 稅 前 損 益	842,286	633,544	647,872		
繼 續 營 業 部 門 損 益	786,604	526,687	561,049		
停 業 部 門 損 益	—	—	—		
非 常 損 益	—	—	—		
會 計 原 則 變 動 之 累 積 影 響 數	—	—	—		
本 期 損 益	786,604	526,687	561,049		
每 股 盈 餘 (元) (註 2)	3.53	2.36	2.51		

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

註 2：民國 99 年度之每股盈餘，已追溯調整。

(四) 我國財務會計準則-個體資訊

1.簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目		最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)				
		99 年	100 年	101 年	102 年	103 年
流 動 資 產		3,626,865	3,114,936	2,967,389	不 適 用	不 適 用
基 金 及 投 資		925,964	992,130	1,276,164		
固 定 資 產		126,956	252,034	233,177		
無 形 資 產		—	—	—		
其 他 資 產		121,954	86,103	62,285		
資 產 總 額		4,801,739	4,445,203	4,539,015		
流 動 負 債	分配前	959,961	742,426	779,765		
	分配後	1,667,468	1,256,703	1,338,761		
長 期 負 債		—	—	—		
其 他 負 債		73,098	75,028	100,730		
負 債 總 額	分配前	1,033,059	817,454	880,495		
	分配後	1,740,566	1,331,731	1,439,491		
股 本		2,237,681	2,235,985	2,235,985		
資 本 公 積		59,711	83,257	83,257		
保 留 盈 餘	分配前	1,471,231	1,290,499	1,336,416		
	分配後	763,724	776,222	777,420		
金 融 商 品 未 實 現 損 益		—	—	—		
累 積 換 算 調 整 數		57	18,008	2,862		
未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失		50,183	11,798	1,190		
股 東 權 益 總 額	分配前	3,768,680	3,627,749	3,658,520		
	分配後	3,061,173	3,113,472	3,099,524		

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

2.簡明損益表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	最 近 五 年 度 財 務 資 料(註 1)				
	99 年	100 年	101 年	102 年	103 年
營 業 收 入	3,849,472	3,319,526	3,365,511	不 適 用	不 適 用
營 業 毛 利	1,789,948	1,449,620	1,489,273		
營 業 損 益	767,948	531,504	602,338		
營 業 外 收 入 及 利 益	97,556	110,106	60,923		
營 業 外 費 用 及 損 失	27,164	9,442	17,348		
繼 續 營 業 部 門 稅 前 損 益	838,340	632,168	645,913		
繼 續 營 業 部 門 損 益	786,103	526,775	560,194		
停 業 部 門 損 益	—	—	—		
非 常 損 益	—	—	—		
會計原則變動之累積影響數	—	—	—		
本 期 損 益	786,103	526,775	560,194		
每 股 盈 餘 (元) (註 2)	3.53	2.36	2.51		

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

註 2：民國 99 年度之每股盈餘，已追溯調整。

(五) 最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見

年度	簽證會計師	所屬單位名稱	查核意見
99	游萬淵、魏興海	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見
100	游萬淵、魏興海	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見
101	魏興海、游萬淵	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見
102	魏興海、曾漢鈺	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見
103	魏興海、曾漢鈺	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見

二、最近五年度財務分析

(一) 國際財務報導準則—合併資訊

年 度 (註 1) 分析項目 (註 3)		最 近 五 年 度 財 務 分 析 (註 1)					當 年 度 截 至 104 年 3 月 31 日 財務資料(註 2)
		99 年	100 年	101 年	102 年	103 年	
財務結構 (%)	負債占資產比率	不 適 用	不 適 用	19	19	20	18
	長期資金占不動產、廠房及設備比率			737	796	832	876
償債能力 (%)	流動比率			434	448	446	490
	速動比率			360	386	387	423
	利息保障倍數			—	—	—	—
經營能力	應收款項週轉率(次)			7.10	6.84	6.07	5.66
	平均收現日數			51	53	60	64
	存貨週轉率(次)			3.56	3.83	4.02	3.41
	應付款項週轉率(次)			4.34	4.47	4.40	3.82
	平均銷貨日數			103	95	91	107
	不動產、廠房及設備週轉率(次)			8.68	7.82	7.96	7.25
	總資產週轉率(次)			0.78	0.79	0.78	0.68
獲利能力	資產報酬率(%)			12	16	16	13
	權益報酬率(%)			15	20	20	16
	稅前純益占實收資本額比率(%)			29	39	41	34
	純益率(%)			16	19	20	18
	每股盈餘(元)			2.51	3.32	3.50	0.71
現金流量	現金流量比率(%)			72	117	114	21
	現金流量允當比率(%)			116	126	124	95
	現金再投資比率(%)			1	9	5	—
槓桿度	營運槓桿度			1.00	1.96	1.86	1.97
	財務槓桿度			1.00	1.00	1.00	1.00

請說明最近二年度各項財務比率變動原因(若增減變動未達 20%者可免分析)

1、現金再投資比率較 102 年度下降，主要係 103 年度現金股利發放增加所致。

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

註 2：當年度截至 104 年 3 月 31 日財務資料為經會計師核閱之合併財務季報告。

註 3：分析項目之計算公式如後。

(二) 國際財務報導準則—個體資訊

年 度 (註 1) 分析項目 (註 2)		最 近 五 年 度 財 務 分 析 (註 1)					當 年 度 截 至 104 年 3 月 31 日 財 務 資 料
		99 年	100 年	101 年	102 年	103 年	
財務結構 (%)	負債占資產比率	不	不	19	19	19	不
	長期資金占不動產、廠房及設備比率			1,568	1,905	2,094	
償債能力 (%)	流動比率			402	414	416	
	速動比率			331	356	362	
	利息保障倍數			—	—	—	
經營能力	應收款項週轉率(次)			7.13	6.81	5.99	
	平均收現日數			51	54	61	
	存貨週轉率(次)			3.76	4.10	4.38	
	應付款項週轉率(次)			4.42	4.53	4.45	
	平均銷貨日數			97	89	83	
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	適	適	13.87	16.31	17.99	適
	總資產週轉率(次)			0.75	0.74	0.72	
獲利能力	資產報酬率(%)			13	16	16	
	權益報酬率(%)			15	20	20	
	稅前純益占實收資本額比率(%)			29	38	41	
	純益率(%)			17	21	22	
	每股盈餘 (元)			2.51	3.32	3.50	
現金流量	現金流量比率(%)			74	119	108	
	現金流量允當比率(%)			113	122	118	
	現金再投資比率(%)			0	8	3	
槓桿度	營運槓桿度			1.01	1.81	1.73	
	財務槓桿度			1.00	1.00	1.00	

請說明最近二年度各項財務比率變動原因(若增減變動未達 20%者可免分析)

1、現金再投資比率較 102 年度下降，主要係 103 年度現金股利發放增加所致。

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

註 2：分析項目之計算公式如後。

財務分析計算公式

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕／平均資產總額。

(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)。

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)。

(三) 我國財務會計準則—合併資訊

年 度 分析項目（註 2）		最 近 五 年 度 財 務 分 析（註 1）				
		99 年	100 年	101 年	102 年	103 年
財務結構 (%)	負債占資產比率	22	19	20	不 	

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

註 2：分析項目之計算公式如後。

(四) 我國財務會計準則—個體資訊

年 度 分析項目（註 2）		最 近 五 年 度 財 務 分 析（註 1）				
		99 年	100 年	101 年	102 年	103 年
財務結構 (%)	負債占資產比率	22	18	19	不 	

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

註 2：分析項目之計算公式如後。

財務分析計算公式

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋長期負債）／固定資產淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額／平均固定資產淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕／平均資產總額。

(2)股東權益報酬率＝稅後損益／平均股東權益淨額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(固定資產毛額＋長期投資＋其他資產＋營運資金)。

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)。

三、最近年度財務報告之監察人審查報告：詳見第 105 頁。

四、最近年度財務報告：詳見第 106 頁~第 148 頁。

五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告：詳見第 149 頁~第 187 頁。

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響：無。

三、最近年度財務報告之監察人審查報告

盛群半導體股份有限公司 監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表已委請安侯建業聯合會計師事務所魏興海、曾漢鈺會計師查核完竣，並出具查核報告書在案。上述表冊及報告經本監察人等審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

此 致

本公司一〇四年股東常會

盛群半導體股份有限公司

監察人：王仁宗



林嘉茂



新耕投資有限公司

代表人：周玲娜



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 八 日

會計師查核報告

盛群半導體股份有限公司董事會 公鑒：

盛群半導體股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達盛群半導體股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

盛群半導體股份有限公司業已編製民國一〇三年度及一〇二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

魏曉海

曾漢鈺



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號

民國一〇四年一月二十六日

民國一〇三年及一〇二三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103.12.31		102.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100 現金及約當現金(附註六(一))		\$ 1,179,235	23	1,050,620	21
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動					
(附註六(二))		158,476	3	263,247	5
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))		102,956	2	91,116	2
1180 應收關係人款項(附註七)		571,953	11	528,982	11
130X 存貨(附註六(四))		500,981	10	515,202	11
1476 其他金融資產－流動(附註六(五)及八)		1,294,657	26	1,256,951	26
1470 其他流動資產		21,900	-	18,464	-
		<u>3,830,158</u>	<u>75</u>	<u>3,724,582</u>	<u>76</u>
非流動資產：					
1550 採用權益法之投資(附註六(六))		399,112	8	360,439	7
1543 以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(二))		229,750	5	238,570	5
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七))		487,863	10	499,508	10
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))		37,897	1	35,644	1
1900 其他非流動資產		74,786	1	70,742	1
		<u>1,229,408</u>	<u>25</u>	<u>1,204,903</u>	<u>24</u>
		<u>\$ 5,059,566</u>	<u>100</u>	<u>4,929,485</u>	<u>100</u>
負債及權益總計					
負債：					
流動負債：					
2150 應付票據					
2170 應付帳款					
2180 應付關係人款項(附註七)					
2201 應付薪資及獎金					
2230 應付所得稅					
2300 其他流動負債					
		<u>2,024</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>68,819</u>	<u>1</u>	<u>76,921</u>	<u>2</u>
		<u>858,093</u>	<u>17</u>	<u>830,553</u>	<u>17</u>
非流動負債：					
2570 遞延所得稅負債(附註六(十))		78,015	2	56,138	1
2640 應計退休金負債(附註六(九))		58,254	1	60,829	1
2645 存入保證金		7,597	-	7,597	-
		<u>143,866</u>	<u>3</u>	<u>124,564</u>	<u>2</u>
		<u>1,001,959</u>	<u>20</u>	<u>955,117</u>	<u>19</u>
負債總計					
權益：					
3110 普通股股本		2,261,682	45	2,249,412	46
3140 預收股本		-	-	40,368	1
3211 資本公積－普通股股票溢價		142,309	3	114,211	2
3310 保留盈餘：					
法定盈餘公積		791,920	15	777,359	16
特別盈餘公積		2,642	-	4,598	-
未分配盈餘		794,417	16	761,084	16
		<u>1,588,979</u>	<u>31</u>	<u>1,543,041</u>	<u>32</u>
3410 國外營運機構財務報告換算之兌換差額		45,662	1	15,730	-
36XX 歸屬於母公司業主之權益合計		<u>4,038,632</u>	<u>80</u>	<u>3,962,762</u>	<u>81</u>
36XX 非控制權益		18,975	-	11,606	-
		<u>4,057,607</u>	<u>80</u>	<u>3,974,368</u>	<u>81</u>
		<u>\$ 5,059,566</u>	<u>100</u>	<u>4,929,485</u>	<u>100</u>



董事長：



經理人：

嗣後附合併財務報告附註)



會計主管：

盛群半導體股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103年度		102年度	
		金額	%	金額	%
4100	營業收入淨額(附註七)	\$ 3,930,519	100	3,894,361	100
5110	營業成本(附註六(四)及七)	2,041,772	52	2,071,023	53
	營業毛利	1,888,747	48	1,823,338	47
5910	未實現銷貨利益之變動	4,815	-	20,115	1
	已實現營業毛利	1,883,932	48	1,803,223	46
	營業費用：				
6100	推銷費用	84,369	2	93,717	3
6200	管理費用	324,045	8	330,581	8
6300	研究發展費用	658,023	17	623,336	16
		1,066,437	27	1,047,634	27
	營業淨利	817,495	21	755,589	19
	營業外收入及支出：				
7100	利息收入	26,480	1	23,211	1
7060	採用權益法認列之關聯企業利益之份額(附註六(六))	57,440	1	61,252	1
7020	其他利益淨額(附註六(十四))	37,104	1	41,980	1
		121,024	3	126,443	3
	稅前淨利	938,519	24	882,032	22
7950	所得稅費用(附註六(十))	139,935	4	134,232	3
	本期淨利	798,584	20	747,800	19
	其他綜合損益：				
8310	國外營運機構財務報告換算之兌換差額	35,989	1	37,307	1
8360	確定福利計畫精算利益	888	-	6,016	-
8399	減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅(附註六(十))	6,281	-	6,870	-
	其他綜合損益(稅後淨額)	30,596	1	36,453	1
	本期綜合損益總額	\$ 829,180	21	784,253	20
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 791,556	20	744,945	19
8620	非控制權益	7,028	-	2,855	-
		\$ 798,584	20	747,800	19
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 822,225	21	781,291	20
8720	非控制權益	6,955	-	2,962	-
		\$ 829,180	21	784,253	20
	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十三))				
9750	基本每股盈餘	\$ 3.50		3.32	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 3.46		3.28	

董事長：



(請詳閱後附會計師報告附註)

經理人：



會計主管：



盛群半導體股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	國外營運機構財務報表換算之兌換差									
	普通股 股本	預收股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘	換算之兌換 差	歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制權益	權益總計
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 2,235,985	-	83,257	776,122	4,598	570,902	(15,146)	3,655,718	8,644	3,664,362
本期淨利	-	-	-	-	-	744,945	-	744,945	2,855	747,800
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	5,470	30,876	36,346	107	36,453
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	750,415	30,876	781,291	2,962	784,253
盈餘指撥及分配(註1):										
提列法定盈餘公積	-	-	-	56,019	-	(56,019)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(54,782)	-	(504,214)	-	(558,996)	-	(558,996)
員工行使認股權	13,427	40,368	30,954	-	-	-	-	84,749	-	84,749
民國一〇二年十二月三十一日餘額	2,249,412	40,368	114,211	777,359	4,598	761,084	15,730	3,962,762	11,606	3,974,368
本期淨利	-	-	-	-	-	791,556	-	791,556	7,028	798,584
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	737	29,932	30,669	(73)	30,596
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	792,293	29,932	822,225	6,955	829,180
盈餘指撥及分配(註2):										
提列法定盈餘公積	-	-	-	74,495	-	(74,495)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(59,934)	-	(686,421)	-	(746,355)	-	(746,355)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(1,956)	1,956	-	-	-	-
員工行使認股權	12,270	(40,368)	28,098	-	-	-	-	-	-	-
非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	414	414
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 2,261,682	-	142,309	791,920	2,642	794,417	45,662	4,038,632	18,975	4,057,607

註：董事監察人酬勞7,563千元及員工紅利68,064千元已於綜合損益表中扣除。

註：董事監察人酬勞10,057千元及員工紅利90,511千元已於綜合損益表中扣除。



董事長：

(請詳閱合併財務報告附註)



經理人：

會計主管：



盛群半導體股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 938,519	882,032
調整項目：		
折舊費用	47,843	48,208
攤銷費用	51,272	45,719
利息收入	(26,480)	(23,211)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(57,440)	(61,252)
聯屬公司間未實現銷貨利益變動	4,815	20,115
其他不影響現金流量之費損(收益)淨額	336	(65)
與營業活動相關之資產及負債淨變動數：		
持有供交易之金融資產	104,737	77,836
應收票據及帳款(含應收關係人款項)	(47,552)	(88,893)
存貨	24,448	49,176
其他營業資產	(15,926)	(19,463)
應付票據及帳款(含應付關係人款項)	4,064	(19,090)
應計退休金負債	(1,687)	(1,855)
其他營業負債	68	64,577
營運產生之現金流入	1,027,017	973,834
收取利息	26,476	22,134
收取股利	40,849	26,861
支付所得稅	(115,171)	(47,072)
營業活動之淨現金流入	979,171	975,757
投資活動之現金流量：		
取得以成本衡量之金融資產	-	(4,176)
取得採用權益法之投資	(7,632)	-
取得不動產、廠房及設備	(20,338)	(31,296)
處分不動產、廠房及設備價款	450	-
存出保證金減少(增加)	(487)	1,063
其他金融資產增加	(32,630)	(106,068)
其他非流動資產增加	(52,247)	(38,926)
投資活動之淨現金流出	(112,884)	(179,403)
籌資活動之現金流量：		
發放股東現金股利	(746,355)	(558,996)
員工認股權執行認購價款	-	84,749
籌資活動之淨現金流出	(746,355)	(474,247)
匯率變動影響數	8,683	11,023
本期現金及約當現金增加數	128,615	333,130
期初現金及約當現金餘額	1,050,620	717,490
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,179,235	1,050,620

董事長：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：



盛群半導體股份有限公司及其子公司
合併財務報告附註
民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日
(除另有註明者外，所有金額均以新台幣千元為單位)

一、公司沿革

盛群半導體股份有限公司(以下稱「本公司」)於民國八十七年十月一日依中華民國公司法及科學園區設置管理條例之規定成立，自民國八十七年十二月十一日開始營業，民國八十九年四月於香港設立分公司。本公司股票自民國九十一年十一月四日起於中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌買賣，自民國九十三年九月二十七日起改於台灣證券交易所股份有限公司掛牌買賣。

本公司及子公司(以下併稱「合併公司」)主要營業項目為各種積體電路之研究、開發、生產、製造及銷售。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告已於民國一〇四年一月二十六日經董事會通過。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)尚未採用金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)認可之2013年版國際財務報導準則之影響

依據金管會民國一〇三年四月三日金管證審字第1030010325號令，上市、上櫃及興櫃公司應自民國一〇四年起全面採用經金管會認可並發布生效之2013年版國際財務報導準則(不包含國際財務報導準則第九號「金融工具」)編製財務報告，相關國際會計準則理事會新發布、修正及修訂之準則及解釋彙列如下：

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布 之生效日
國際財務報導準則第1號之修正「國際財務報導準則第7號之比較揭露對首次採用者之有限度豁免」	99.7.1
國際財務報導準則第1號之修正「嚴重高度通貨膨脹及首次採用者固定日期之移除」	100.7.1
國際財務報導準則第1號之修正「政府貸款」	102.1.1
國際財務報導準則第7號之修正「揭露—金融資產之移轉」	100.7.1
國際財務報導準則第7號之修正「揭露—金融資產及金融負債之互抵」	102.1.1
國際財務報導準則第10號「合併財務報表」	102.1.1 (投資個體於 103.1.1生效)
國際財務報導準則第11號「聯合協議」	102.1.1
國際財務報導準則第12號「對其他個體之權益之揭露」	102.1.1
國際財務報導準則第13號「公允價值衡量」	102.1.1

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布 之生效日
國際會計準則第1號之修正「其他綜合損益項目之表達」	101.7.1
國際會計準則第12號之修正「遞延所得稅：標的資產之回收」	101.1.1
國際會計準則第19號之修訂「員工福利」	102.1.1
國際會計準則第27號之修訂「單獨財務報表」	102.1.1
國際會計準則第32號之修正「金融資產及金融負債之互抵」	103.1.1
國際財務報導解釋第20號「露天礦場於生產階段之剝除成本」	102.1.1

經評估後合併公司認為除下列各項外，適用2013年版國際財務報導準則將不致對合併財務報告造成重大變動：

1. 國際會計準則第19號「員工福利」

該準則主要修正以淨確定福利負債（資產）乘以折現率決定淨利息，並用其取代準則修訂前之利息成本及計畫資產之預期報酬、刪除精算損益得採「緩衝區法」或發生時一次列入損益之會計政策選擇，並規定精算損益應於發生時列入其他綜合損益、前期服務成本應於發生時認列為損益，不再於符合既得條件前之平均期間內按直線法分攤認列為費用，另企業係於不再能撤銷離職福利之要約或於認列相關重組成本之孰早者認列離職福利，而非僅於已明確承諾相關離職事件時，始應認列離職福利為負債及費用等。此外增加確定福利計畫之揭露規定。經評估該準則對合併公司財務狀況與經營結果無重大影響，惟將依規定增加確定福利計畫相關揭露。

2. 國際會計準則第1號「財務報表之表達」

該準則修正其他綜合損益之表達方式，將列示於其他綜合損益之項目依性質分類為「後續不重分類至損益」及「後續將重分類至損益」兩類別。該修正同時規定以稅前金額列示之其他綜合損益項目，其相關稅額應隨前述兩類別予以單獨列示。合併公司將依該準則改變綜合損益表之表達方式。

3. 國際財務報導準則第12號「對其他個體之權益之揭露」

該準則整合各號準則對企業所持有子公司、聯合協議、關聯企業及未納入合併財務報告之結構型個體之權益之揭露規定，並要求揭露相關資訊。合併公司將依該準則增加有關子公司及關聯企業之資訊揭露。

4. 國際財務報導準則第13號「公允價值衡量」

該準則定義公允價值，建立公允價值衡量之架構，並規範公允價值衡量相關揭露。經評估該準則對合併公司財務狀況與經營結果無重大影響，惟將依規定增加公允價值衡量相關揭露。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(二)國際會計準則理事會已發布但尚未經金管會認可之國際財務報導準則之影響

下表彙列國際會計準則理事會已發布但尚未納入金管會認可2013年版國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布之生效日
國際財務報導準則第9號「金融工具」	107.1.1
國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	105.1.1
國際財務報導準則第10號、國際財務報導準則第12號及國際會計準則第28號之修正「投資個體：合併報表例外規定之適用」	105.1.1
國際財務報導準則第11號之修正「處理聯合營運權益之取得」	105.1.1
國際財務報導準則第14號「管制遞延帳戶」	105.1.1
國際財務報導準則第15號「來自客戶合約之收入」	106.1.1
國際會計準則第1號之修正「揭露計畫」	105.1.1
國際會計準則第16號及國際會計準則第38號之修正「闡明可接受之折舊及攤銷方法」	105.1.1
國際會計準則第16號及國際會計準則第41號之修正「生產性植物」	105.1.1
國際會計準則第19號之修正「確定福利計畫：員工提撥」	103.7.1
國際會計準則第27號之修正「單獨財務報表之權益法」	105.1.1
國際會計準則第36號之修正「非金融資產可回收金額之揭露」	103.1.1
國際會計準則第39號之修正「衍生工具之合約更替及避險會計之繼續」	103.1.1
國際財務報導解釋第21號「公課」	103.1.1

合併公司現正持續評估上述準則及解釋對合併公司財務狀況與經營結果之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

本合併財務報告所採用之重大會計政策彙總說明如下。除另有說明者外，下列會計政策已一致適用於本合併財務報告之所有表達期間。

(一)遵循聲明

本合併財務報告係依照「證券發行人財務報告編製準則」(以下簡稱「編製準則」)及金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則」)編製。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(二)編製基礎

1.衡量基礎

除下列資產負債表之重要項目外，本合併財務報告係依歷史成本為基礎編製：

- (1)透過損益按公允價值衡量之金融工具(包括衍生金融工具)；及
- (2)確定福利負債，係依退休基金資產加計未認列前期服務成本與未認列精算損失，減除未認列精算利益與確定福利義務現值之淨額認列。

2.功能性貨幣及表達貨幣

合併公司每一個體均係以該個體所處主要經濟環境之貨幣為其功能性貨幣。本合併財務報告係以本公司之功能性貨幣新台幣表達。所有以新台幣表達之財務資訊均以新台幣千元為單位。

(三)合併基礎

1.合併財務報告編製原則

合併財務報告之編製主體包含本公司及本公司之子公司。

自取得子公司控制力之日起，開始將其財務報告納入合併財務報告，直至不再具有控制力之日為止。歸屬於子公司非控制權益之損益歸屬於非控制權益，即使非控制權益因而成為虧損餘額亦然。

合併公司間之重大交易、餘額及未實現收益與費用，於編製合併財務報告時均已消除。

2.列入合併財務報告之子公司

列入本合併財務報告之子公司包含：

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比	
			103.12.31	102.12.31
本公司	MCU Holdings Ltd. (MCU)	投資控股公司	100%	100%
本公司	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. (Holtek BVI)	投資控股公司	100%	100%
本公司	Sigmos Holdings Ltd. (Sigmos)	投資控股公司	100%	100%
本公司	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. (Kingtek BVI)	投資控股公司	100%	100%
本公司	盛凌投資股份有限公司(盛凌投資)	專業投資公司	100%	100%
Holtek BVI	盛揚半導體(深圳)有限公司(盛揚) (註)	銷售及技術服務	-	100%
Holtek BVI	芯群集成電路(廈門)有限公司(芯群)	銷售及技術服務	100%	100%
Holtek BVI	合泰半導體(中國)有限公司(合泰)	銷售及技術服務	100%	100%
Sigmos	Holtek Semiconductor (USA) Inc. (Holtek (USA))	銷售及技術服務	100%	100%
Kingtek BVI	金科集成電路(蘇州)有限公司(金科)	銷售及技術服務	100%	100%

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比	
			103.12.31	102.12.31
盛凌投資	優方科技股份有限公司(優方)	製造及銷售	54.75%	56%
優方	Best Solution Electronics Inc. (Best Solution)	製造及銷售	100%	100%
盛凌投資	盛通科技股份有限公司(盛通)	製造及銷售	100%	-
盛通	BestComm RF Electronics Inc. (BestComm)	製造及銷售	100%	-

註：盛揚已於民國一〇三年八月完成清算各項權利義務及註銷登記。

3.未列入合併財務報告之子公司：無

(四)外幣

1.外幣交易

外幣交易依交易日之匯率換算為功能性貨幣。報導日之外幣貨幣性項目依當日之匯率換算為功能性貨幣，其兌換損益係指期初以功能性貨幣計價之攤銷後成本，調整當期之有效利息及付款後之金額，與依外幣計價之攤銷後成本按報導日匯率換算金額間之差異。以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目依衡量公允價值當日之匯率重新換算為功能性貨幣，以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目則依交易日之匯率換算。除備供出售金融資產、指定為國外營運機構淨投資避險之金融負債或合格之現金流量避險，換算所產生之外幣兌換差異認列於其他綜合損益外，其餘係認列為損益。

2.國外營運機構

國外營運機構之資產及負債，係依報導日之匯率換算為新台幣；股東權益項目除期初保留盈餘以上期期末換算後之餘額結轉外，其餘依歷史匯率換算為新台幣；收益及費損項目係依當期平均匯率換算為新台幣，所產生之兌換差額均認列為其他綜合損益。

當處分國外營運機構致喪失控制、共同控制或重大影響時，與該國外營運機構相關之累計兌換差額係全數重分類為損益。部分處分含有國外營運機構之子公司時，相關累計兌換差額係按比例重新歸屬至非控制權益。部分處分含有國外營運機構之關聯企業或合資之投資時，相關累計兌換差額則按比例重分類至損益。

(五)資產與負債區分流動與非流動之分類標準

符合下列條件之一之資產列為流動資產，非屬流動資產之所有其他資產則列為非流動資產：

- 1.預期於合併公司正常營業週期中實現，或意圖將其出售或消耗者。
- 2.主要為交易目的而持有者。
- 3.預期將於資產負債表日後十二個月內實現者。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

4.現金或約當現金，但不包括於資產負債表日後逾十二個月用以交換、清償負債或受有其他限制者。

符合下列條件之一之負債列為流動負債，非屬流動負債之所有其他負債則列為非流動負債：

- 1.預期將於合併公司正常營業週期中清償者。
- 2.主要為交易目的而持有者。
- 3.預期將於資產負債表日後十二個月內到期清償者。
- 4.合併公司不能無條件將清償期限延期至資產負債表日後至少十二個月者。

(六)現金及約當現金

現金包括庫存現金及活期存款。約當現金係指可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之短期並具高度流動性之投資。定期存款符合前述定義且持有目的係滿足短期現金承諾而非投資或其他目的者，列報於約當現金。

(七)金融工具

1.金融資產

(1)透過損益按公允價值衡量之金融資產

此類金融資產係指持有供交易之金融資產，其取得或發生之主要目的為短期內出售或再買回。此類金融資產於原始認列時係按公允價值衡量，交易成本於發生時認列為損益；後續評價按公允價值衡量，再衡量產生之利益或損失認列為損益，並列報於營業外收入及支出項下。依交易慣例購買或出售金融資產時，採用交易日會計處理。

(2)備供出售金融資產

此類金融資產若屬「無活絡市場公開報價且公允價值無法可靠衡量」之權益投資，則以成本減除減損損失後之金額衡量，列報於「以成本衡量之金融資產」。

(3)應收款

應收款係無活絡市場公開報價，且具固定或可決定付款金額之金融資產，包括應收款項及其他應收款。原始認列時係按公允價值加計直接可歸屬之交易成本衡量；續後評價採有效利率法以攤銷後成本減除減損損失衡量，惟短期應收款項之利息認列不具重大性之情況除外。

(4)金融資產減損

非透過損益按公允價值衡量之金融資產，於每個報導日評估減損。當有客觀證據顯示，因金融資產原始認列後發生之單一或多項事件，致使該資產之估計未來現金流量受損失者，該金融資產即已發生減損。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

針對應收帳款個別評估未有減損後，另再以組合基礎評估減損。應收款組合之客觀減損證據可能包含合併公司過去收款經驗、該組合超過平均授信期間之延遲付款增加情況，以及與應收款拖欠有關之全國性或區域性經濟情勢變化。

以成本衡量之金融資產，認列之減損損失金額係該資產之帳面金額與估計未來現金流量按該金融資產之相似資產市場報酬率折現之現值間之差額。該減損損失於後續期間不得迴轉。

所有金融資產之減損損失係直接自金融資產之帳面金額中扣除，惟應收款之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額，當判斷應收款無法收回時，則沖銷備抵帳戶，原先已沖銷而後續收回之款項則貸記備抵帳戶。備抵帳戶帳面金額之變動認列於損益。

當金融資產以攤銷後成本衡量時，若後續期間減損損失金額減少，且該減少客觀地連結至認列減損後發生之事項，則先前認列之減損損失予以迴轉認列於損益，惟該投資於減損迴轉日之帳面金額不得大於若未認列減損情況下應有之攤銷後成本。

(5)金融資產之除列

合併公司僅於對來自該資產現金流量之合約權利終止，或已移轉金融資產且該資產幾乎所有之風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

2.金融負債

(1)應付款

金融負債非屬持有供交易且未指定為透過損益按公允價值衡量者，包括應付帳款及其他應付款，原始認列時係按公允價值加計直接可歸屬之交易成本衡量；續後評價採有效利率法以攤銷後成本衡量。

(2)金融負債之除列

合併公司係於合約義務已履行、取消或到期時，除列金融負債。

除列金融負債時，其帳面金額與所支付或應支付對價總額間之差額認列為損益，並列報於營業外收入及支出項下。

(3)金融資產及負債之互抵

金融資產及金融負債僅於合併公司有法定權利進行互抵及有意圖以淨額交割或同時變現資產及清償負債時，方予以互抵並以淨額表達於資產負債表。

(八)存貨

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。成本包括使其達可供使用之地點及狀態所發生之必要支出，並採加權平均法計算。淨變現價值係正常營業下之估計售價減除至完工尚需投入之成本及銷售費用為計算基礎。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(九)投資關聯企業

關聯企業係指合併公司對其財務及營運政策具有重大影響力但未達控制能力者。合併公司持有被投資公司百分之二十至百分之五十之表決權時，即假設具有重大影響力，並採權益法評價。

在權益法下，原始取得時係依成本認列，投資成本包含交易之成本。投資關聯企業之帳面金額包括原始投資時所辨認之商譽，減除任何累計減損損失。

合併財務報告包括自具有重大影響力之日起至喪失重大影響力之日止，於進行與合併公司會計政策一致性之調整後，合併公司依權益比例認列各該投資關聯企業之損益及其他綜合損益之金額。

合併公司與關聯企業間之交易所產生之未實現損益，已在合併公司對該被投資公司之權益範圍內予以消除。

當合併公司依比例應認列關聯企業之損失份額等於或超過其在關聯企業之權益時，即停止認列其損失，而僅於發生法定義務、推定義務或已代該被投資公司支付款項之範圍內，認列額外之損失及相關負債。

(十)不動產、廠房及設備

1.認列與衡量

不動產、廠房及設備之認列及衡量係採成本模式，依成本減除累計折舊與累計減損後之金額衡量。成本包含可直接歸屬於取得資產之支出、任何其他使資產達預計用途之可使用狀態的直接可歸屬成本、拆卸與移除該項目及復原所在地點之成本。此外，為整合相關設備功能而購入之軟體亦資本化為該設備之一部分。

當不動產、廠房及設備包含不同組成部分，且相對於該項目之總成本若屬重大而採用不同之折舊方法較為合宜時，則視為不動產、廠房及設備之單獨項目(主要組成部分)處理。

不動產、廠房及設備之處分損益，以淨額認列於營業外收入及支出項下。

2.後續成本

若不動產、廠房及設備項目後續支出所預期產生之未來經濟效益很有可能流入合併公司，且其金額能可靠衡量，則該支出認列為該項目帳面金額之一部分，被重置部分之帳面金額則予以除列。不動產、廠房及設備之日常維修成本於發生時認列為損益。

3.折舊

折舊係依資產成本減除殘值後按估計耐用年限採直線法計提，並依資產之各別重大組成部分評估，若一組成部分之耐用年限不同於資產之其他部分，則此組成部分應單獨提列折舊。折舊之提列認列為損益。

當期及比較期間之估計耐用年限如下：

(1)房屋及建築物：20~40年

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(2)機器設備：3~5年

(3)其他設備：2~8年

每年至少於財務年度結束日檢視不動產、廠房及設備之折舊方法、耐用年限及殘值，若有變動，視為會計估計變動。

(十一)租賃

營業租賃之租金給付依直線法於租賃期間認列為費用。

(十二)無形資產

1.研究與發展

研究階段係指預期為獲取及瞭解嶄新的科學或技術知識而進行之活動，相關支出於發生時認列於損益。

發展階段之支出於同時符合下列所有條件時，認列為無形資產；未同時符合者，於發生時即認列於損益：

- (1)完成無形資產之技術可行性已達成，使該無形資產將可供使用或出售。
- (2)意圖完成該無形資產，並加以使用或出售。
- (3)有能力使用或出售該無形資產。
- (4)無形資產將很有可能產生未來經濟效益。
- (5)具充足之技術、財務及其他資源，以完成此項發展，並使用或出售該無形資產。
- (6)歸屬於該無形資產發展階段之支出能可靠衡量。

2.其他無形資產

合併公司取得其他無形資產係以成本減除累計攤銷與累計減損衡量之。

3.後續支出

後續支出僅於可增加相關特定資產的未來經濟效益時，方將其資本化。

4.攤銷

攤銷時係以資產成本減除殘值後金額為可攤銷金額，自達可供使用狀態起，按估計耐用年限採直線法攤銷，攤銷數認列於損益。

每年至少於財務年度結束日檢視無形資產之殘值、攤銷期間及攤銷方法，若有變動，視為會計估計變動。

(十三)非金融資產減損

針對存貨及遞延所得稅資產以外之非金融資產，合併公司於每一報導日評估是否發生減損，就有減損跡象之資產(個別資產或現金產生單位)估計其可回收金額，並就可回收金額低於帳面價值之資產，認列減損損失。於以前年度所認列除商譽以外之累計減損損失，嗣後若已不存在或減少，則迴轉增加帳面價值至可回收金額，惟不超過資產在未認列減損損失下，減除應提列折舊或攤銷之數。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(十四)收入認列

正常活動中銷售商品所產生之收入，係考量退回、商業折扣及數量折扣後，按已收或應收對價之公允價值衡量。收入係俟具說服力之證據存在、所有權之重大風險及報酬已移轉予買方、價款很有可能收回及相關成本與可能之商品退回能可靠估計、不持續參與商品之管理及收入金額能可靠衡量時加以認列。若折扣很有可能發生且金額能可靠衡量時，則於銷售認列時予以認列作為收入之減項。

風險及報酬移轉之時點係視銷售合約個別條款而定。

(十五)員工福利

1.確定提撥計畫

確定提撥退休金計畫之提撥義務係於員工提供勞務期間內認列為損益項下之員工福利費用。

2.確定福利計畫

合併公司在確定福利退休金計畫下之淨義務係針對福利計畫以員工當期或過去服務所賺得之未來福利金額折算為現值計算。任何未認列之前期服務成本及計畫資產之公允價值均予以減除。折現率係以到期日與合併公司淨義務期限接近，且計價幣別與預期支付福利金相同之政府公債之市場殖利率於年度報導日之利率為主。

企業淨義務每年由精算師以預計單位福利法精算。當計算結果對合併公司有利時，認列資產係以任何未認列之前期服務成本，及未來得以從該計畫退還之資金或減少未來對該計畫之提撥等方式所可獲得經濟效益現值之總額為限。計算經濟效益現值時應考量任何適用於合併公司任何計畫之最低資金提撥需求。一項效益若能在計畫期間內或計畫負債清償時實現，對合併公司而言，即具有經濟效益。

民國一〇一年一月一日(金管會認可之國際財務報導準則轉換日)，所有精算損益皆認列於保留盈餘。合併公司所有確定福利計畫續後產生之精算損益立即認列於其他綜合損益。

3.短期員工福利

短期員工福利義務係以未折現之基礎衡量，且於提供相關服務時認列為費用。

有關短期現金紅利或分紅計畫下預期支付之金額，若係因員工過去提供服務而使合併公司負有現時之法定或推定支付義務，且該義務能可靠估計時，將該金額認列為負債。

(十六)股份基礎給付交易

給與員工之股份基礎給付獎酬以給與日之公允價值，於員工達到可無條件取得報酬之期間內，認列酬勞成本並增加相對權益。認列之酬勞成本係隨預期符合服務條件及非市價既得條件之獎酬數量予以調整；而最終認列之金額係以既得日符合服務條件及非市價既得條件之獎酬數量為基礎衡量。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

股份基礎給付協議之給與日在民國九十七年一月一日前，且既得日在民國一〇一年一月一日(金管會認可之國際財務報導準則轉換日)前之員工認股權計畫，選擇適用國際財務報導準則第1號之豁免，依金管會民國九十八年一月十日發布之證券發行人財務報告編製準則及財團法人中華民國會計研究發展基金會公布之各號財務會計準則公報及其解釋(以下簡稱先前一般公認會計原則)認列，採用內含價值法認列酬勞性員工認股選擇權計畫之酬勞成本，亦即按衡量日本公司股票市價與行使價格間之差額估計為酬勞成本，並於員工認股選擇權計畫所規定之員工服務年限內認列為合併公司之費用，同時增加合併公司之股東權益。

(十七)所得稅

所得稅費用包括當期及遞延所得稅。除與企業合併、直接認列於權益或其他綜合損益之項目相關者外，當期所得稅及遞延所得稅應認列於損益。

當期所得稅包括當年度課稅所得(損失)按報導日之法定稅率或實質性立法稅率計算之預計應付所得稅或應收退稅款，及任何對以前年度應付所得稅的調整。

遞延所得稅係就資產及負債於財務報導目的之帳面金額與其課稅基礎之暫時性差異予以衡量認列。

遞延所得稅係以預期資產實現或負債清償當期之稅率衡量，並以報導日之法定稅率或實質性立法稅率為基礎。

合併公司僅於同時符合下列條件時，始將遞延所得稅資產及遞延所得稅負債互抵：

- 1.有法定執行權將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵；且
- 2.遞延所得稅資產及遞延所得稅負債與下列由同一稅捐機關課徵所得稅之納稅主體之一有關；
 - (1)同一納稅主體；或
 - (2)不同納稅主體，惟各主體意圖在重大金額之遞延所得稅資產預期回收及遞延所得稅負債預期清償之每一未來期間，將當期所得稅負債及資產以淨額基礎清償，或同時實現資產及清償負債。

對於可遞轉後期之未使用所得稅抵減及可減除暫時性差異，在很有可能有未來課稅所得可供使用之範圍內，認列為遞延所得稅資產。並於每一報導日予以重評估，就相關所得稅利益非屬很有可能實現之範圍內予以調減。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(十八)每股盈餘

合併公司列示歸屬於本公司普通股權益持有人之基本及稀釋每股盈餘。基本每股盈餘係以歸屬於本公司普通股權益持有人之損益，除以當期加權平均流通在外普通股股數計算之。稀釋每股盈餘則係將歸屬於本公司普通股權益持有人之損益及加權平均流通在外普通股股數，分別調整所有潛在稀釋普通股之影響後計算之。合併公司之潛在稀釋普通股包括本公司尚未經股東會決議且得採股票發放之員工分紅。因盈餘或資本公積轉增資而新增之股份，採追溯調整計算。

(十九)部門資訊

營運部門係合併公司之組成部分，從事可能賺得收入並發生費用(包括與合併公司內其他組成部分間交易相關之收入及費用)之經營活動。所有營運部門之營運結果均定期由合併公司主要營運決策者複核，以制定分配資源予該部門之決策並評量其績效。各營運部門均具單獨之財務資訊。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

管理階層依金管會認可之國際財務報導準則編製本合併財務報告時，必須作出判斷、估計及假設，其將對會計政策之採用及資產、負債、收益及費用之報導金額有所影響。實際結果可能與估計存有差異。

管理當局持續檢視估計及基本假設，會計估計變動於變動期間及受影響之未來期間予以認列。

對於假設及估計之不確定性中，存有重大風險將於未來次一年度造成重大調整之相關資訊，請詳下列附註：

(一)附註六(四)，存貨之評價。

(二)附註六(九)，確定福利義務之衡量。

六、重要會計項目之說明

(一)現金及約當現金

	103.12.31	102.12.31
現金及活期存款	\$ 222,922	297,009
定期存款	956,313	753,611
	<u>\$ 1,179,235</u>	<u>1,050,620</u>

(二)金融商品

1.透過損益按公允價值衡量之金融資產

	103.12.31	102.12.31
持有供交易之金融資產－受益憑證	<u>\$ 158,476</u>	<u>263,247</u>

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

2.以成本衡量之金融資產：

	103.12.31	102.12.31
未上市(櫃)公司股票：		
Unitech Capital Inc. (Unitech)	\$ 86,750	86,750
諧永投資股份有限公司(諧永投資)	143,000	143,000
金佶科技股份有限公司(金佶)	-	8,820
	<u>\$ 229,750</u>	<u>238,570</u>

為擴展本公司在指紋辨識應用產品市場領域，民國一〇三年五月本公司透過盛凌投資參與金佶之現金增資案，增資後盛凌投資對金佶之持股比例增加至32.17%，並將對金佶之投資轉列至採用權益法之投資項下。

(三)應收票據及帳款淨額

	103.12.31	102.12.31
應收票據	\$ 531	1,530
應收帳款	109,818	96,979
	110,349	98,509
減：備抵呆帳	(7,393)	(7,393)
	<u>\$ 102,956</u>	<u>91,116</u>

合併公司於民國一〇三年度及一〇二年度針對應收票據及應收帳款並無提列(迴轉)減損損失情形。

(四)存貨

	103.12.31	102.12.31
原料及物料	\$ 125,326	132,437
在製品	138,897	133,862
製成品及商品	236,758	248,903
	<u>\$ 500,981</u>	<u>515,202</u>

營業成本組成明細如下：

	103年度	102年度
銷貨成本	\$ 2,041,548	2,070,502
迴轉存貨跌價損失	(6,000)	-
報廢成本	6,224	521
	<u>\$ 2,041,772</u>	<u>2,071,023</u>

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(五)其他金融資產－流動

	103.12.31	102.12.31
定期存款(三個月以上)	\$ 1,277,620	1,245,375
受限制銀行存款	3,583	3,576
其他	13,454	8,000
	<u>\$ 1,294,657</u>	<u>1,256,951</u>

(六)採用權益法之投資

合併公司於報導日採用權益法之投資列示如下：

	103.12.31	102.12.31
關聯企業	\$ 458,476	414,988
減：聯屬公司間未實現交易利得	(59,364)	(54,549)
	<u>\$ 399,112</u>	<u>360,439</u>

合併公司民國一〇三年度及一〇二年度所享有關聯企業利益之份額分別為57,440千元及61,252千元。

合併公司之關聯企業其未依合併公司持有之所有權比例作調整之財務資訊彙總如下：

	103.12.31	102.12.31
總資產	<u>\$ 2,651,926</u>	<u>2,515,843</u>
總負債	<u>\$ 1,376,843</u>	<u>1,362,389</u>
	103年度	102年度
收入	<u>\$ 4,926,529</u>	<u>4,403,063</u>
本期淨利	<u>\$ 166,530</u>	<u>161,046</u>

合併公司並無任何與其他投資者共同承擔關聯企業之或有負債，或對關聯企業之負債負有個別責任而產生之或有負債。

合併公司關聯企業將資金移轉予合併公司之能力並未受有重大限制。

(七)不動產、廠房及設備

合併公司不動產、廠房及設備之成本及累計折舊變動明細如下：

	土地	房屋及 建築	機器設備	其他設備	未完工程	總計
成本：						
民國103年1月1日餘額	\$ 26,676	531,036	318,672	76,654	-	953,038
增添	-	1,759	15,330	3,249	-	20,338
重分類	-	-	5,904	324	-	6,228
處分	-	-	(15,165)	(6,207)	-	(21,372)
匯率變動之影響	-	9,611	2,957	1,244	-	13,812
民國103年12月31日餘額	<u>\$ 26,676</u>	<u>542,406</u>	<u>327,698</u>	<u>75,264</u>	<u>-</u>	<u>972,044</u>

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

	土 地	房 屋 及 建 築	機 器 設 備	其 他 設 備	未 完 工 程	總 計
民國102年1月1日餘額	\$ 26,676	475,002	320,914	95,808	22,135	940,535
增添	-	18,042	8,839	2,547	1,868	31,296
重分類	-	24,459	3,807	778	(24,459)	4,585
處分	-	-	(19,152)	(24,614)	-	(43,766)
匯率變動之影響	-	13,533	4,264	2,135	456	20,388
民國102年12月31日餘額	<u>\$ 26,676</u>	<u>531,036</u>	<u>318,672</u>	<u>76,654</u>	<u>-</u>	<u>953,038</u>
累計折舊：						
民國103年1月1日餘額	\$ -	136,585	258,332	58,613	-	453,530
本期折舊	-	21,501	21,136	5,206	-	47,843
處分	-	-	(15,132)	(6,207)	-	(21,339)
匯率變動之影響	-	1,099	2,253	795	-	4,147
民國103年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>159,185</u>	<u>266,589</u>	<u>58,407</u>	<u>-</u>	<u>484,181</u>
民國102年1月1日餘額	\$ -	115,196	253,038	75,174	-	443,408
本期折舊	-	20,709	21,761	5,738	-	48,208
處分	-	-	(19,152)	(23,606)	-	(42,758)
匯率變動之影響	-	680	2,685	1,307	-	4,672
民國102年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>136,585</u>	<u>258,332</u>	<u>58,613</u>	<u>-</u>	<u>453,530</u>
帳面價值：						
民國103年12月31日	<u>\$ 26,676</u>	<u>383,221</u>	<u>61,109</u>	<u>16,857</u>	<u>-</u>	<u>487,863</u>
民國102年12月31日	<u>\$ 26,676</u>	<u>394,451</u>	<u>60,340</u>	<u>18,041</u>	<u>-</u>	<u>499,508</u>
民國102年1月1日	<u>\$ 26,676</u>	<u>359,806</u>	<u>67,876</u>	<u>20,634</u>	<u>22,135</u>	<u>497,127</u>

(八)營業租賃

- 1.合併公司依已簽訂之辦公室、停車位及員工宿舍租賃合約，預估未來最低租金給付額彙列如下：

	103.12.31	102.12.31
一年內	\$ 14,789	12,621
一年以上至二年	5,449	5,900
二年以上	-	420
	<u>\$ 20,238</u>	<u>18,941</u>

- 2.本公司位於新竹科學工業園區廠房之土地係向科學工業園區管理局承租，租賃期間自民國九十年三月十五日起至民國一〇九年十二月三十一日止，且租賃期間屆滿時得另訂新約。自民國一〇二年五月起租金每年約為3,360千元，如遇政府調整地價時，租金亦隨同調整。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(九)員工福利

1.確定福利計畫

合併公司確定福利義務現值與計畫資產公允價值之調節如下：

	103.12.31	102.12.31
未提撥義務現值	\$ 106,093	108,330
計畫資產之公允價值	(47,839)	(47,501)
已認列之確定福利義務負債	<u>\$ 58,254</u>	<u>60,829</u>

合併公司之確定福利計畫係提撥至台灣銀行之勞工退休準備金專戶。適用勞動基準法之每位員工之退休支付，係依據服務年資所獲得之基數及其退休前六個月之平均薪資計算。

(1)計畫資產組成

合併公司依勞動基準法提撥之退休基金係由勞動部勞動基金運用局(以下簡稱勞動基金局)統籌管理，依「勞工退休基金收支保管及運用辦法」規定，基金之運用，其每年決算分配之最低收益，不得低於依當地銀行二年定期存款利率計算之收益。

截至報導日，合併公司之台灣銀行勞工退休準備金專戶餘額計47,839千元。勞工退休基金資產運用之資料包括基金收益率以及基金資產配置，請詳勞動基金局網站公布之資訊。

(2)確定福利義務現值之變動

合併公司民國一〇三年度及一〇二年度確定福利義務現值變動如下：

	103年度	102年度
1月1日確定福利義務	\$ 108,330	112,743
計畫支付之福利	(3,636)	-
當期服務成本及利息	2,167	1,970
精算利益	(768)	(6,383)
12月31日確定福利義務	<u>\$ 106,093</u>	<u>108,330</u>

(3)計畫資產現值之變動

合併公司民國一〇三年度及一〇二年度確定福利計畫資產現值之變動如下：

	103年度	102年度
1月1日計畫資產之公允價值	\$ 47,501	44,043
計畫支付之福利	(3,636)	-
計畫資產預計報酬	979	796
計劃參與者之提撥	2,875	3,029
精算利益(損失)	120	(367)
12月31日計畫資產之公允價值	<u>\$ 47,839</u>	<u>47,501</u>

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(4)認列為損益之費用

合併公司民國一〇三年度及一〇二年度認列為損益之費用如下：

	103年度	102年度
利息成本	\$ 2,167	1,970
計畫資產預計報酬	(979)	(796)
	<u>\$ 1,188</u>	<u>1,174</u>
計畫資產實際報酬	<u>\$ 1,099</u>	<u>429</u>

(5)認列為其他綜合損益之精算損益

合併公司民國一〇三年度及一〇二年度認列為其他綜合損益之精算損益如下：

	103年度	102年度
1月1日累積餘額	\$ (3,214)	2,802
本期認列	(888)	(6,016)
12月31日累積餘額	<u>\$ (4,102)</u>	<u>(3,214)</u>

(6)精算假設

合併公司所使用之主要精算假設如下：

A.用於精算民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日確定福利義務現值者

	103.12.31	102.12.31
折現率	2.10%	2.00%
計畫資產預期報酬率	2.00%	2.00%
未來薪資成長率	2.10%	2.00%

B.用於精算民國一〇三年度及一〇二年度確定福利計劃成本者

	103年度	102年度
折現率	2.00%	1.75%
計畫資產預期報酬率	2.00%	1.75%
未來薪資成長率	2.00%	2.00%

計畫資產預期報酬率係以整體投資組合為基礎，而非加總個別資產類別之報酬。此一報酬率純粹以歷史報酬率為基礎，不作調整。

(7)經驗調整之歷史資訊

	103.12.31	102.12.31	101.12.31	101.1.1
確定福利義務之現值	\$ 106,093	108,330	112,743	122,400
計畫資產之公允價值	(47,839)	(47,501)	(44,043)	(41,908)
確定福利義務淨負債	<u>\$ 58,254</u>	<u>60,829</u>	<u>68,700</u>	<u>80,492</u>
確定福利計畫現值金額之經驗調整	<u>\$ (902)</u>	<u>1,815</u>	<u>811</u>	-
計畫資產公允價值金額之經驗調整	<u>\$ 120</u>	<u>(367)</u>	<u>(310)</u>	-

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

合併公司預計於民國一〇三年度報導日後之一年內支付予確定福利計畫之提撥金額為2,822千元。

(8)計算確定福利義務現值時，合併公司必須運用判斷及估計以決定資產負債表日相關精算假設，包含員工離職率及未來薪資變動等。任何精算假設之變動，均可能重大影響合併公司確定福利義務之金額。

合併公司民國一〇三年十二月三十一日之應計退休金負債之帳面金額為58,254千元，當採用之折現率及未來薪資成長率增減變動1%時，合併公司認列之應計退休金負債增減變動如下：

精算假設	應計退休金負債	
	增加1%	減少1%
折現率	\$ (15,107)	18,214
未來薪資成長率	\$ 16,834	(14,357)

2.確定提撥計畫

合併公司之國內子公司其確定提撥計畫係依勞工退休金條例之規定，依勞工每月工資6%之提繳率，提撥至勞動部勞工保險局(以下簡稱勞工保險局)之勞工退休金個人專戶。在此計畫下合併公司提撥固定金額至勞工保險局後，即無支付額外金額之法定或推定義務。合併公司民國一〇三年度及一〇二年度確定提撥退休金辦法下之退休金費用分別為18,495千元及18,036千元，已提撥至勞工保險局。

除上，民國一〇三年度及一〇二年度各國外分公司及合併子公司依當地相關法令認列之退休金費用分別為14,371千元及12,094千元。

(十)所得稅

1.所得稅費用(利益)

合併公司民國一〇三年度及一〇二年度費用(利益)明細如下：

	103年度	102年度
當期所得稅費用		
當期產生	\$ 116,739	70,641
調整前期之當期所得稅	9,853	(3,212)
	126,592	67,429
遞延所得稅費用		
暫時性差異之發生及迴轉	15,013	68,538
認列前期未認列之遞延所得稅資產	(1,670)	(1,735)
	13,343	66,803
所得稅費用	\$ 139,935	134,232

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

合併公司民國一〇三年度及一〇二年度認列於其他綜合損益項下之所得稅費用明細如下：

	103年度	102年度
國外營運機構財務報告換算之兌換差額	\$ 6,130	6,324
確定福利計畫之精算利益	151	546
	<u>\$ 6,281</u>	<u>6,870</u>

合併公司所得稅費用與稅前淨利之關係調節如下：

	103年度	102年度
稅前淨利	\$ 938,519	882,032
依本公司所在地國內稅率計算之所得稅	159,548	149,945
永久性差異調整	(6,065)	(7,468)
免稅所得	(12,511)	(38,237)
投資抵減預期失效(新增)數	(16,014)	28,952
以前年度所得稅核定及估計差異	9,853	(3,207)
認列前期未認列之遞延所得稅資產	(1,670)	(1,735)
其他	6,794	5,982
	<u>\$ 139,935</u>	<u>134,232</u>

2.遞延所得稅資產及負債

(1)未認列之遞延所得稅資產

優方未認列為遞延所得稅資產之項目如下：

	103.12.31	102.12.31
前期虧損扣抵之稅額	\$ -	1,670

優方於民國一〇二年度將先前未認列之虧損扣抵相關稅額1,735千元認列為遞延所得稅資產，主因管理階層認為未來很有可能產生足夠之課稅所得以使用該部份虧損扣抵。管理階層修正該估計係因觸控領域相關產品逐漸打入中國市場，並提升銷售之營運績效。另，後續隨著對未來營運績效估計之變動，民國一〇三年進一步再將先前未認列之虧損扣抵相關稅額1,670千元認列為遞延所得稅資產。

(2)已認列之遞延所得稅資產及負債

遞延所得稅資產

	102.1.1	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	102.12.31	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	103.12.31
存貨跌價損失	\$ 11,900	-	-	11,900	1,020	-	10,880
未實現聯屬公司間利益	10,494	(908)	-	11,402	(3,307)	-	14,709
應計退休金負債	11,204	317	546	10,341	287	151	9,903
投資抵減	56,068	56,068	-	-	-	-	-
其他	1,829	(172)	-	2,001	(404)	-	2,405
	<u>\$ 91,495</u>	<u>55,305</u>	<u>546</u>	<u>35,644</u>	<u>(2,404)</u>	<u>151</u>	<u>37,897</u>

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

遞延所得稅負債

	102.1.1	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	102.12.31	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	103.12.31
國外營運機構財務報告 換算之兌換利益	\$ (1,002)	-	6,324	(7,326)	-	6,130	(13,456)
採權益法認列之國外投 資利益	(37,310)	11,047	-	(48,357)	13,318	-	(61,675)
其他	(4)	451	-	(455)	2,429	-	(2,884)
	<u>\$ (38,316)</u>	<u>11,498</u>	<u>6,324</u>	<u>(56,138)</u>	<u>15,747</u>	<u>6,130</u>	<u>(78,015)</u>

3.本公司營利事業所得稅結算申報已奉稅捐稽徵機關核定至民國一〇〇年度。

4.兩稅合一相關資訊如下：

	103.12.31	102.12.31
屬民國八十七年度以後之未分配盈餘	<u>\$ 794,417</u>	<u>761,084</u>
可扣抵稅額帳戶餘額	<u>\$ 39,969</u>	<u>2,852</u>
	103年度 (預計)	102年度 (實際)
對中華民國居住者盈餘分配之稅額扣抵比率	<u>14.28%</u>	<u>9.40%</u>

5.本公司民國一〇〇年度營利事業所得稅結算申報案件，因對免稅所得之計算與稅捐稽徵機關之見解不同，經核定補徵稅額18,255千元。本公司雖不服稅捐稽徵機關之核定並提出行政救濟申請，惟於所得稅估列時業已考量稅捐稽徵機關核定結果之影響。

(十一)資本及其他權益

1.股本

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日本公司額定股本均為3,000,000千元(均含保留供發行員工認股權憑證200,000千元及可轉換公司債500,000千元之額度)，實收股本分別為2,261,682千元及2,249,412千元，每股面額10元。

本公司員工於民國一〇二年度行使九十六年發行之員工認股權憑證計2,569,750股，截至民國一〇二年十二月三十一日止，尚有1,227,000股未完成法定登記程序，帳列預收股本40,368千元。前述員工認股權憑證於民國一〇三年間皆已完成法定登記程序。

2.資本公積

依公司法規定，資本公積需優先填補虧損後，始得以已實現資本公積之全部或一部轉作資本或發放現金。前項所稱之已實現資本公積，包括超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得。依發行人募集與發行有價證券處理準則規定，得撥充資本之資本公積，每年撥充之合計金額，不得超過實收資本額百分之十。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

3.法定盈餘公積

依公司法規定，公司應就稅後純益提撥百分之十為法定盈餘公積，直至與資本總額相等為止。公司無虧損時，得經股東會決議，以法定盈餘公積發給新股或現金，惟以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

4.特別盈餘公積

本公司於首次採用金管會認可之國際財務報導準則時，因選擇適用國際財務報導準則第一號「首次採用國際財務報導準則」豁免項目，調整帳列股東權益項下之累積換算調整數而增加保留盈餘之金額為18,008千元；另就轉換日之精算損益調整減列保留盈餘13,410千元。依金管會民國一〇一年四月六日金管證發字第1010012865號令規定，應就因轉換採用金管會認可之國際財務報導準則產生之保留盈餘淨增加數4,598千元提列特別盈餘公積，並於使用、處分或重分類相關資產時，得就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉分派盈餘。本公司轉投資之海外子公司盛揚半導體(深圳)有限公司已於民國一〇三年八月完成清算各項權利義務及註銷登記，本公司依據前述函令規定，就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉特別盈餘公積併入保留盈餘計1,956千元。截至民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日止，該項特別盈餘公積餘額分別為2,642千元及4,598千元。

又依上段所述函令規定，本公司於分派可分配盈餘時，就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額與上段所提列特別盈餘公積餘額之差額，自當期損益與前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積；屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積不得分派。嗣後其他股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

5.盈餘分派

依本公司章程規定，年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：

- (1)提繳稅捐。
- (2)彌補虧損。
- (3)提存百分之十為法定盈餘公積。
- (4)依證券交易法提列或迴轉特別盈餘公積。
- (5)員工紅利就依一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之十三·五。
- (6)董事監察人酬勞就一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之一·五。
- (7)扣除前各項餘額後，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派之。

上述股東股利部份，其中現金股利不低於當年度發放股東現金股利及股東股票股利合計數之百分之五十。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

本公司依證券主管機關規定於分派盈餘時，應就當年度發生之股東權益減項自可分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，不得分派。嗣後股東權益減項有迴轉時，得就迴轉部分併入可分派盈餘。

本公司以民國一〇三年度及一〇二年度之稅後淨利依本公司章程所定盈餘分派政策，估計員工紅利金額分別為96,174千元及90,511千元，董事監察人酬勞分別為10,686千元及10,057千元，配發股票紅利之股數計算基礎係依據股東會決議前一日之收盤價並考量除權除息之影響。若嗣後股東會決議實際配發金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動，列為下一年度之損益。

本公司民國一〇二年度及一〇一年度盈餘分派案，分別於民國一〇三年六月十一日及一〇二年六月十一日經股東常會決議，分派之每股股利、員工紅利及董事監察人酬勞如下：

	102年度	101年度
普通股每股現金股利(元)	<u>\$ 3.3</u>	<u>2.5</u>
員工紅利－現金紅利	\$ 90,511	68,064
董事監察人酬勞	<u>10,057</u>	<u>7,563</u>
	<u>\$ 100,568</u>	<u>75,627</u>

上述民國一〇二年度及一〇一年度盈餘分派情形與本公司董事會擬議內容並無差異。

本公司民國一〇三年度盈餘分派案，尚待本公司董事會擬議及股東會決議，相關資訊可俟相關會議召開後至公開資訊觀測站等管道查詢之。

(十二)股份基礎給付

本公司於民國一〇二年度尚在存續期間之員工認股權憑證發行情形彙列如下：

種 類	申報生效日期	給與日	既得期間	給與單位數 (千單位)	每股認購 價格(元)	衡量日每股 市價(元)	調整後履約 價格(元)
96年第一次 員工認股權	96.12.31	96.12.31	4年	4,000	49.45	49.45	32.90

上述員工認股權憑證於民國一〇一年一月一日前皆已既得，依國際財務報導準則第一號公報「首次採用國際財務報導準則」之規定，不予追溯重新計算認列酬勞成本。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

本公司酬勞性員工認股選擇權計畫相關數量及加權平均行使價格資訊揭露如下：
(以千單位表達)

	102年度	
	加權平均履 約價格(元)	認股權 數 量
1月1日流通在外	\$ 35.40	2,776
本期行使	32.98	(2,570)
本期失效	32.98	(206)
12月31日流通在外		-

(十三)每股盈餘

歸屬於本公司每股盈餘之計算列示如下：

	103年度	102年度
基本每股盈餘：		
本期淨利	\$ 791,556	744,945
計算每股盈餘之加權平均流通在外股數 (千股)	226,168	224,158
基本每股盈餘(元)	\$ 3.50	3.32
稀釋每股盈餘：		
本期淨利	\$ 791,556	744,945
加權平均流通在外股數(千股)	226,168	224,158
具稀釋作用潛在普通股之影響(千股)	2,494	3,175
計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數 (千股)	228,662	227,333
稀釋每股盈餘(元)	\$ 3.46	3.28

(十四)營業外收入及支出

綜合損益表所列之其他利益淨額明細如下：

	103年度	102年度
外幣兌換利益淨額	\$ 20,109	22,375
股利收入	4,558	2,245
其他	12,437	17,360
	\$ 37,104	41,980

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(十五)金融工具

1.金融工具之種類

金融資產

	103.12.31	102.12.31
現金及約當現金	\$ 1,179,235	1,050,620
應收票據及帳款(含關係人)	674,909	620,098
透過損益按公允價值衡量之金融資產	158,476	263,247
其他金融資產－流動	1,294,657	1,256,951
存出保證金(帳列其他非流動資產)	6,457	5,296
	\$ 3,313,734	3,196,212

金融負債

	103.12.31	102.12.31
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 471,782	458,662
存入保證金	7,597	7,597
	\$ 479,379	466,259

2.信用風險

(1)信用風險之暴險

金融資產之帳面金額代表最大信用暴險金額。民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之最大信用暴險金額分別為3,313,734千元及3,196,212千元。

合併公司之潛在信用風險係源自金融資產交易對方或他方未履行合約之潛在影響，主要來自於本公司之現金及約當現金、約定期間三個月以上之定期存款及應收客戶之帳款。

合併公司之現金及約當現金及定期存款存放於信用良好之銀行，發生信用風險可能性低。

合併公司主要銷售對象為國內外信譽良好之公司，除依授信作業程序給予客戶信用額度外，並持續了解客戶之信用狀況，民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日佔合併公司應收票據及帳款(含關係人)10%以上客戶之帳款金額分別為326,199千元及251,104千元，使合併公司有應收帳款信用風險集中之情形，惟已定期評估應收帳款之回收可能性並提列適當備抵呆帳，管理當局預期未來不致有重大損失。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(2)減損損失

報導日應收款項之帳齡分析如下：

	103.12.31		102.12.31	
	總額	減損	總額	減損
未逾期	\$ 676,918	2,009	623,090	2,992
逾期0~30天	4,966	4,966	4,401	4,401
逾期31~120天	418	418	-	-
	<u>\$ 682,302</u>	<u>7,393</u>	<u>627,491</u>	<u>7,393</u>

3.流動性風險

下表為金融負債之合約到期日分析：

	帳面金額	合 約 現金流量	1年以內	超過5年
103年12月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 471,782	471,782	471,782	-
存入保證金	7,597	7,597	-	7,597
	<u>\$ 479,379</u>	<u>479,379</u>	<u>471,782</u>	<u>7,597</u>
102年12月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 458,662	458,662	458,662	-
存入保證金	7,597	7,597	-	7,597
	<u>\$ 466,259</u>	<u>466,259</u>	<u>458,662</u>	<u>7,597</u>

合併公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

4.匯率風險

(1)匯率風險之暴險

合併公司暴露於重大外幣匯率風險之金融資產及負債如下：

	103.12.31			102.12.31			
	外幣	匯率	台幣	外幣	匯率	台幣	
<u>金融資產</u>							
<u>貨幣性項目</u>							
美金	\$	3,323	31.6	104,996	7,442	29.805	221,808
人民幣		91,243	5.067	462,329	67,608	4.919	332,566
<u>非貨幣性項目</u>							
美金	\$	9,138	31.65	289,205	8,811	29.805	262,625

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

	103.12.31			102.12.31			
	外幣	匯率	台幣	外幣	匯率	台幣	
金融負債							
貨幣性項目							
美 金	\$	4,829	31.65	152,849	5,320	29.805	158,558
人 民 幣		14,389	5.092	73,269	393	4.919	1,934

(2)敏感性分析

合併公司之匯率風險主要來自於以外幣計價之現金、應收帳款及其他應收款及應付帳款等，於換算時產生外幣兌換損益。於民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日當新台幣相對於美金及人民幣貶值或升值1%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一〇三年度及一〇二年度之稅後淨利將分別增加或減少2,832千元及3,280千元。

4.公允價值

(1)公允價值與帳面金額

除詳列於下表者外，合併公司之管理階層認為合併公司以攤銷後成本衡量之金融資產及金融負債於合併財務報告中之帳面金額趨近於其公允價值：

	103.12.31		102.12.31	
	帳面金額	公允價值	帳面金額	公允價值
金融資產：				
透過損益按公允價值衡量之金				
融資產	\$ 158,476	158,476	263,247	263,247

(2)衡量公允價值所採用之評價技術及假設

金融資產如有活絡市場公開報價時，則以此市場價格為公平價值。若無市場價格可供參考時，則採用評價方法估計，所使用之估計與假設係與市場參與者於金融商品訂價時用以作為估計及假設之資訊一致。

(3)公允價值層級

下表按評價方式，分析以公允價值衡量之金融工具，各公允價值層級定義如下：

- A.第一級：相同資產或負債於活絡市場之公開報價(未經調整)。
- B.第二級：除包含於第一級之公開報價外，資產或負債之輸入參數係直接(即價格)或間接(即由價格推導而得)可觀察。
- C.第三級：資產或負債之輸入參數非基於可觀察之市場資料(非可觀察參數)。

	第一級	第二級	第三級	合計
103年12月31日				
透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$ 158,476	-	-	158,476

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

	第一級	第二級	第三級	合 計
102年12月31日				
透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$ 263,247	-	-	263,247

民國一〇三年度及一〇二年度並無任何公允價值層級移轉情形。

(十六)財務風險管理

1.風險管理架構

董事會全權負責發展及控管合併公司之風險管理政策。

合併公司之風險管理政策之建置係為辨認及分析合併公司所面臨之風險，及設定適當風險限額及控制，並監督風險及風險限額之遵循。風險管理政策及系統係定期覆核以反映市場情況及合併公司運作之變化。合併公司透過訓練、管理準則及作業程序，以發展有紀律且具建設性之控制環境，使所有員工了解其角色及義務。

合併公司之董事會監督管理階層如何監控合併公司風險管理政策及程序之遵循，及覆核合併公司對於所面臨風險之相關風險管理架構之適當性。內部稽核人員協助合併公司董事會扮演監督角色。該等人員進行定期及例外覆核風險管理控制及程序，並將覆核結果報告予董事會。

2.信用風險

有關現金及約當現金、應收款項之信用風險分析，請詳附註六(十五)。另，截至民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日止，合併公司均無提供任何背書保證。

3.流動性風險

流動性風險係合併公司無法交付現金或其他金融資產以清償金融負債，未能履行相關義務之風險。合併公司管理流動性之方法係盡可能確保合併公司在一般及具壓力之情況下，皆有足夠之流動資金以支應到期之負債，而不致發生不可接受之損失或使合併公司之聲譽遭受到損害之風險。

流動性風險係由合併公司之財務部門所監控，持續監督合併公司實際現金流量部位，並使用多方面的資訊，預測並監控合併公司在長期與短期之現金流動部位，財務部門並投資額外之現金於適當到期日之存款或短期性投資，並確保合併公司之流動性，足以因應即將到期之負債。截至民國一〇三年十二月三十一日止，合併公司之營運資金及目前尚有銀行未動支之借款額度158,250千元，應足以支應履行所有合約義務，故未有無法籌措資金以履行合約義務之流動性風險。

4.市場風險

市場風險係指因市價變動，如匯率、利率、權益工具價格變動，而影響合併公司之收益或所持有金融工具價值之風險。市場風險管理之目標係管控市場風險之暴險程度在可承受範圍內，並將投資報酬最佳化。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

合併公司為管理市場匯率及權益證券價格變動風險，所有重大交易之執行均經董事會之覆核與核准，相關財務操作亦受內部稽核部門之監督。相關之管理說明如下：

(1)合併公司暴露於非以各該集團企業之功能性貨幣計價之銷售及採購交易所產生之匯率風險。集團企業之功能性貨幣以新台幣為主，亦有美金及人民幣，該等交易主要之計價貨幣有新台幣、美元及人民幣。

有關外幣計價之貨幣性資產及負債，當發生短期不平衡時，合併公司係藉由以即時匯率買進或賣出外幣，以確保淨暴險保持在可接受之水準。

(2)投資組合中重大投資均採個別管理，且所有買賣決策均經董事會之核准。

(十七)資本管理

董事會管理資本之目標係確保合併公司於繼續經營與成長之前提下，藉由將債務及權益餘額最適化，以提供股東足夠之報酬。

董事會之資本結構管理策略，係依據合併公司所營事業之產業規模、產業未來之成本與產品發展藍圖，以設定合併公司適當之市場佔有率，並據以規劃所需之營運資金與現金，以對合併公司長期發展所需之各項資產規模，做出整體性之規劃；最後根據合併公司產品競爭力推估可能之產品邊際貢獻、營業利益率與現金流量，並考量產業景氣循環波動、產品生命週期等風險因素，以決定合併公司適當之資本結構。

董事會定期審核資本結構，並考量不同資本結構可能涉及之成本與風險。

截至民國一〇三年十二月三十一日止，合併公司資本管理之方式並未改變。

合併公司於報導日之負債權益比率如下：

	103.12.31	102.12.31
負債總額	<u>\$ 1,001,959</u>	<u>955,117</u>
權益總額	<u>\$ 4,057,607</u>	<u>3,974,368</u>
負債權益比率	<u>24.69%</u>	<u>24.03%</u>

七、關係人交易

(一)與關係人間之重大交易事項

1.銷售

合併公司對關係人之重大銷售金額如下：

	103年度	102年度
關聯企業	<u>\$ 2,632,831</u>	<u>2,553,662</u>

合併公司之銷售價格依銷售之產品規格而定，並視銷售之數量給予不定幅度之折扣；銷售予關係人之收款條件約為月結60天至90天。合併公司與一般客戶之銷售交易收款條件則視個別客戶之交易往來經驗及債信評估結果決定採預收貨款、即期電匯或月結30天至60天不等。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

截至民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日止，合併公司與採權益法評價之被投資公司間因銷貨交易所產生之未實現銷貨毛利分別為59,364千元及54,549千元，帳列採用權益法之投資項下。

合併公司因上述銷貨交易產生之應收關係人款項明細如下：

	103.12.31	102.12.31
關聯企業	\$ 571,953	528,982

2.進貨及其他交易

合併公司向關係人進貨金額如下：

	103年度	102年度
關聯企業	\$ 1,582	76

合併公司與關係人間之進貨交易條件與一般供應商尚無明顯不同。

合併公司支付關係人耗材費、雜項購置及委託關係人提供積體電路銷售服務之金額如下：

	103年度	102年度
關聯企業	\$ 3,537	4,602

合併公司因上述進貨及其他交易產生之應付關係人款項如下：

	103.12.31	102.12.31
關聯企業	\$ 2,024	-

(二)主要管理階層人員交易

主要管理階層人員報酬如下：

	103年度	102年度
短期員工福利	\$ 24,001	23,699
退職後福利	432	432
	\$ 24,433	24,131

八、質押之資產

資產名稱	質押擔保標的	103.12.31	102.12.31
定期存款(帳列其他金融資產—流動)	進口關稅保證金	\$ 3,583	3,576

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

(一)合併公司與Dolphin公司及ARM公司等簽有技術授權合約，合約中訂定當合併公司銷售之產品若有運用約定技術時，需依雙方議定價格支付權利金。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(二)德鼎樞紐法律事務所於民國一〇三年五月對本公司提起民事訴訟，請求給付法律服務費用及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年利率百分之五計算之利息。本公司已委任律師處理相關事宜，評估前述事件對本公司目前之營業不致產生重大影響。

十、重大之災害損失：無。

十一、重大之期後事項：無。

十二、其 他

員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總如下：

功 能 別 性 質 別	103年度			102年度		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	25,647	552,307	577,954	22,397	564,680	587,077
勞健保費用	1,965	34,521	36,486	1,739	32,544	34,283
退休金費用	1,229	32,825	34,054	1,134	30,170	31,304
其他員工福利費用	1,120	14,747	15,867	1,016	14,672	15,688
折舊費用	8,265	39,578	47,843	9,742	38,466	48,208
攤銷費用	-	51,272	51,272	-	45,719	45,719

合併公司民國一〇三年度及一〇二年度平均員工人數分別為631人及619人。

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

民國一〇三年度合併公司依證券發行人財務報告編製準則之規定，應再揭露之重大交易事項相關資訊如下：

- 1.資金貸與他人：無。
- 2.為他人背書保證：無。
- 3.期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資控制部分)：

數量單位：千股(單位)

持有之 公 司	有價證券 種類及名稱	與有價證券 發行人之關係	帳列科目	期 末				期中最高 持股比例	備 註
				股 數	帳面金額	持股比例	公允價值		
本公司	第一金台灣債券基金	-	透過損益按公允價值 衡量之金融資產－流動	4,120	61,863	-	61,863	-	
本公司	統一強棒基金	-	透過損益按公允價值 衡量之金融資產－流動	5,883	96,613	-	96,613	-	
Holtek Semiconduct or Holding (BVI) Ltd.	Unitech Capital Inc.	-	以成本衡量之金融資 產	2,500	86,750	5.00%	-	5.00%	
盛凌投資股 份有限公司	瑞永投資股份有限 公司	-	以成本衡量之金融資 產	23,124	143,000	3.03%	-	3.03%	

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期 初		買 入		賣 出				期 末	
					單位數	金額	單位數	金額	單位數	售價	帳面成本	處分損益	單位數	金額
本公司	統一強棒基金	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	統一投信	-	3,926	63,933	27,503	450,960	25,546	418,826	418,328	498	5,883	96,565 (註)

註：期末金額係取得成本，依市價評價後之帳面金額請詳3。

5. 取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
 6. 處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
 7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關 係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金 額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間	單 價	授信期間	餘 額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	欣宏	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(450,322)	(12)%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	78,910	12%	
欣宏	本公司	對欣宏採權益法評價之投資公司	進貨	450,322	60%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(78,910)	(68)%	
本公司	Holtek BVI	本公司之子公司	銷貨	(374,889)	(10)%	月結90天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	196,567	31%	
Holtek BVI	本公司	Holtek BVI之母公司	進貨	374,889	100%	月結90天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(196,567)	(100)%	
本公司	ForIC	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(204,962)	(6)%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	17,240	3%	
ForIC	本公司	對ForIC採權益法評價之投資公司	進貨	204,962	90%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(17,240)	(30)%	
本公司	Newtek	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(197,704)	(5)%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	33,331	5%	
Newtek	本公司	對Newtek採權益法評價之投資公司	進貨	(197,704)	59%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(33,331)	(54)%	
本公司	Crown Rich	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(184,346)	(5)%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	32,864	5%	
Crown Rich	本公司	對Crown Rich採權益法評價之投資公司	進貨	184,346	54%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(32,864)	(32)%	
本公司	優方	本公司之子公司	銷貨	(154,213)	(4)%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	27,224	4%	
優方	本公司	優方之母公司	進貨	154,213	100%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(27,224)	(100)%	
本公司	鉅威	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(151,349)	(4)%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	14,953	2%	
鉅威	本公司	對鉅威採權益法評價之投資公司	進貨	151,349	12%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(14,953)	(9)%	
本公司	金濤	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(135,992)	(4)%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	20,913	3%	
金濤	本公司	對金濤採權益法評價之投資公司	進貨	135,992	84%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(20,913)	(86)%	

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	New Wave	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(128,514)	(4)%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	24,790	4%	
New Wave	本公司	對New Wave採權益法評價之投資公司	進貨	128,514	61%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(24,790)	(28)%	
本公司	Truetek	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(111,947)	(3)%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	19,186	3%	
Truetek	本公司	對Truetek採權益法評價之投資公司	進貨	111,947	3%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(19,186)	(30)%	

8.應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額	提列備抵呆帳金額
					金額	處理方式		
本公司	Holtek BVI	子公司	196,567	2.70	36,061	即期收款	66,298 (註)	-

註：係截至民國一〇四年一月十三日止收回之金額。

9.從事衍生性商品交易：無。

10.母子公司間業務關係及重要交易往來情形：

編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係	交易往來情形			
				科目	金額	交易條件	佔合併總營業收入或總資產之比率
0	本公司	Holtek BVI	母公司對子公司	銷貨收入	374,889	月結90天	9.54%
0	本公司	Holtek BVI	母公司對子公司	應收帳款	196,657	-	3.89%
0	本公司	優方	母公司對子公司	銷貨收入	154,213	月結60天	3.92%
0	本公司	優方	母公司對子公司	應收帳款	27,224		0.54%
0	本公司	Holtek (USA)	母公司對子公司	銷貨收入	50,743	月結60天	1.29%
0	本公司	合泰	母公司對子公司	銷貨收入	37,286	月結90天	0.95%
0	本公司	合泰	母公司對子公司	應收帳款	29,939		0.59%
0	本公司	芯群	母公司對子公司	銷貨收入	26,994	月結90天	0.69%

註：係揭示交易金額佔合併總營收或總資產0.5%以上之交易。

(二)轉投資事業相關資訊：

民國一〇三年度本公司之轉投資事業資訊如下(不包含大陸被投資公司)：

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高持股比率	被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
本公司	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	475,831	541,571	15,253	100.00%	496,079	100.00%	(6,071)	(6,071)註2	本公司之子公司
本公司	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	69,542	69,542	2,000	100.00%	125,531	100.00%	3,991	3,991註2	本公司之子公司
本公司	Sigmos Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	6,898	6,898	200	100.00%	16,193	100.00%	2,286	2,286註2	本公司之子公司
Sigmos Holdings Ltd.	Holtek Semiconductor (USA) Inc.	美國加州	積體電路買賣及技術服務	6,898	6,898	2,000	100.00%	16,193	100.00%	2,286	註1,2	本公司之孫公司

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所 在 地 區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高 持股比率	被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
本公司	MCU Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	74,393	74,393	2,277	100.00%	419,144	100.00%	66,010	註2	本公司之子公司
MCU Holdings Ltd.	ForIC Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	9,733	9,733	300	40.00%	29,875	40.00%	19,821	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
ForIC Electronics Holding Ltd.	E-Micro Technology Holding Ltd. (BVI)	B.V.I.	投資海外各項事業	9,473	9,473	300	100.00%	11,305	100.00%	1,525	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Truetek Technology Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	16,306	16,306	920	40.00%	43,519	40.00%	12,189	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Quanding Technology Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	1,868	1,868	60	40.00%	10,147	40.00%	2,893	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Innotek Electronics Inc.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	9,411	9,411	320	40.00%	10,143	40.00%	3,669	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Santek Holdings Ltd.	B.V.I.	投資並提供電子元器件與單片機蕊片之應用與技術諮詢	3,758	3,758	180	40.00%	11,876	40.00%	5,458	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Bestway Electronic Inc.	B.V.I.	電子零件之銷售及技術服務	3,470	3,470	800	40.00%	18,670	40.00%	9,698	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
Bestway Electronic Inc.	新棠(香港)有限公司	香港	電子零件之銷售及技術服務	8,675	8,675	-	100.00%	13,286	100.00%	(1,287)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	New Wave Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	24,784	24,784	800	40.00%	46,158	40.00%	21,463	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Newtek Electronics Ltd.	B.V.I.	投資並提供電子元器件與單片機蕊片之應用與技術諮詢	8,105	8,105	1,501	40.61%	61,556	40.61%	20,383	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Crown Rich Technology Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	2,641	2,641	80	40.00%	33,917	40.00%	17,666	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	金濟高科有限公司	香港	電子零件之銷售及技術服務	9,907	9,907	-	40.00%	16,459	40.00%	(2,940)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

投資公司 名 稱	被投資公司 名 稱	所 在 地 區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高 持股比率	被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備 註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
MCU Holdings Ltd.	泓達科技有限 公司	香港	電子零件 設計及銷 售	5,427	5,427	-	33.00%	6,885	33.00%	3,568	註1	本公司之 子公司採權 益法評價之 被投資公司
本公司	盛凌投資股份 有限公司	新竹市	專營投資 業務	400,000	400,000	40,000	100.00%	391,413	100.00%	17,913	17,913 註2	本公司之 子公司
盛凌投資股份 有限公司	欣宏電子股份 有限公司	台北市	電子零組 件製造/批 發/零售	77,035	77,035	6,345	40.00%	97,684	40.00%	47,998	註1	本公司之 子公司採權 益法評價之 被投資公司
欣宏電子股份 有限公司	A-ONE WIRELESS TECHNOLOG Y CORP.	B.V.I.	電子零組 件製造/批 發/零售	59,204	59,204	2,000	100.00%	125,671	100.00%	28,146	註1	本公司之 子公司採權 益法評價之 被投資公司 轉投資之 子公司
盛凌投資股份 有限公司	鉅威股份有限 公司	新北市	電子零組 件加工製 造、買賣進 出口	37,500	37,500	5,641	22.39%	63,119	22.39%	15,986	註1	本公司之 子公司採權 益法評價之 被投資公司
盛凌投資股份 有限公司	高聖科技股份 有限公司	新北市	電子零組 件製造、電 子材料批 發零售、電 信器材批 發零售、電 腦及其週 邊設備製 造、資訊軟 體服務及 國際貿易	2,350	2,350	235	39.17%	-	39.17%	(167)	註1	本公司之 子公司採權 益法評價之 被投資公司
盛凌投資股份 有限公司	優方科技股份 有限公司	台北市	電子零組 件製造、電 子材料批 發零售、電 腦及其週 邊設備製 造、資訊軟 體服務及 國際貿易	16,000	16,000	1,600	54.75%	22,958	56.00%	15,723	註1,2	本公司之 孫公司
優方科技股份 有限公司	Best Solution Electronics Inc.	B.V.I.	電子元器 件、電子材 料批發	12,279	-	400	100.00%	30,984	100.00%	12,066	註1,2	本公司之 孫公司投資 之子公司
盛凌投資股份 有限公司	金信科技股份 有限公司	新竹市	模具批 發、精密儀 器批發、資 訊軟體批 發、電子材 料批發、資 訊軟體零 售及電子 材料零 售、國際貿 易及資訊 軟體服務 業、資訊處 理服務及 產品設計 業、網路認 証服務業	16,452	-	846	32.17%	8,468	32.17%	(10,534)	註1	本公司之 子公司採權 益法評價之 被投資公司

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

投資公司 名 稱	被投資公司 名 稱	所 在 地 區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高 持股比例	被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備 註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
金信科技股 份有限公司	Gingy Technology Inc.	B.V.I.	模具批 發、精密儀 器批發、資 訊軟體批 發、電子材 料批發、資 訊軟體零 售及電子 材料零 售、國際貿 易及資訊 軟體服務 業、資訊處 理服務及 產品設計 業、網路認 証服務業	988	-	2	100.00%	1,072	100.00%	84	註1	本公司之子 公司採權益 法評價之被 投資公司轉 投資之子公 司
盛凌投資股 份有限公司	天宇微機電股 份有限公司	新竹市	電子零組 件製造、電 子材料批 發零售、電 信器材批 發零售、智 慧財產權 業、資訊軟 體服務及 國際貿易	10,002	10,002	380	20.00%	-	20.00%	(1,659)	註1	本公司之子 公司採權益 法評價之被 投資公司
盛凌投資股 份有限公司	盛通科技股份 有限公司	新竹市	電子零組 件製造、電 子材料批 發零售、資 訊軟體服 務及國際 貿易	20,000	-	2,000	100.00%	16,775	100.00%	(3,225)	註1,2	本公司之孫 公司
盛通科技股 份有限公司	BestComm RF Electronics Inc.	B.V.I.	電子零組 件製造/批 發/零售	8,924	-	18	100.00%	8,069	100.00%	(855)	註1,2	本公司之孫 公司投資之 子公司

註1：對各該公司投資損益之認列已分別包含於對子公司或孫公司之投資損益中。

註2：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中銷除。

(三)大陸投資資訊：

1.轉投資大陸地區之事業相關資訊：

大陸被 投資公 司名稱	主要營業 項 目	實 收 資本額	投資 方式	本期期初自 台灣匯出累 積投資金額	本期匯出或 收回投資金額		本期期末自 台灣匯出累 積投資金額	被投資 公司本 期損益	本公司直接 或間接投資 之持股比例	期中最高 持股比例	本期認 列投資 損 益	期末投 資帳面 價 值	截至本期 止已匯回 投資收益
					匯出	收回							
盛揚半導體 (深圳)有限 公司	積體電路 買賣及技 術服務	65,740	(註1)	65,740	-	65,740	-	700	-	-	700	-	-
芯群集成電 路(廈門)有 限公司	積體電路 買賣及技 術服務	113,551	(註1)	101,027	-	-	101,027	2,697	100%	100%	2,697	120,602	-
合泰半導體 (中國)有限 公司	集成電 路、電子元 器件及單 片機、芯片 之批發及 進出口業 務與諮詢 服務業務	292,423	(註1)	272,221	-	-	272,221	(9,662)	100%	100%	(9,662)	280,245	-

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	期中最高持股比率	本期認列投資損益	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回							
新緯科技(深圳)有限公司	電子零件銷售及售後服務	6,769	(註1)	3,383	-	-	3,383	(22)	40%	40%	(8)	11,348	-
新禾(廈門)電子有限公司	電子元件及單片機蕊片技術支持與諮詢服務業務	6,398	(註1)	2,506	-	-	2,506	991	40%	40%	396	13,133	-
諾華達電子(深圳)有限公司	電子元件及單片機蕊片技術支持與諮詢服務業務	9,287	(註1)	3,928	-	-	3,928	(342)	40%	40%	(137)	18,478	-
新碩電子科技(杭州)有限公司	電子元件及單片機蕊片技術研發與諮詢服務業務	14,727	(註1)	-	-	-	-	946	40%	40%	378	15,103	-
華榮匯電子科技(北京)有限公司	電子元件及單片機蕊片技術支持與諮詢服務業務	19,361	(註1)	3,601	-	-	3,601	4,168	40%	40%	1,667	25,240	-
振揚電子(青島)有限公司	電子元件及單片機蕊片技術支持與諮詢服務業務	6,315	(註1)	2,634	-	-	2,634	367	40%	40%	147	7,222	-
新鼎電子(深圳)有限公司	電子元件及單片機蕊片技術支持與諮詢服務業務	6,699	(註1)	2,647	-	-	2,647	2,666	40.61%	40.61%	1,082	3,338	-
信霖電子商貿(上海)有限公司	電子元件及單片機蕊片技術支持與諮詢服務業務	30,293	(註1)	3,911	-	-	3,911	727	40%	40%	291	37,683	-
華瑞昇電子(深圳)有限公司	電子元件及單片機蕊片技術支持與諮詢服務業務	4,952	(註1)	1,964	-	-	1,964	1,696	40%	40%	678	10,807	-
全鼎電子(蘇州)有限公司	電子元件及單片機蕊片技術支持與諮詢服務業務	3,736	(註1)	1,600	-	-	1,600	363	40%	40%	145	8,278	-
金科集成電路(蘇州)有限公司	電子零件銷售及售後服務	69,712	(註1)	69,712	-	-	69,712	3,989	100%	100%	3,989	125,490	-

2.轉投資大陸地區限額：

本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額(註2)	經濟部投審會核准投資金額(註2、3)	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額
471,089 (美金15,111千元)	529,346 (美金16,725千元)	2,423,179 (註4)

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

註1：透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

註2：累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額係依實際匯出之歷史匯率換算之新台幣金額；經濟部投審會核准投資金額係以資產負債表日匯率換算新台幣金額。

註3：係包括核准自台灣匯出投資金額計476,495千元(美金15,054千元)及第三地區之盈餘轉增資金額計52,887千元(美金1,671千元)。

註4：依「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定，本公司對大陸投資累計金額未超過主管機關所定投資金額或比例上限。淨值4,038,632千元 \times 60%＝2,423,179千元。

3.重大交易事項：

合併公司民國一〇三年度與大陸被投資公司直接或間接之重大交易事項（於編製合併報告時業已沖銷），請詳(一)「重大交易事項相關資訊」第10項「母子公司間業務關係及重要交易往來情形」之說明。

十四、部門資訊

(一)一般性資訊

合併公司主要營運項目為積體電路之研究、開發、生產、製造及銷售，為單一營運部門。營運部門資訊與合併財務報表一致，收入(來自外部客戶收入)及部門損益請詳合併綜合損益表；部門資產請詳合併資產負債表。

(二)產品別及勞務別資訊

合併公司來自外部客戶收入資訊如下：

	103年度		102年度	
	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%
積體電路銷貨收入	\$ 3,925,640	100	3,886,113	100
設計收入	4,879	-	8,248	-
	<u>\$ 3,930,519</u>	<u>100</u>	<u>3,894,361</u>	<u>100</u>

(三)地區別資訊

合併公司地區別資訊如下，其中收入係依據客戶所在地理位置歸類，而非流動資產則依據資產所在地理位置歸類。

	103年度		102年度	
	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%
來自外部客戶收入：				
中國	\$ 2,695,798	68	2,662,029	68
台灣	538,807	14	544,477	14
其他國家	695,914	18	687,855	18
	<u>\$ 3,930,519</u>	<u>100</u>	<u>3,894,361</u>	<u>100</u>

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

	103.12.31		102.12.31	
	金 額	佔當期總 資產之%	金 額	佔當期總 資產之%
非流動資產：				
台灣	\$ 258,909	5	270,367	5
中國	297,283	6	293,957	6
	<u>\$ 556,192</u>	<u>11</u>	<u>564,324</u>	<u>11</u>

(四)主要客戶

合併公司佔營業收入淨額10%以上之重要客戶資訊如下：

	103年度		102年度	
	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%
欣宏	<u>\$ 470,973</u>	<u>12</u>	<u>482,797</u>	<u>12</u>

會計師查核報告

盛群半導體股份有限公司董事會 公鑒：

盛群半導體股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達盛群半導體股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

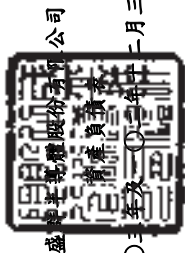
會計師：

魏曉海
曾漢鈺



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號

民國一〇四年一月二十六日



盛豐盛股份有限公司

資產負債表

民國一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31	102.12.31
	金額	金額
資產		
流動資產：		
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 996,708	823,119
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動		
(附註六(二))	158,476	263,247
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))	90,378	81,470
1180 應收關係人款項(附註七)	553,722	479,086
130X 存貨(附註六(四))	425,350	451,944
1476 其他金融資產－流動(附註六(五)及八)	1,069,281	1,124,943
1470 其他流動資產	20,765	12,504
	<u>3,314,680</u>	<u>3,236,313</u>
非流動資產：		
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	1,361,836	1,321,573
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七))	192,841	208,066
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))	36,345	34,488
1900 其他非流動資產	70,575	67,081
	<u>1,661,597</u>	<u>1,631,208</u>
	<u>4,976,277</u>	<u>4,867,521</u>
資產總計	<u>100</u>	<u>100</u>

	103.12.31	102.12.31
	金額	金額
負債及權益		
流動負債：		
2150 應付票據	2150	147,907
2170 應付帳款	2170	278,627
2180 應付關係人款項(附註七)	2180	1,934
2201 應付薪資及獎金	2201	201,073
2230 應付所得稅	2230	84,807
2300 其他流動負債	2300	67,002
	<u>796,996</u>	<u>781,350</u>
非流動負債：		
2570 遞延所得稅負債(附註六(十))	2570	54,983
2640 應計退休金負債(附註六(九))	2640	60,829
2645 存入保證金	2645	7,597
	<u>113,409</u>	<u>123,409</u>
負債總計	<u>910,405</u>	<u>904,759</u>
權益(附註六(十一))：		
3110 普通股股本	3110	2,249,412
3140 預收股本	3140	40,368
3211 資本公積－普通股股票溢價	3211	114,211
保留盈餘：		
3310 法定盈餘公積	3310	777,359
3320 特別盈餘公積	3320	4,598
3350 未分配盈餘	3350	761,084
	<u>1,588,979</u>	<u>1,543,041</u>
國外營運機構財務報告換算之兌換差額	3410	15,730
權益總計	<u>4,038,632</u>	<u>3,962,762</u>
負債及權益總計	<u>4,976,277</u>	<u>4,867,521</u>
	<u>100</u>	<u>100</u>



董事長：



經理人：

後附個體財務報告附註)

會計主管：



盛群半導體股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4100 營業收入淨額(附註七)	\$ 3,605,717	100	3,599,332	100
5110 營業成本(附註六(四)及七)	1,920,337	53	1,966,639	55
營業毛利	1,685,380	47	1,632,693	45
5910 未實現銷貨利益之變動	19,243	1	5,502	-
已實現營業毛利	1,666,137	46	1,627,191	45
營業費用：				
6100 推銷費用	86,046	2	105,591	3
6200 管理費用	223,090	6	236,689	7
6300 研究發展費用	562,351	16	554,756	15
	871,487	24	897,036	25
營業淨利	794,650	22	730,155	20
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	20,454	1	17,932	-
7070 採用權益法認列之子公司利益之份額(附註六(六))	84,129	2	79,631	2
7020 其他利益淨額(附註六(十四))	28,186	1	50,053	2
	132,769	4	147,616	4
稅前淨利	927,419	26	877,771	24
7950 所得稅費用(附註六(十))	135,863	4	132,826	3
本期淨利	791,556	22	744,945	21
其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	36,062	1	37,200	1
8360 確定福利計畫精算利益	888	-	6,016	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅(附註六(十))	6,281	-	6,870	-
其他綜合損益(稅後淨額)	30,669	1	36,346	1
本期綜合損益總額	\$ 822,225	23	\$ 781,291	22
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十三))				
9750 基本每股盈餘	\$ 3.50		\$ 3.32	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 3.46		\$ 3.28	

董事長：



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：



會計主管：





盛群半導體股份有限公司

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	預收股本	資本公積	保留盈餘			國外營運機構財務報表 換算之兌換 差	權益總計
				法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘		
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 2,235,985	-	83,257	776,122	4,598	570,902	(15,146)	3,655,718
本期淨利	-	-	-	-	-	744,945	-	744,945
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	5,470	30,876	36,346
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	750,415	30,876	781,291
盈餘指撥及分配(註1)：								
提列法定盈餘公積	-	-	-	56,019	-	(56,019)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(54,782)	-	(504,214)	-	(558,996)
員工行使認股權	13,427	40,368	30,954	-	-	-	-	84,749
民國一〇二年十二月三十一日餘額	2,249,412	40,368	114,211	777,359	4,598	761,084	15,730	3,962,762
本期淨利	-	-	-	-	-	791,556	-	791,556
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	737	29,932	30,669
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	792,293	29,932	822,225
盈餘指撥及分配(註2)：								
提列法定盈餘公積	-	-	-	74,495	-	(74,495)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(59,934)	-	(686,421)	-	(746,355)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(1,956)	1,956	-	-
員工行使認股權	12,270	(40,368)	28,098	-	-	-	-	-
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 2,261,682	-	142,309	791,920	2,642	794,417	45,662	4,038,632

註1：董事監察人酬勞7,563千元及員工紅利68,064千元已於綜合損益表中扣除。

註2：董事監察人酬勞10,057千元及員工紅利90,511千元已於綜合損益表中扣除。

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

盛群半導體股份有限公司

現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 927,419	877,771
調整項目：		
折舊費用	28,906	30,387
攤銷費用	50,226	44,726
利息收入	(20,454)	(17,932)
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(84,129)	(79,631)
聯屬公司間未實現銷貨利益變動	19,243	5,502
其他不影響現金流量之費損(收益)淨額	949	(806)
與營業活動相關之資產及負債淨變動數：		
持有供交易之金融資產	104,737	77,836
應收票據及帳款(含應收關係人款項)	(83,544)	(64,002)
存貨	26,199	53,810
其他營業資產	(18,069)	(16,484)
應付票據及帳款(含應付關係人款項)	6,676	(10,918)
應計退休金負債	(1,687)	(1,855)
其他營業負債	(4,860)	61,940
營運產生之現金流入	951,612	960,344
收取利息	20,195	17,120
支付所得稅	(111,213)	(45,808)
營業活動之淨現金流入	860,594	931,656
投資活動之現金流量：		
採用權益法之被投資公司減資退回股款	59,860	-
取得不動產、廠房及設備	(10,432)	(5,276)
處分不動產、廠房及設備價款	450	-
存出保證金增加	(331)	(437)
其他金融資產減少(增加)	56,993	(72,047)
其他非流動資產增加	(47,190)	(35,093)
投資活動之淨現金流入(出)	59,350	(112,853)
籌資活動之現金流量：		
發放股東現金股利	(746,355)	(558,996)
員工認股權執行認購價款	-	84,749
籌資活動之淨現金流出	(746,355)	(474,247)
本期現金及約當現金增加數	173,589	344,556
期初現金及約當現金餘額	823,119	478,563
期末現金及約當現金餘額	\$ 996,708	823,119

董事長：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



會計主管：



盛群半導體股份有限公司
個體財務報告附註
民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日
(除另有註明者外，所有金額均以新台幣千元為單位)

一、公司沿革

盛群半導體股份有限公司(以下稱「本公司」)於民國八十七年十月一日依中華民國公司法及科學園區設置管理條例之規定成立，自民國八十七年十二月十一日開始營業，民國八十九年四月於香港設立分公司。本公司股票自民國九十一年十一月四日起於中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌買賣，自民國九十三年九月二十七日起改於台灣證券交易所股份有限公司掛牌買賣。

本公司主要營業項目為各種積體電路之研究、開發、生產、製造及銷售。

二、通過財務報告之日期及程序

本個體財務報告已於民國一〇四年一月二十六日經董事會通過。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)尚未採用金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)認可之2013年版國際財務報導準則之影響

依據金管會民國一〇三年四月三日金管證審字第1030010325號令，上市、上櫃及興櫃公司應自民國一〇四年起全面採用經金管會認可並發布生效之2013年版國際財務報導準則(不包含國際財務報導準則第九號「金融工具」)編製財務報告，相關國際會計準則理事會新發布、修正及修訂之準則及解釋彙列如下：

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布 之生效日
國際財務報導準則第1號之修正「國際財務報導準則第7號之比較揭露對首次採用者之有限度豁免」	99.7.1
國際財務報導準則第1號之修正「嚴重高度通貨膨脹及首次採用者固定日期之移除」	100.7.1
國際財務報導準則第1號之修正「政府貸款」	102.1.1
國際財務報導準則第7號之修正「揭露—金融資產之移轉」	100.7.1
國際財務報導準則第7號之修正「揭露—金融資產及金融負債之互抵」	102.1.1
國際財務報導準則第10號「合併財務報表」	102.1.1 (投資個體於 103.1.1生效)
國際財務報導準則第11號「聯合協議」	102.1.1
國際財務報導準則第12號「對其他個體之權益之揭露」	102.1.1

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布 之生效日
國際財務報導準則第13號「公允價值衡量」	102.1.1
國際會計準則第1號之修正「其他綜合損益項目之表達」	101.7.1
國際會計準則第12號之修正「遞延所得稅：標的資產之回收」	101.1.1
國際會計準則第19號之修訂「員工福利」	102.1.1
國際會計準則第27號之修訂「單獨財務報表」	102.1.1
國際會計準則第32號之修正「金融資產及金融負債之互抵」	103.1.1
國際財務報導解釋第20號「露天礦場於生產階段之剝除成本」	102.1.1

經評估後本公司認為除下列各項外，適用2013年版國際財務報導準則將不致對個體財務報告造成重大變動：

1. 國際會計準則第19號「員工福利」

該準則主要修正以淨確定福利負債（資產）乘以折現率決定淨利息，並用其取代準則修訂前之利息成本及計畫資產之預期報酬、刪除精算損益得採「緩衝區法」或發生時一次列入損益之會計政策選擇，並規定精算損益應於發生時列入其他綜合損益、前期服務成本應於發生時認列為損益，不再於符合既得條件前之平均期間內按直線法分攤認列為費用，另企業係於不再能撤銷離職福利之要約或於認列相關重組成本之孰早者認列離職福利，而非僅於已明確承諾相關離職事件時，始應認列離職福利為負債及費用等。此外增加確定福利計畫之揭露規定。經評估該準則對本公司財務狀況與經營結果無重大影響，惟將依規定增加確定福利計畫相關揭露。

2. 國際會計準則第1號「財務報表之表達」

該準則修正其他綜合損益之表達方式，將列示於其他綜合損益之項目依性質分類為「後續不重分類至損益」及「後續將重分類至損益」兩類別。該修正同時規定以稅前金額列示之其他綜合損益項目，其相關稅額應隨前述兩類別予以單獨列示。本公司將依該準則改變綜合損益表之表達方式。

3. 國際財務報導準則第12號「對其他個體之權益之揭露」

該準則整合各號準則對企業所持有子公司、聯合協議、關聯企業及未納入合併財務報告之結構型個體之權益之揭露規定，並要求揭露相關資訊。本公司將依該準則增加有關子公司及關聯企業之資訊揭露。

4. 國際財務報導準則第13號「公允價值衡量」

該準則定義公允價值，建立公允價值衡量之架構，並規範公允價值衡量相關揭露。經評估該準則對本公司財務狀況與經營結果無重大影響，惟將依規定增加公允價值衡量相關揭露。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(二)國際會計準則理事會已發布但尚未經金管會認可之國際財務報導準則之影響

下表彙列國際會計準則理事會已發布但尚未納入金管會認可2013年版國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布 之生效日
國際財務報導準則第9號「金融工具」	107.1.1
國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	105.1.1
國際財務報導準則第10號、國際財務報導準則第12號及國際會計準則第28號之修正「投資個體：合併報表例外規定之適用」	105.1.1
國際財務報導準則第11號之修正「處理聯合營運權益之取得」	105.1.1
國際財務報導準則第14號「管制遞延帳戶」	105.1.1
國際財務報導準則第15號「來自客戶合約之收入」	106.1.1
國際會計準則第1號之修正「揭露計畫」	105.1.1
國際會計準則第16號及國際會計準則第38號之修正「闡明可接受之折舊及攤銷方法」	105.1.1
國際會計準則第16號及國際會計準則第41號之修正「生產性植物」	105.1.1
國際會計準則第19號之修正「確定福利計畫：員工提撥」	103.7.1
國際會計準則第27號之修正「單獨財務報表之權益法」	105.1.1
國際會計準則第36號之修正「非金融資產可回收金額之揭露」	103.1.1
國際會計準則第39號之修正「衍生工具之合約更替及避險會計之繼續」	103.1.1
國際財務報導解釋第21號「公課」	103.1.1

本公司現正持續評估上述準則及解釋對本公司財務狀況與經營結果之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

本個體財務報告所採用之重大會計政策彙總說明如下。除另有說明者外，下列會計政策已一致適用於本個體財務報告之所有表達期間。

(一)遵循聲明

本個體財務報告係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製。

(二)編製基礎

1.衡量基礎

除下列資產負債表之重要項目外，本個體財務報告係依歷史成本為基礎編製：

- (1)透過損益按公允價值衡量之金融工具(包括衍生金融工具)；及
- (2)確定福利負債，係依退休基金資產加計未認列前期服務成本與未認列精算損失，減除未認列精算利益與確定福利義務現值之淨額認列。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

2.功能性貨幣及表達貨幣

本公司以營運所處主要經濟環境之貨幣為功能性貨幣。本個體財務報告係以本公司之功能性貨幣新台幣表達。所有以新台幣表達之財務資訊均以新台幣千元為單位。

(三)外幣

1.外幣交易

外幣交易依交易日之匯率換算為功能性貨幣。報導日之外幣貨幣性項目依當日之匯率換算為功能性貨幣，其兌換損益係指期初以功能性貨幣計價之攤銷後成本，調整當期之有效利息及付款後之金額，與依外幣計價之攤銷後成本按報導日匯率換算金額間之差異。以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目依衡量公允價值當日之匯率重新換算為功能性貨幣，以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目則依交易日之匯率換算。除備供出售金融資產、指定為國外營運機構淨投資避險之金融負債或合格之現金流量避險，換算所產生之外幣兌換差異認列於其他綜合損益外，其餘係認列為損益。

2.國外營運機構

國外營運機構之資產及負債，係依報導日之匯率換算為新台幣；股東權益項目除期初保留盈餘以上期期末換算後之餘額結轉外，其餘依歷史匯率換算為新台幣；收益及費損項目係依當期平均匯率換算為新台幣，所產生之兌換差額均認列為其他綜合損益。

當處分國外營運機構致喪失控制、共同控制或重大影響時，與該國外營運機構相關之累計兌換差額係全數重分類為損益。部分處分含有國外營運機構之子公司時，相關累計兌換差額係按比例重新歸屬至非控制權益。部分處分含有國外營運機構之關聯企業或合資之投資時，相關累計兌換差額則按比例重分類至損益。

(四)資產與負債區分流動與非流動之分類標準

符合下列條件之一之資產列為流動資產，非屬流動資產之所有其他資產則列為非流動資產：

- 1.預期於本公司正常營業週期中實現，或意圖將其出售或消耗者。
- 2.主要為交易目的而持有者。
- 3.預期將於資產負債表日後十二個月內實現者。
- 4.現金或約當現金，但不包括於資產負債表日後逾十二個月用以交換、清償負債或受有其他限制者。

符合下列條件之一之負債列為流動負債，非屬流動負債之所有其他負債則列為非流動負債：

- 1.預期將於本公司正常營業週期中清償者。
- 2.主要為交易目的而持有者。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

3.預期將於資產負債表日後十二個月內到期清償者。

4.本公司不能無條件將清償期限延期至資產負債表日後至少十二個月者。

(五)現金及約當現金

現金包括庫存現金及活期存款。約當現金係指可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之短期並具高度流動性之投資。定期存款符合前述定義且持有目的係滿足短期現金承諾而非投資或其他目的者，列報於約當現金。

(六)金融工具

1.金融資產

(1)透過損益按公允價值衡量之金融資產

此類金融資產係指持有供交易之金融資產，其取得或發生之主要目的為短期內出售或再買回。此類金融資產於原始認列時係按公允價值衡量，交易成本於發生時認列為損益；後續評價按公允價值衡量，再衡量產生之利益或損失認列為損益，並列報於營業外收入及支出項下。依交易慣例購買或出售金融資產時，採用交易日會計處理。

(2)應收款

應收款係無活絡市場公開報價，且具固定或可決定付款金額之金融資產，包括應收款項及其他應收款。原始認列時係按公允價值加計直接可歸屬之交易成本衡量；續後評價採有效利率法以攤銷後成本減除減損損失衡量，惟短期應收款項之利息認列不具重大性之情況除外。

(3)金融資產減損

非透過損益按公允價值衡量之金融資產，於每個報導日評估減損。當有客觀證據顯示，因金融資產原始認列後發生之單一或多項事件，致使該資產之估計未來現金流量受損失者，該金融資產即已發生減損。

針對應收帳款個別評估未有減損後，另再以組合基礎評估減損。應收款組合之客觀減損證據可能包含本公司過去收款經驗、該組合超過平均授信期間之延遲付款增加情況，以及與應收款拖欠有關之全國性或區域性經濟情勢變化。

所有金融資產之減損損失係直接自金融資產之帳面金額中扣除，惟應收款之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額，當判斷應收款無法收回時，則沖銷備抵帳戶，原先已沖銷而後續收回之款項則貸記備抵帳戶。備抵帳戶帳面金額之變動認列於損益。

當金融資產以攤銷後成本衡量時，若後續期間減損損失金額減少，且該減少客觀地連結至認列減損後發生之事項，則先前認列之減損損失予以迴轉認列於損益，惟該投資於減損迴轉日之帳面金額不得大於若未認列減損情況下應有之攤銷後成本。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(4)金融資產之除列

本公司僅於對來自該資產現金流量之合約權利終止，或已移轉金融資產且該資產幾乎所有之風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

2.金融負債

(1)應付款

金融負債非屬持有供交易且未指定為透過損益按公允價值衡量者，包括應付帳款及其他應付款，原始認列時係按公允價值加計直接可歸屬之交易成本衡量；續後評價採有效利率法以攤銷後成本衡量。

(2)金融負債之除列

本公司係於合約義務已履行、取消或到期時，除列金融負債。

除列金融負債時，其帳面金額與所支付或應支付對價總額間之差額認列為損益，並列報於營業外收入及支出項下。

(3)金融資產及負債之互抵

金融資產及金融負債僅於本公司有法定權利進行互抵及有意圖以淨額交割或同時變現資產及清償負債時，方予以互抵並以淨額表達於資產負債表。

(七)存貨

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。成本包括使其達可供使用之地點及狀態所發生之必要支出，並採加權平均法計算。淨變現價值係正常營業下之估計售價減除至完工尚需投入之成本及銷售費用為計算基礎。

(八)投資關聯企業

關聯企業係指本公司對其財務及營運政策具有重大影響力但未達控制能力者。本公司持有被投資公司百分之二十至百分之五十之表決權時，即假設具有重大影響力，並採權益法評價。

在權益法下，原始取得時係依成本認列，投資成本包含交易之成本。投資關聯企業之帳面金額包括原始投資時所辨認之商譽，減除任何累計減損損失。

個體財務報告包括自具有重大影響力之日起至喪失重大影響力之日止，於進行與本公司會計政策一致性之調整後，本公司依權益比例認列各該投資關聯企業之損益及其他綜合損益之金額。

本公司與關聯企業間之交易所產生之未實現損益，已在本公司對該被投資公司之權益範圍內予以消除。

當本公司依比例應認列關聯企業之損失份額等於或超過其在關聯企業之權益時，即停止認列其損失，而僅於發生法定義務、推定義務或已代該被投資公司支付款項之範圍內，認列額外之損失及相關負債。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(九)投資子公司

於編製個體財務報告時，本公司對具控制力之被投資公司係採權益法評價。在權益法下，個體財務報告當期損益及其他綜合損益與合併基礎編製之財務報告中當期損益及其他綜合損益歸屬於母公司業主之分攤數相同，且個體財務報告業主權益與合併基礎編製之財務報告中歸屬於母公司業主之權益相同。

本公司對子公司所有權權益之變動，未導致喪失控制者，作為與業主間之權益交易處理。

(十)不動產、廠房及設備

1.認列與衡量

不動產、廠房及設備之認列及衡量係採成本模式，依成本減除累計折舊與累計減損後之金額衡量。成本包含可直接歸屬於取得資產之支出、任何其他使資產達預計用途之可使用狀態的直接可歸屬成本、拆卸與移除該項目及復原所在地點之成本。此外，為整合相關設備功能而購入之軟體亦資本化為該設備之一部分。

當不動產、廠房及設備包含不同組成部分，且相對於該項目之總成本若屬重大而採用不同之折舊方法較為合宜時，則視為不動產、廠房及設備之單獨項目(主要組成部分)處理。

不動產、廠房及設備之處分損益，以淨額認列於營業外收入及支出項下。

2.後續成本

若不動產、廠房及設備項目後續支出所預期產生之未來經濟效益很有可能流入本公司，且其金額能可靠衡量，則該支出認列為該項目帳面金額之一部分，被重置部分之帳面金額則予以除列。不動產、廠房及設備之日常維修成本於發生時認列為損益。

3.折舊

折舊係依資產成本減除殘值後按估計耐用年限採直線法計提，並依資產之各別重大組成部分評估，若一組成部分之耐用年限不同於資產之其他部分，則此組成部分應單獨提列折舊。折舊之提列認列為損益。

當期及比較期間之估計耐用年限如下：

(1)房屋及建築物：20~30年

(2)機器設備：3~5年

(3)其他設備：2~8年

每年至少於財務年度結束日檢視不動產、廠房及設備之折舊方法、耐用年限及殘值，若有變動，視為會計估計變動。

(十一)租賃

營業租賃之租金給付依直線法於租賃期間認列為費用。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十二)無形資產

1.研究與發展

研究階段係指預期為獲取及瞭解嶄新的科學或技術知識而進行之活動，相關支出於發生時認列於損益。

發展階段之支出於同時符合下列所有條件時，認列為無形資產；未同時符合者，於發生時即認列於損益：

- (1)完成無形資產之技術可行性已達成，使該無形資產將可供使用或出售。
- (2)意圖完成該無形資產，並加以使用或出售。
- (3)有能力使用或出售該無形資產。
- (4)無形資產將很有可能產生未來經濟效益。
- (5)具充足之技術、財務及其他資源，以完成此項發展，並使用或出售該無形資產。
- (6)歸屬於該無形資產發展階段之支出能可靠衡量。

2.其他無形資產

本公司取得其他無形資產係以成本減除累計攤銷與累計減損衡量之。

3.後續支出

後續支出僅於可增加相關特定資產的未來經濟效益時，方將其資本化。

4.攤銷

攤銷時係以資產成本減除殘值後金額為可攤銷金額，自達可供使用狀態起，按估計耐用年限採直線法攤銷，攤銷數認列於損益。

每年至少於財務年度結束日檢視無形資產之殘值、攤銷期間及攤銷方法，若有變動，視為會計估計變動。

(十三)非金融資產減損

針對存貨及遞延所得稅資產以外之非金融資產，本公司於每一報導日評估是否發生減損，就有減損跡象之資產(個別資產或現金產生單位)估計其可回收金額，並就可回收金額低於帳面價值之資產，認列減損損失。於以前年度所認列除商譽以外之累計減損損失，嗣後若已不存在或減少，則迴轉增加帳面價值至可回收金額，惟不超過資產在未認列減損損失下，減除應提列折舊或攤銷之數。

(十四)收入認列

正常活動中銷售商品所產生之收入，係考量退回、商業折扣及數量折扣後，按已收或應收對價之公允價值衡量。收入係俟具說服力之證據存在、所有權之重大風險及報酬已移轉予買方、價款很有可能收回及相關成本與可能之商品退回能可靠估計、不持續參與商品之管理及收入金額能可靠衡量時加以認列。若折扣很有可能發生且金額能可靠衡量時，則於銷售認列時予以認列作為收入之減項。

風險及報酬移轉之時點係視銷售合約個別條款而定。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十五)員工福利

1.確定提撥計畫

確定提撥退休金計畫之提撥義務係於員工提供勞務期間內認列為損益項下之員工福利費用。

2.確定福利計畫

本公司在確定福利退休金計畫下之淨義務係針對福利計畫以員工當期或過去服務所賺得之未來福利金額折算為現值計算。任何未認列之前期服務成本及計畫資產之公允價值均予以減除。折現率係以到期日與本公司淨義務期限接近，且計價幣別與預期支付福利金相同之政府公債之市場殖利率於年度報導日之利率為主。

企業淨義務每年由精算師以預計單位福利法精算。當計算結果對本公司有利時，認列資產係以任何未認列之前期服務成本，及未來得以從該計畫退還之資金或減少未來對該計畫之提撥等方式所可獲得經濟效益現值之總額為限。計算經濟效益現值時應考量任何適用於本公司任何計畫之最低資金提撥需求。一項效益若能在計畫期間內或計畫負債清償時實現，對本公司而言，即具有經濟效益。

民國一〇一年一月一日(金管會認可之國際財務報導準則轉換日)，所有精算損益皆認列於保留盈餘。本公司所有確定福利計畫續後產生之精算損益立即認列於其他綜合損益。

3.短期員工福利

短期員工福利義務係以未折現之基礎衡量，且於提供相關服務時認列為費用。

有關短期現金紅利或分紅計畫下預期支付之金額，若係因員工過去提供服務而使本公司負有現時之法定或推定支付義務，且該義務能可靠估計時，將該金額認列為負債。

(十六)股份基礎給付交易

給與員工之股份基礎給付獎酬以給與日之公允價值，於員工達到可無條件取得報酬之期間內，認列酬勞成本並增加相對權益。認列之酬勞成本係隨預期符合服務條件及非市價既得條件之獎酬數量予以調整；而最終認列之金額係以既得日符合服務條件及非市價既得條件之獎酬數量為基礎衡量。

股份基礎給付協議之給與日在民國九十七年一月一日前，且既得日在民國一〇一年一月一日(金管會認可之國際財務報導準則轉換日)前之員工認股權計畫，選擇適用國際財務報導準則第1號之豁免，依金管會民國九十八年一月十日發布之證券發行人財務報告編製準則及財團法人中華民國會計研究發展基金會公布之各號財務會計準則公報及其解釋(以下簡稱先前一般公認會計原則)認列，採用內含價值法認列酬勞性員工認股選擇權計畫之酬勞成本，亦即按衡量日本公司股票市價與行使價格間之差額估計為酬勞成本，並於員工認股選擇權計畫所規定之員工服務年限內認列為本公司之費用，同時增加本公司之股東權益。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十七)所得稅

所得稅費用包括當期及遞延所得稅。除與企業合併、直接認列於權益或其他綜合損益之項目相關者外，當期所得稅及遞延所得稅應認列於損益。

當期所得稅包括當年度課稅所得（損失）按報導日之法定稅率或實質性立法稅率計算之預計應付所得稅或應收退稅款，及任何對以前年度應付所得稅的調整。

遞延所得稅係就資產及負債於財務報導目的之帳面金額與其課稅基礎之暫時性差異予以衡量認列。

遞延所得稅係以預期資產實現或負債清償當期之稅率衡量，並以報導日之法定稅率或實質性立法稅率為基礎。

本公司僅於同時符合下列條件時，始將遞延所得稅資產及遞延所得稅負債互抵：

- 1.有法定執行權將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵；且
- 2.遞延所得稅資產及遞延所得稅負債與下列由同一稅捐機關課徵所得稅之納稅主體之一有關；

(1)同一納稅主體；或

(2)不同納稅主體，惟各主體意圖在重大金額之遞延所得稅資產預期回收及遞延所得稅負債預期清償之每一未來期間，將當期所得稅負債及資產以淨額基礎清償，或同時實現資產及清償負債。

對於可遞轉後期之未使用所得稅抵減及可減除暫時性差異，在很有可能有未來課稅所得可供使用之範圍內，認列為遞延所得稅資產。並於每一報導日予以重評估，就相關所得稅利益非屬很有可能實現之範圍內予以調減。

(十八)每股盈餘

本公司列示歸屬於本公司普通股權益持有人之基本及稀釋每股盈餘。基本每股盈餘係以歸屬於本公司普通股權益持有人之損益，除以當期加權平均流通在外普通股股數計算之。稀釋每股盈餘則係將歸屬於本公司普通股權益持有人之損益及加權平均流通在外普通股股數，分別調整所有潛在稀釋普通股之影響後計算之。本公司之潛在稀釋普通股包括本公司尚未經股東會決議且得採股票發放之員工分紅。因盈餘或資本公積轉增資而新增之股份，採追溯調整計算。

(十九)部門資訊

本公司已於合併財務報告揭露部門資訊，因此個體財務報告不揭露部門資訊。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

管理階層依「證券發行人財務報告編製準則」編製本個體財務報告時，必須作出判斷、估計及假設，其將對會計政策之採用及資產、負債、收益及費用之報導金額有所影響。實際結果可能與估計存有差異。

管理當局持續檢視估計及基本假設，會計估計變動於變動期間及受影響之未來期間予以認列。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

對於假設及估計之不確定性中，存有重大風險將於未來次一年度造成重大調整之相關資訊，請詳下列附註：

(一)附註六(四)，存貨之評價。

(二)附註六(九)，確定福利義務之衡量。

六、重要會計項目之說明

(一)現金及約當現金

	103.12.31	102.12.31
現金及活期存款	\$ 72,072	132,219
定期存款	924,636	690,900
	<u>\$ 996,708</u>	<u>823,119</u>

(二)透過損益按公允價值衡量之金融資產

	103.12.31	102.12.31
持有供交易之金融資產－受益憑證	<u>\$ 158,476</u>	<u>263,247</u>

(三)應收票據及帳款淨額

	103.12.31	102.12.31
應收票據	\$ 530	1,476
應收帳款	97,241	87,387
	97,771	88,863
減：備抵呆帳	(7,393)	(7,393)
	<u>\$ 90,378</u>	<u>81,470</u>

本公司於民國一〇三年度及一〇二年度針對應收票據及應收帳款並無提列(迴轉)減損損失情形。

(四)存貨

	103.12.31	102.12.31
原料及物料	\$ 106,191	119,693
在製品	122,286	120,810
製成品及商品	196,873	211,441
	<u>\$ 425,350</u>	<u>451,944</u>

營業成本組成明細如下：

	103年度	102年度
銷貨成本	\$ 1,919,942	1,966,118
迴轉存貨跌價損失	(6,000)	-
報廢成本	6,395	521
	<u>\$ 1,920,337</u>	<u>1,966,639</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(五)其他金融資產－流動

	103.12.31	102.12.31
定期存款(三個月以上)	\$ 1,059,000	1,116,000
受限制銀行存款	3,583	3,576
其他	6,698	5,367
	<u>\$ 1,069,281</u>	<u>1,124,943</u>

(六)採用權益法之投資

本公司於報導日採用權益法之投資列示如下：

	103.12.31	102.12.31
子公司	\$ 1,448,360	1,388,641
減：聯屬公司間未實現交易利得	(86,524)	(67,068)
	<u>\$ 1,361,836</u>	<u>1,321,573</u>

子公司相關資訊請參閱民國一〇三年度合併財務報告。

本公司民國一〇三年度及一〇二年度所享有子公司利益之份額分別為84,129千元及79,631千元。

(七)不動產、廠房及設備

本公司不動產、廠房及設備之成本及累計折舊變動明細如下：

	土 地	房 屋 及 建 築	機 器 設 備	其 他 設 備	總 計
成本：					
民國103年1月1日餘額	\$ 26,676	257,763	238,553	43,151	566,143
增添	-	1,759	7,185	1,488	10,432
處分	-	-	(15,165)	(6,206)	(21,371)
重分類	-	-	3,070	324	3,394
民國103年12月31日餘額	<u>\$ 26,676</u>	<u>259,522</u>	<u>233,643</u>	<u>38,757</u>	<u>558,598</u>
民國102年1月1日餘額	\$ 26,676	257,763	242,618	51,284	578,341
增添	-	-	4,644	632	5,276
處分	-	-	(8,709)	(8,765)	(17,474)
民國102年12月31日餘額	<u>\$ 26,676</u>	<u>257,763</u>	<u>238,553</u>	<u>43,151</u>	<u>566,143</u>
累計折舊：					
民國103年1月1日餘額	\$ -	117,768	201,174	39,135	358,077
本期折舊	-	12,355	14,654	1,897	28,906
處分	-	-	(15,019)	(6,207)	(21,226)
民國103年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>130,123</u>	<u>200,809</u>	<u>34,825</u>	<u>365,757</u>
民國102年1月1日餘額	\$ -	105,569	193,843	45,752	345,164
本期折舊	-	12,199	16,040	2,148	30,387
處分	-	-	(8,709)	(8,765)	(17,474)
民國102年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>117,768</u>	<u>201,174</u>	<u>39,135</u>	<u>358,077</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

	土 地	房 屋 及 建 築	機 器 設 備	其 他 設 備	總 計
帳面價值：					
民國103年12月31日	\$ 26,676	129,399	32,834	3,932	192,841
民國102年12月31日	\$ 26,676	139,995	37,379	4,016	208,066
民國102年1月1日	\$ 26,676	152,194	48,775	5,532	233,177

(八)營業租賃

- 1.本公司依已簽訂之辦公室、停車位及員工宿舍租賃合約，預估未來最低租金給付額彙列如下：

	103.12.31	102.12.31
一年內	\$ 10,121	6,754
一年以上至二年	5,024	1,181
二年以上	-	101
	<u>\$ 15,145</u>	<u>8,036</u>

- 2.本公司廠房之土地係向科學工業園區管理局承租，租賃期間自民國九十年三月十五日起至民國一〇九年十二月三十一日止，且租賃期間屆滿時得另訂新約。自民國一〇二年五月起租金每年約為3,360千元，如遇政府調整地價時，租金亦隨同調整。

(九)員工福利

1.確定福利計畫

本公司確定福利義務現值與計畫資產公允價值之調節如下：

	103.12.31	102.12.31
未提撥義務現值	\$ 106,093	108,330
計畫資產之公允價值	(47,839)	(47,501)
已認列之確定福利義務負債	<u>\$ 58,254</u>	<u>60,829</u>

本公司之確定福利計畫係提撥至台灣銀行之勞工退休準備金專戶。適用勞動基準法之每位員工之退休支付，係依據服務年資所獲得之基數及其退休前六個月之平均薪資計算。

(1)計畫資產組成

本公司依勞動基準法提撥之退休基金係由勞動部勞動基金運用局(以下簡稱勞動基金局)統籌管理，依「勞工退休基金收支保管及運用辦法」規定，基金之運用，其每年決算分配之最低收益，不得低於依當地銀行二年定期存款利率計算之收益。

截至報導日，本公司之台灣銀行勞工退休準備金專戶餘額計47,839千元。勞工退休基金資產運用之資料包括基金收益率以及基金資產配置，請詳勞動基金局網站公布之資訊。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(2)確定福利義務現值之變動

本公司民國一〇三年度及一〇二年度確定福利義務現值變動如下：

	103年度	102年度
1月1日確定福利義務	\$ 108,330	112,743
計畫支付之福利	(3,636)	-
當期服務成本及利息	2,167	1,970
精算利益	(768)	(6,383)
12月31日確定福利義務	<u>\$ 106,093</u>	<u>108,330</u>

(3)計畫資產現值之變動

本公司民國一〇三年度及一〇二年度確定福利計畫資產現值之變動如下：

	103年度	102年度
1月1日計畫資產之公允價值	\$ 47,501	44,043
計畫支付之福利	(3,636)	-
計畫資產預計報酬	979	796
計劃參與者之提撥	2,875	3,029
精算利益(損失)	120	(367)
12月31日計畫資產之公允價值	<u>\$ 47,839</u>	<u>47,501</u>

(4)認列為損益之費用

本公司民國一〇三年度及一〇二年度認列為損益之費用如下：

	103年度	102年度
利息成本	\$ 2,167	1,970
計畫資產預計報酬	(979)	(796)
	<u>\$ 1,188</u>	<u>1,174</u>
計畫資產實際報酬	<u>\$ 1,099</u>	<u>429</u>

(5)認列為其他綜合損益之精算損益

本公司民國一〇三年度及一〇二年度認列為其他綜合損益之精算損益如下：

	103年度	102年度
1月1日累積餘額	\$ (3,214)	2,802
本期認列	(888)	(6,016)
12月31日累積餘額	<u>\$ (4,102)</u>	<u>(3,214)</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(6)精算假設

本公司所使用之主要精算假設如下：

A.用於精算民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日確定福利義務現值者

	103.12.31	102.12.31
折現率	2.10%	2.00%
計畫資產預期報酬率	2.00%	2.00%
未來薪資成長率	2.10%	2.00%

B.用於精算民國一〇三年度及一〇二年度確定福利計畫成本者

	103年度	102年度
折現率	2.00%	1.75%
計畫資產預期報酬率	2.00%	1.75%
未來薪資成長率	2.00%	2.00%

計畫資產預期報酬率係以整體投資組合為基礎，而非加總個別資產類別之報酬。此一報酬率純粹以歷史報酬率為基礎，不作調整。

(7)經驗調整之歷史資訊

	103.12.31	102.12.31	101.12.31	101.1.1
確定福利義務之現值	\$ 106,093	108,330	112,743	122,400
計畫資產之公允價值	(47,839)	(47,501)	(44,043)	(41,908)
確定福利義務淨負債	<u>\$ 58,254</u>	<u>60,829</u>	<u>68,700</u>	<u>80,492</u>
確定福利計畫現值金額之經驗調整	<u>\$ (902)</u>	<u>1,815</u>	<u>811</u>	<u>-</u>
計畫資產公允價值金額之經驗調整	<u>\$ 120</u>	<u>(367)</u>	<u>(310)</u>	<u>-</u>

本公司預計於民國一〇三年度報導日後之一年內支付予確定福利計畫之提撥金額為2,822千元。

(8)計算確定福利義務現值時，本公司必須運用判斷及估計以決定資產負債表日相關精算假設，包含員工離職率及未來薪資變動等。任何精算假設之變動，均可能重大影響本公司確定福利義務之金額。

本公司民國一〇三年十二月三十一日之應計退休金負債之帳面金額為58,254千元，當採用之折現率及未來薪資成長率增減變動1%時，本公司認列之應計退休金負債增減變動如下：

精算假設	應計退休金負債	
	增加1%	減少1%
折現率	<u>\$ (15,107)</u>	<u>18,214</u>
未來薪資成長率	<u>\$ 16,834</u>	<u>(14,357)</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

2.確定提撥計畫

本公司之確定提撥計畫係依勞工退休金條例之規定，依勞工每月工資6%之提繳率，提撥至勞動部勞工保險局(以下簡稱勞工保險局)之勞工退休金個人專戶。在此計畫下本公司提撥固定金額至勞工保險局後，即無支付額外金額之法定或推定義務。本公司民國一〇三年度及一〇二年度確定提撥退休金辦法下之退休金費用分別為18,495千元及18,036千元，已提撥至勞工保險局。

除上，民國一〇三年度及一〇二年度國外分公司依當地相關法令認列之退休金費用分別為734千元及647千元。

(十)所得稅

1.所得稅費用(利益)

本公司民國一〇三年度及一〇二年度費用(利益)明細如下：

	103年度	102年度
當期所得稅費用		
當期產生	\$ 114,359	69,234
調整前期之當期所得稅	9,827	(3,212)
	<u>124,186</u>	<u>66,022</u>
遞延所得稅費用		
暫時性差異之發生及迴轉	11,677	66,804
所得稅費用	<u>\$ 135,863</u>	<u>132,826</u>

本公司民國一〇三年度及一〇二年度認列於其他綜合損益項下之所得稅費用明細如下：

	103年度	102年度
國外營運機構財務報告換算之兌換差額	\$ 6,130	6,324
確定福利計畫之精算利益	151	546
	<u>\$ 6,281</u>	<u>6,870</u>

本公司所得稅費用與稅前淨利之關係調節如下：

	103年度	102年度
稅前淨利	\$ 927,419	877,771
依本公司所在地國內稅率計算之所得稅	157,661	149,221
永久性差異調整	(3,100)	(3,901)
免稅所得	(12,511)	(38,237)
投資抵減預期失效(新增)數	(16,014)	28,952
以前年度所得稅核定及估計差異	9,827	(3,209)
	<u>\$ 135,863</u>	<u>132,826</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

2.遞延所得稅資產及負債變動明細表

遞延所得稅資產

	102.1.1	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	102.12.31	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	103.12.31
存貨跌價損失	\$ 11,900	-	-	11,900	1,020	-	10,880
未實現聯屬公司間利益	10,494	(908)	-	11,402	(3,307)	-	14,709
應計退休金負債	11,204	317	546	10,341	287	151	9,903
投資抵減	56,068	56,068	-	-	-	-	-
其他	1,935	1,090	-	845	(8)	-	853
	<u>\$ 91,601</u>	<u>56,567</u>	<u>546</u>	<u>34,488</u>	<u>(2,008)</u>	<u>151</u>	<u>36,345</u>

遞延所得稅負債

	102.1.1	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	102.12.31	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	103.12.31
國外營運機構財務報告 換算之兌換利益	\$ (1,002)	-	6,324	(7,326)	-	6,130	(13,456)
採權益法認列之國外投 資利益	(37,310)	9,892	-	(47,202)	11,256	-	(58,458)
其他	(110)	345	-	(455)	2,429	-	(2,884)
	<u>\$ (38,422)</u>	<u>10,237</u>	<u>6,324</u>	<u>(54,983)</u>	<u>13,685</u>	<u>6,130</u>	<u>(74,798)</u>

3.本公司營利事業所得稅結算申報已奉稅捐稽徵機關核定至民國一〇〇年度。

4.兩稅合一相關資訊如下：

	103.12.31	102.12.31
屬民國八十七年度以後之未分配盈餘	<u>\$ 794,417</u>	<u>761,084</u>
可扣抵稅額帳戶餘額	<u>\$ 39,969</u>	<u>2,852</u>
	103年度 (預計)	102年度 (實際)
對中華民國居住者盈餘分配之稅額扣抵比率	<u>14.28%</u>	<u>9.40%</u>

5.本公司民國一〇〇年度營利事業所得稅結算申報案件，因對免稅所得之計算與稅捐稽徵機關之見解不同，經核定補徵稅額18,255千元。本公司雖不服稅捐稽徵機關之核定並提出行政救濟申請，惟於所得稅估列時業已考量稅捐稽徵機關核定結果之影響。

(十一)資本及其他權益

1.股本

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日本公司額定股本均為3,000,000千元(均含保留供發行員工認股權憑證200,000千元及可轉換公司債500,000千元之額度)，實收股本分別為2,261,682千元及2,249,412千元，每股面額10元。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司員工於民國一〇二年度行使九十六年發行之員工認股權憑證計2,569,750股，截至民國一〇二年十二月三十一日止，尚有1,227,000股未完成法定登記程序，帳列預收股本40,368千元。前述員工認股權憑證於民國一〇三年間皆已完成法定登記程序。

2. 資本公積

依公司法規定，資本公積需優先填補虧損後，始得以已實現資本公積之全部或一部轉作資本或發放現金。前項所稱之已實現資本公積，包括超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得。依發行人募集與發行有價證券處理準則規定，得撥充資本之資本公積，每年撥充之合計金額，不得超過實收資本額百分之十。

3. 法定盈餘公積

依公司法規定，公司應就稅後純益提撥百分之十為法定盈餘公積，直至與資本總額相等為止。公司無虧損時，得經股東會決議，以法定盈餘公積發給新股或現金，惟以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

4. 特別盈餘公積

本公司於首次採用金管會認可之國際財務報導準則時，因選擇適用國際財務報導準則第一號「首次採用國際財務報導準則」豁免項目，調整帳列股東權益項下之累積換算調整數而增加保留盈餘之金額為18,008千元；另就轉換日之精算損益調整減列保留盈餘13,410千元。依金管會民國一〇一年四月六日金管證發字第1010012865號令規定，應就因轉換採用金管會認可之國際財務報導準則產生之保留盈餘淨增加數4,598千元提列特別盈餘公積，並於使用、處分或重分類相關資產時，得就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉分派盈餘。本公司轉投資之海外子公司盛揚半導體(深圳)有限公司已於民國一〇三年八月完成清算各項權利義務及註銷登記，本公司依據前述函令規定，就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉特別盈餘公積併入保留盈餘計1,956千元。截至民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日止，該項特別盈餘公積餘額分別為2,642千元及4,598千元。

又依上段所述函令規定，本公司於分派可分配盈餘時，就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額與上段所提列特別盈餘公積餘額之差額，自當期損益與前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積；屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積不得分派。嗣後其他股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

5. 盈餘分派

依本公司章程規定，年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：

- (1) 提繳稅捐。
- (2) 彌補虧損。
- (3) 提存百分之十為法定盈餘公積。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(4)依證券交易法提列或迴轉特別盈餘公積。

(5)員工紅利就依一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之十三·五。

(6)董事監察人酬勞就一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之一·五。

(7)扣除前各項餘額後，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派之。

上述股東股利部份，其中現金股利不低於當年度發放股東現金股利及股東股票股利合計數之百分之五十。

本公司依證券主管機關規定於分派盈餘時，應就當年度發生之股東權益減項自可分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，不得分派。嗣後股東權益減項有迴轉時，得就迴轉部分併入可分派盈餘。

本公司以民國一〇三年度及一〇二年度之稅後淨利依本公司章程所定盈餘分派政策，估計員工紅利金額分別為96,174千元及90,511千元，董事監察人酬勞分別為10,686千元及10,057千元，配發股票紅利之股數計算基礎係依據股東會決議前一日之收盤價並考量除權除息之影響。若嗣後股東會決議實際配發金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動，列為下一年度之損益。

本公司民國一〇二年度及一〇一年度盈餘分派案，分別於民國一〇三年六月十一日及一〇二年六月十一日經股東常會決議，分派之每股股利、員工紅利及董事監察人酬勞如下：

	102年度	101年度
普通股每股現金股利(元)	\$ <u>3.3</u>	<u>2.5</u>
員工紅利－現金紅利	\$ 90,511	68,064
董事監察人酬勞	<u>10,057</u>	<u>7,563</u>
	\$ <u>100,568</u>	<u>75,627</u>

上述民國一〇二年度及一〇一年度盈餘分派情形與本公司董事會擬議內容並無差異。

本公司民國一〇三年度盈餘分派案，尚待本公司董事會擬議及股東會決議，相關資訊可俟相關會議召開後至公開資訊觀測站等管道查詢之。

(十二)股份基礎給付

本公司於民國一〇二年度尚在存續期間之員工認股權憑證發行情形彙列如下：

種 類	申報生效日期	給與日	既得期間	給與單位數 (千單位)	每股認購 價格(元)	衡量日每股 市價(元)	調整後履約 價格(元)
96年第一次 員工認股權	96.12.31	96.12.31	4年	4,000	49.45	49.45	32.90

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

上述員工認股權憑證於民國一〇一年一月一日前皆已既得，依國際財務報導準則第一號公報「首次採用國際財務報導準則」之規定，不予追溯重新計算認列酬勞成本。

本公司酬勞性員工認股選擇權計畫相關數量及加權平均行使價格資訊揭露如下：
(以千單位表達)

	102年度	
	加權平均履約價格(元)	認股權數量
1月1日流通在外	\$ 35.40	2,776
本期行使	32.98	(2,570)
本期失效	32.98	(206)
12月31日流通在外		-

(十三)每股盈餘

本公司每股盈餘之計算列示如下：

	103年度	102年度
基本每股盈餘：		
本期淨利	<u>\$ 791,556</u>	<u>744,945</u>
計算每股盈餘之加權平均流通在外股數(千股)	<u>226,168</u>	<u>224,158</u>
基本每股盈餘(元)	<u>\$ 3.50</u>	<u>3.32</u>
稀釋每股盈餘：		
本期淨利	<u>\$ 791,556</u>	<u>744,945</u>
加權平均流通在外股數(千股)	226,168	224,158
具稀釋作用潛在普通股之影響(千股)	<u>2,494</u>	<u>3,175</u>
計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數(千股)	<u>228,662</u>	<u>227,333</u>
稀釋每股盈餘(元)	<u>\$ 3.46</u>	<u>3.28</u>

(十四)營業外收入及支出

綜合損益表所列之其他利益淨額明細如下：

	103年度	102年度
技術支援勞務收入	\$ -	20,614
外幣兌換利淨額	26,939	17,385
其他	<u>1,247</u>	<u>12,054</u>
	<u>\$ 28,186</u>	<u>50,053</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十五)金融工具

1.金融工具之種類

金融資產

	103.12.31	102.12.31
現金及約當現金	\$ 996,708	823,119
應收票據及帳款(含關係人)	644,100	560,556
透過損益按公允價值衡量之金融資產	158,476	263,247
其他金融資產－流動	1,069,281	1,124,943
存出保證金(帳列其他非流動資產)	5,122	4,791
	<u>\$ 2,873,687</u>	<u>2,776,656</u>

金融負債

	103.12.31	102.12.31
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 435,144	428,468
存入保證金	7,597	7,597
	<u>\$ 442,741</u>	<u>436,065</u>

2.信用風險

(1)信用風險之暴險

金融資產之帳面金額代表最大信用暴險金額。民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之最大信用暴險金額分別為2,873,687千元及2,776,656千元。

本公司之潛在信用風險係源自金融資產交易對方或他方未履行合約之潛在影響，主要來自於本公司之現金及約當現金、約定期間三個月以上之定期存款及應收客戶之帳款。

本公司之現金及約當現金及定期存款存放於信用良好之銀行，發生信用風險可能性低。

本公司主要銷售對象為國內外信譽良好之公司，除依授信作業程序給予客戶信用額度外，並持續了解客戶之信用狀況，民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日佔本公司應收票據及帳款(含關係人)10%以上客戶之帳款金額分別為275,477千元及171,986千元，使本公司有應收帳款信用風險集中之情形，惟已定期評估應收帳款之回收可能性並提列適當備抵呆帳，管理當局預期未來不致有重大損失。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(2)減損損失

報導日應收款項之帳齡分析如下：

	103.12.31		102.12.31	
	總額	減損	總額	減損
未逾期	\$ 609,631	-	547,005	-
逾期0~30天	25,155	-	4,391	-
逾期31~120天	16,707	7,393	16,553	7,393
	<u>\$ 651,493</u>	<u>7,393</u>	<u>567,949</u>	<u>7,393</u>

3.流動性風險

下表為金融負債之合約到期日分析：

	帳面金額	合 約 現金流量	1年以內	超過5年
103年12月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 435,144	435,144	435,144	-
存入保證金	7,597	7,597	-	7,597
	<u>\$ 442,741</u>	<u>442,741</u>	<u>435,144</u>	<u>7,597</u>
102年12月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 428,468	428,468	428,468	-
存入保證金	7,597	7,597	-	7,597
	<u>\$ 436,065</u>	<u>436,065</u>	<u>428,468</u>	<u>7,597</u>

本公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

4.匯率風險

(1)匯率風險之暴險

本公司暴露於重大外幣匯率風險之金融資產及負債如下：

	103.12.31			102.12.31			
	外幣	匯率	台幣	外幣	匯率	台幣	
<u>金融資產</u>							
<u>貨幣性項目</u>							
美金	\$	3,521	31.6	111,281	10,879	29.805	324,242
人民幣		111,323	5.067	565,356	56,098	4.919	275,947
<u>非貨幣性項目</u>							
美金	\$	33,395	31.65	1,056,947	34,115	29.805	1,016,792

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

	103.12.31			102.12.31			
	外幣	匯率	台幣	外幣	匯率	台幣	
<u>金融負債</u>							
<u>貨幣性項目</u>							
美 金	\$	4,829	31.65	152,849	5,385	29.805	160,491
人 民 幣		14,389	5.092	73,269	393	4.9190	1,934

(2)敏感性分析

本公司之匯率風險主要來自於以外幣計價之現金、應收帳款及其他應收款及應付帳款等，於換算時產生外幣兌換損益。於民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日當新台幣相對於美金及人民幣貶值或升值1%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一〇三年度及一〇二年度之稅後淨利將分別增加或減少3,739千元及3,647千元。

4.公允價值

(1)公允價值與帳面金額

除詳列於下表者外，本公司之管理階層認為本公司以攤銷後成本衡量之金融資產及金融負債於個體財務報表中之帳面金額趨近於其公允價值：

	103.12.31		102.12.31	
	帳面金額	公允價值	帳面金額	公允價值
<u>金融資產：</u>				
透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$ 158,476	158,476	263,247	263,247

(2)衡量公允價值所採用之評價技術及假設

金融資產如有活絡市場公開報價時，則以此市場價格為公平價值。若無市場價格可供參考時，則採用評價方法估計，所使用之估計與假設係與市場參與者於金融商品訂價時用以作為估計及假設之資訊一致。

(3)公允價值層級

下表按評價方式，分析以公允價值衡量之金融工具，各公允價值層級定義如下：

- A.第一級：相同資產或負債於活絡市場之公開報價(未經調整)。
- B.第二級：除包含於第一級之公開報價外，資產或負債之輸入參數係直接(即價格)或間接(即由價格推導而得)可觀察。
- C.第三級：資產或負債之輸入參數非基於可觀察之市場資料(非可觀察參數)。

	第一級	第二級	第三級	合計
103年12月31日				
透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$ 158,476	-	-	158,476

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

	第一級	第二級	第三級	合 計
102年12月31日				
透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$ 263,247	-	-	263,247

民國一〇三年度及一〇二年度並無任何公允價值層級移轉情形。

(十六)財務風險管理

1.風險管理架構

董事會全權負責發展及控管本公司之風險管理政策。

本公司之風險管理政策之建置係為辨認及分析本公司所面臨之風險，及設定適當風險限額及控制，並監督風險及風險限額之遵循。風險管理政策及系統係定期覆核以反映市場情況及本公司運作之變化。本公司透過訓練、管理準則及作業程序，以發展有紀律且具建設性之控制環境，使所有員工了解其角色及義務。

本公司之董事會監督管理階層如何監控本公司風險管理政策及程序之遵循，及覆核本公司對於所面臨風險之相關風險管理架構之適當性。內部稽核人員協助本公司董事會扮演監督角色。該等人員進行定期及例外覆核風險管理控制及程序，並將覆核結果報告予董事會。

2.信用風險

有關現金及約當現金、應收款項之信用風險分析，請詳附註六(十五)。另，截至民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日止，本公司均無提供任何背書保證。

3.流動性風險

流動性風險係本公司無法交付現金或其他金融資產以清償金融負債，未能履行相關義務之風險。本公司管理流動性之方法係盡可能確保本公司在一般及具壓力之情況下，皆有足夠之流動資金以支應到期之負債，而不致發生不可接受之損失或使本公司之聲譽遭受到損害之風險。

流動性風險係由本公司之財務部門所監控，持續監督本公司實際現金流量部位，並使用多方面的資訊，預測並監控本公司在長期與短期之現金流動部位，財務部門並投資額外之現金於適當到期日之存款或短期性投資，並確保本公司之流動性，足以因應即將到期之負債。截至民國一〇三年十二月三十一日止，本公司之營運資金及目前尚有銀行未動支之借款額度158,250千元，應足以支應履行所有合約義務，故未有無法籌措資金以履行合約義務之流動性風險。

4.市場風險

市場風險係指因市價變動，如匯率、利率、權益工具價格變動，而影響本公司之收益或所持有金融工具價值之風險。市場風險管理之目標係管控市場風險之暴險程度在可承受範圍內，並將投資報酬最佳化。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司為管理市場匯率及權益證券價格變動風險，所有重大交易之執行均經董事會之覆核與核准，相關財務操作亦受內部稽核部門之監督。相關之管理說明如下：

(1)本公司暴露於非以功能性貨幣計價之銷售及採購交易所產生之匯率風險。該等交易主要之計價貨幣有美元及人民幣。

有關外幣計價之貨幣性資產及負債，當發生短期不平衡時，本公司係藉由以即時匯率買進或賣出外幣，以確保淨暴險保持在可接受之水準。

(2)投資組合中重大投資均採個別管理，且所有買賣決策均經董事會之核准。

(十七)資本管理

董事會管理資本之目標係確保本公司於繼續經營與成長之前提下，藉由將債務及權益餘額最適化，以提供股東足夠之報酬。

董事會之資本結構管理策略，係依據本公司所營事業之產業規模、產業未來之成本與產品發展藍圖，以設定本公司適當之市場佔有率，並據以規劃所需之營運資金與現金，以對本公司長期發展所需之各項資產規模，做出整體性之規劃；最後根據本公司產品競爭力推估可能之產品邊際貢獻、營業利益率與現金流量，並考量產業景氣循環波動、產品生命週期等風險因素，以決定本公司適當之資本結構。

董事會定期審核資本結構，並考量不同資本結構可能涉及之成本與風險。

截至民國一〇三年十二月三十一日止，本公司資本管理之方式並未改變。

本公司於報導日之負債權益比率如下：

	103.12.31	102.12.31
負債總額	\$ 937,645	904,759
權益總額	\$ 4,038,632	3,962,762
負債權益比率	23.22%	22.83%

七、關係人交易

(一)母子公司間關係

本公司之子公司明細如下：

	設立地	業主權益(持股%)	
		103.12.31	102.12.31
MCU Holdings Ltd. (MCU)	BVI	100%	100%
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. (Holtek BVI)	BVI	100%	100%
Sigmos Holdings Ltd. (Sigmos)	BVI	100%	100%
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. (Kingtek BVI)	BVI	100%	100%
盛凌投資股份有限公司(盛凌投資)	新竹市	100%	100%

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

	設立地	業主權益(持股%)	
		103.12.31	102.12.31
盛揚半導體(深圳)有限公司(盛揚)(註)	中國深圳市	-	100%
芯群集成電路(廈門)有限公司(芯群)	中國廈門市	100%	100%
合泰半導體(中國)有限公司(合泰)	中國東莞市	100%	100%
Holtek Semiconductor (USA) Inc. (Holtek (USA))	美國加州	100%	100%
金科集成電路(蘇州)有限公司(金科)	中國蘇州市	100%	100%
盛通科技股份有限公司(盛通)	新竹市	100%	-
BestComm RF Electronics Inc. (BestComm)	BVI	100%	-
優方科技股份有限公司(優方)	新北市	54.75%	56%
Best Solution Electronics Inc. (Best Solution)	BVI	54.75%	56%

註：盛揚已於民國一〇三年八月完成清算各項權利義務及註銷登記。

(二)母公司與最終控制者

本公司為本公司及本公司之子公司之最終控制者。

(三)與關係人間之重大交易事項

1.銷售

本公司對關係人之重大銷售金額如下：

	103年度	102年度
子公司	\$ 658,246	439,824
關聯企業	1,774,628	1,923,724
	\$ 2,432,874	2,363,548

本公司之銷售價格依銷售之產品規格而定，並視銷售之數量給予不定幅度之折扣；銷售予關係人之收款條件約為月結60天至90天。本公司與一般客戶之銷售交易收款條件則視個別客戶之交易往來經驗及債信評估結果決定採預收貨款、即期電匯或月結30天至60天不等。

截至民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日止，本公司與採權益法評價之被投資公司間因銷貨交易所產生之未實現銷貨毛利分別為86,125千元及66,882千元，帳列採用權益法之投資項下。

本公司因上述銷貨交易產生之應收關係人款項明細如下：

	103.12.31	102.12.31
子公司	\$ 270,758	127,141
關聯企業	282,964	351,945
	\$ 553,722	479,086

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

2.進貨

本公司向關係人進貨金額如下：

	103年度	102年度
子公司	\$ 7,046	19,899
關聯企業	1,582	-
	<u>\$ 8,628</u>	<u>19,899</u>

本公司與關係人間之進貨交易條件與一般供應商尚無明顯不同。

本公司支付關係人耗材費、雜項購置及委託關係人提供積體電路銷售服務之金額如下：

	103年度	102年度
子公司	\$ 18,751	19,999
關聯企業	3,519	12,419
	<u>\$ 22,270</u>	<u>32,418</u>

本公司因上述進貨及其他交易產生之應付關係人款項如下：

	103.12.31	102.12.31
關聯企業	<u>\$ 5,245</u>	<u>1,934</u>

3.其他交易

(1)截至民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日止，本公司因出售機器設備予金科及芯群所產生之未實現利益分別為399千元及186千元，帳列採權益法之投資項下。

(2)本公司於民國一〇二年度向關係人收取技術支援勞務收入20,614千元，截至民國一〇二年十二月三十一日止，上述款項皆已收回。

(四)主要管理階層人員交易

主要管理階層人員報酬如下：

	103年度	102年度
短期員工福利	\$ 18,909	18,286
退職後福利	432	432
	<u>\$ 19,341</u>	<u>18,718</u>

八、質押之資產

資產名稱	質押擔保標的	103.12.31	102.12.31
定期存款(帳列其他金融資產—流動)	進口關稅保證金	<u>\$ 3,583</u>	<u>3,576</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

- (一)本公司與Dolphin公司及ARM公司等簽有技術授權合約，合約中訂定當本公司銷售之產品若有運用約定技術時，需依雙方議定價格支付權利金。
- (二)德鼎樞紐法律事務所於民國一〇三年五月對本公司提起民事訴訟，請求給付法律服務費用及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年利率百分之五計算之利息。本公司已委任律師處理相關事宜，評估前述事件對本公司目前之營業不致產生重大影響。

十、重大之災害損失：無。

十一、重大之期後事項：無。

十二、其 他

員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總如下：

功 能 別 性 質 別	103年度			102年度		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	25,646	442,226	467,872	22,397	471,342	493,739
勞健保費用	1,965	29,722	31,687	1,739	28,649	30,388
退休金費用	1,229	19,188	20,417	1,134	18,723	19,857
其他員工福利費用	1,120	12,961	14,081	1,016	12,997	14,013
折舊費用	8,265	20,641	28,906	9,742	20,645	30,387
攤銷費用	-	50,226	50,226	-	44,726	44,726

本公司民國一〇三年度及一〇二年度平均員工人數分別為381人及380人。

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

民國一〇三年度本公司依證券發行人財務報告編製準則之規定，應再揭露之重大交易事項相關資訊如下：

- 1.資金貸與他人：無。
- 2.為他人背書保證：無。
- 3.期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資控制部分)：

數量單位：千股(單位)

持有之公司	有價證券 種類及名稱	與有價證券 發行人之關係	帳列科目	期 末				備 註
				股 數	帳面金額	持股比率	公允價值	
本公司	第一金台灣債券基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	4,120	61,863	-	61,863	
本公司	統一強棒基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	5,883	96,613	-	96,613	

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

持有之公司	有價證券 種類及名稱	與有價證券 發行人之關係	帳列科目	期 末				備 註
				股 數	帳面金額	持股比例	公允價值	
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	Unitech Capital Inc.	-	以成本衡量之金融資產	2,500	86,750	5.00%	-	
盛凌投資股份有限公司	瑞永投資股份有限公司	-	以成本衡量之金融資產	23,124	143,000	3.03%	-	

4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：

買、賣 之公司	有價證券 種 類 及 名 稱	帳列 科目	交易 對象	關 係	期 初		買 入		賣 出				期 末	
					單位數	金額	單位數	金額	單位數	售價	帳面 成本	處分 損益	單位數	金額
本公司	統一強棒基金	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	統一投信	-	3,926	63,933	27,503	450,960	25,546	418,826	418,328	498	5,883	96,565 (註)

註：期末金額係取得成本，依市價評價後之帳面金額請詳3。

5. 取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

6. 處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

進(銷)貨 之公司	交易 對象 名稱	關 係	交易情形				交易條件與一般交易 不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進 (銷) 貨	金 額	佔總進 (銷) 貨 之比率	授信 期間	單 價	授信期間	餘 額	佔總應收 (付)票據、帳 款之比率	
本公司	欣宏	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(450,322)	(12)%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	78,910	12%	
欣宏	本公司	對欣宏採權益法評價之投資公司	進貨	450,322	60%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(78,910)	(68)%	
本公司	Holtek BVI	本公司之子公司	銷貨	(374,889)	(10)%	月結90天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	196,567	31%	
Holtek BVI	本公司	Holtek BVI之母公司	進貨	374,889	100%	月結90天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(196,567)	(100)%	
本公司	ForIC	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(204,962)	(6)%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	17,240	3%	
ForIC	本公司	對ForIC採權益法評價之投資公司	進貨	204,962	90%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(17,240)	(30)%	
本公司	Newtek	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(197,704)	(5)%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	33,331	5%	
Newtek	本公司	對Newtek採權益法評價之投資公司	進貨	(197,704)	59%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(33,331)	(54)%	
本公司	Crown Rich	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(184,346)	(5)%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	32,864	5%	
Crown Rich	本公司	對Crown Rich採權益法評價之投資公司	進貨	184,346	54%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(32,864)	(32)%	
本公司	優方	本公司之子公司	銷貨	(154,213)	(4)%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	27,224	4%	
優方	本公司	優方之母公司	進貨	154,213	100%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(27,224)	(100)%	
本公司	鉅威	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(151,349)	(4)%	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	14,953	2%	

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關 係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金 額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間	單 價	授信期間	餘 額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
鈺威	本公司	對鈺威採權益法評價之投資公司	進貨	151,349	12 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(14,953)	(9)%	
本公司	金濟	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(135,992)	(4) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	20,913	3%	
金濟	本公司	對金濟採權益法評價之投資公司	進貨	135,992	84 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(20,913)	(86)%	
本公司	New Wave	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(128,514)	(4) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	24,790	4%	
New Wave	本公司	對New Wave採權益法評價之投資公司	進貨	128,514	61 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(24,790)	(28)%	
本公司	Truetek	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(111,947)	(3) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	19,186	3%	
Truetek	本公司	對Truetek採權益法評價之投資公司	進貨	111,947	3 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(19,186)	(30)%	

8.應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣千元

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關 係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額	提列備抵呆帳金額
					金 額	處理方式		
本公司	Holtek BVI	子公司	196,567	2.70	36,061	即期收款	66,298 (註)	-

註：係截至民國一〇四年一月十三日止收回之金額。

9.從事衍生性商品交易：無。

(二)轉投資事業相關資訊：

民國一〇三年度本公司之轉投資事業資訊如下(不包含大陸被投資公司)：

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
本公司	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	475,831	541,571	15,253	100.00%	496,079	(6,071)	(6,071)	本公司之子公司
本公司	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	69,542	69,542	2,000	100.00%	125,531	3,991	3,991	本公司之子公司
本公司	Sigmos Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	6,898	6,898	200	100.00%	16,193	2,286	2,286	本公司之子公司
Sigmos Holdings Ltd.	Holtek Semiconductor (USA) Inc.	美國加洲	積體電路買賣及技術服務	6,898	6,898	2,000	100.00%	16,193	2,286	註	本公司之孫公司
本公司	MCU Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	74,393	74,393	2,277	100.00%	419,144	66,010	66,010	本公司之子公司
MCU Holdings Ltd.	ForIC Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機零件的技術支持與諮詢服務	9,733	9,733	300	40.00%	29,875	19,821	註	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
ForIC Electronics Holding Ltd.	E-Micro Technology Holding Ltd. (BVI)	B.V.I.	投資海外各項事業	9,473	9,473	300	100.00%	11,305	1,525	註	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Truetek Technology Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	16,306	16,306	920	40.00%	43,519	12,189	註	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

投資公司 名 稱	被投資公司 名 稱	所 在 地 區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
MCU Holdings Ltd.	Quanding Technology Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	1,868	1,868	60	40.00%	10,147	2,893	註	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Innotek Electronics Inc.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	9,411	9,411	320	40.00%	10,143	3,669	註	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Santek Holdings Ltd.	B.V.I.	投資並提供電子元件與單片機蕊片之應用與技術諮詢	3,758	3,758	180	40.00%	11,876	5,458	註	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Bestway Electronic Inc.	B.V.I.	電子零件之銷售及技術服務	3,470	3,470	800	40.00%	18,670	9,698	註	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
Bestway Electronic Inc.	新棠(香港)有限公司	香港	電子零件之銷售及技術服務	8,675	8,675	-	100.00%	13,286	(1,287)	註	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	New Wave Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	24,784	24,784	800	40.00%	46,158	21,463	註	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Newtek Electronics Ltd.	B.V.I.	投資並提供電子元件與單片機蕊片之應用與技術諮詢	8,105	8,105	1,501	40.61%	61,556	20,383	註	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Crown Rich Technology Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	2,641	2,641	80	40.00%	33,917	17,666	註	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	金濤高科有限公司	香港	電子零件之銷售及技術服務	9,907	9,907	-	40.00%	16,459	(2,940)	註	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	泓達科技有限公司	香港	電子零件設計及銷售	5,427	5,427	-	33.00%	6,885	3,568	註	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
本公司	盛凌投資股份有限公司	新竹市	專營投資業務	400,000	400,000	40,000	100.00%	391,413	17,913	17,913 註	本公司之子公司
盛凌投資股份有限公司	欣宏電子股份有限公司	台北市	電子零組件製造/批發/零售	77,035	77,035	6,345	40.00%	97,684	47,998	註	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
欣宏電子股份有限公司	A-ONE WIRELESS TECHNOLOGY CORP.	B.V.I.	電子零組件製造/批發/零售	59,204	59,204	2,000	100.00%	125,671	28,146	註	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
盛凌投資股份有限公司	鉅威股份有限公司	新北市	電子零組件加工製造、買賣進出口	37,500	37,500	5,641	22.39%	63,119	15,986	註	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
盛凌投資股份有限公司	高聖科技股份有限公司	新北市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電信器材批發零售、電腦及其週邊設備製造、資訊軟體服務及國際貿易	2,350	2,350	235	39.17%	-	(167)	註	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
盛凌投資股份有限公司	優方科技股份有限公司	台北市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電腦及其週邊設備製造、資訊軟體服務及國際貿易	16,000	16,000	1,600	54.75%	22,958	15,723	註	本公司之孫公司

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

投資公司 名 稱	被投資公司 名 稱	所 在 地 區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
優方科技股份 有限公司	Best Solution Electronics Inc.	B.V.I.	電子元器件、 電子材料批發	12,279	-	400	100.00%	30,984	12,066	註	本公司之孫公司 投資之子公司
盛凌投資股份 有限公司	金信科技股份 有限公司	新竹市	模具批發、精 密儀器批發、 資訊軟體批 發、電子材料 批發、資訊軟 體零售及電子 材料零售、國 際貿易及資訊 軟體服務業、 資訊處理服務 及產品設計 業、網路認證 服務業	16,452	-	846	32.17%	8,468	(10,534)	註	本公司之子公司 採權益法評價之 被投資公司
金信科技股份 有限公司	Gingy Technology Inc.	B.V.I	模具批發、精 密儀器批發、 資訊軟體批 發、電子材料 批發、資訊軟 體零售及電子 材料零售、國 際貿易及資訊 軟體服務業、 資訊處理服務 及產品設計 業、網路認證 服務業	988	-	2	100.00%	1,072	84	註	本公司之子公司 採權益法評價之 被投資公司轉投 資之子公司
盛凌投資股份 有限公司	天宇微機電股 份有限公司	新竹市	電子零組件製 造、電子材料 批發零售、電 信器材批發零 售、智慧財產 權業、資訊軟 體服務及國際 貿易	10,002	10,002	380	20.00%	-	(1,659)	註	本公司之子公司 採權益法評價之 被投資公司
盛凌投資股份 有限公司	盛通科技股份 有限公司	新竹市	電子零組件製 造、電子材料 批發零售、資 訊軟體服務及 國際貿易	20,000	-	2,000	100.00%	16,775	(3,225)	註	本公司之孫公司
盛通科技股份 有限公司	BestComm RF Electronics Inc.	B.V.I.	電子零組件製 造/批發/零售	8,924	-	18	100.00%	8,069	(855)	註	本公司之孫公司 投資之子公司

註：對各該公司投資損益之認列已分別包含於對子公司或孫公司之投資損益中。

(三)大陸投資資訊：

1.轉投資大陸地區之事業相關資訊：

大陸被投資 公司名稱	主要營業 項目	實 收 資本額	投資 方式	本期末初自 台灣匯出累 積投資金額	本期匯出或 收回投資金額		本期末末自 台灣匯出累 積投資金額	被投資 公司本 期損益	本公司直接 或間接投資 之持股比例	本期認 列投資 損 益	期末投 資帳面 價 值	截至本期 止已匯回 投資收益
					匯出	收回						
盛揚半導體 (深圳)有限公 司	積體電路買賣 及技術服務	65,740	(註1)	65,740	-	65,740	-	700	-	700	-	-
芯群集成電路 (廈門)有限公 司	積體電路買賣 及技術服務	113,551	(註1)	101,027	-	-	101,027	2,697	100%	2,697	120,602	-
合泰半導體 (中國)有限公 司	集成電路、電 子元器件及單 片機晶片之批 發及進出口業 務與諮詢服務 業務	292,423	(註1)	272,221	-	-	272,221	(9,662)	100%	(9,662)	280,245	-
新緯科技(深 圳)有限公司	電子零件銷售 及售後服務	6,769	(註1)	3,383	-	-	3,383	(22)	40%	(8)	11,348	-

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

大陸被投資 公司名稱	主要營業 項目	實收 資本額	投資 方式	本期期初自 台灣匯出累 積投資金額	本期匯出或 收回投資金額		本期期末自 台灣匯出累 積投資金額	被投資 公司本 期損益	本公司直接 或間接投資 之持股比例	本期認 列投資 損 益	期末投 資帳面 價 值	截至本期 止已匯回 投資收益
					匯出	收回						
新禾(廈門)電 子有限公司	電子元器件及 單片機晶片技 術支持與諮詢 服務業務	6,398	(註1)	2,506	-	-	2,506	991	40%	396	13,133	-
諾華達電子 (深圳)有限公 司	電子元器件及 單片機晶片技 術支持與諮詢 服務業務	9,287	(註1)	3,928	-	-	3,928	(342)	40%	(137)	18,478	-
新碩電子科技 (杭州)有限公 司	電子元器件及 單片機晶片技 術研發與諮詢 服務業務	14,727	(註1)	-	-	-	-	946	40%	378	15,103	-
華榮匯電子科 技(北京)有限 公司	電子元器件及 單片機晶片技 術支持與諮詢 服務業務	19,361	(註1)	3,601	-	-	3,601	4,168	40%	1,667	25,240	-
振揚電子(青 島)有限公司	電子元器件及 單片機晶片技 術支持與諮詢 服務業務	6,315	(註1)	2,634	-	-	2,634	367	40%	147	7,222	-
新鼎電子(深 圳)有限公司	電子元器件及 單片機晶片技 術支持與諮詢 服務業務	6,699	(註1)	2,647	-	-	2,647	2,666	40.61%	1,082	3,338	-
信霖電子商貿 (上海)有限公 司	電子元器件及 單片機晶片技 術支持與諮詢 服務業務	30,293	(註1)	3,911	-	-	3,911	727	40%	291	37,683	-
華瑞昇電子 (深圳)有限公 司	電子元器件及 單片機晶片技 術支持與諮詢 服務業務	4,952	(註1)	1,964	-	-	1,964	1,696	40%	678	10,807	-
全鼎電子(蘇 州)有限公司	電子元器件及 單片機晶片技 術支持與諮詢 服務業務	3,736	(註1)	1,600	-	-	1,600	363	40%	145	8,278	-
金科集成電路 (蘇州)有限公 司	電子零件銷售 及售後服務	69,712	(註1)	69,712	-	-	69,712	3,989	100%	3,989	125,490	-

2.轉投資大陸地區限額：

本期期末累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額(註2)	經濟部投審會核准 投資金額(註2、3)	依經濟部投審會規定 赴大陸地區投資限額
471,089 (美金15,111千元)	529,346 (美金16,725千元)	2,423,179 (註4)

註1：透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

註2：累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額係依實際匯出之歷史匯率換算之新台幣金額；經濟部投審會核准投資金額係以資產負債表日匯率換算新台幣金額。

註3：係包括核准自台灣匯出投資金額計476,459千元(美金15,054千元)及第三地區之盈餘轉增資金額計52,887千元(美金1,671千元)。

註4：依「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定，本公司對大陸投資累計金額未超過主管機關所定投資金額或比例上限。淨值4,038,632千元 \times 60%＝2,423,179千元。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

3.重大交易事項：

本公司民國一〇三年度與大陸被投資公司直接或間接之重大交易事項，請詳「重大交易事項相關資訊」之說明。

十四、部門資訊

請詳民國一〇三年度合併財務報告。

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	103.12.31	102.12.31	差 異	
			金額	%
流動資產	3,830,158	3,724,582	105,576	3
長期投資	628,862	599,009	29,853	5
固定資產	487,863	499,508	(11,645)	(2)
其他資產	112,683	106,386	6,297	6
資產總額	5,059,566	4,929,485	130,081	3
流動負債	858,093	830,553	27,540	3
其他負債	143,866	124,564	19,302	15
負債總額	1,001,959	955,117	46,842	5
股本	2,261,682	2,289,780	(28,098)	(1)
資本公積	142,309	114,211	28,098	25
保留盈餘	1,588,979	1,543,041	45,938	3
股東權益總額	4,057,607	3,974,368	83,239	2
重大變動項目說明： <ol style="list-style-type: none"> 1. 其他負債較 103 年度期末增加，主要係遞延所得稅負債增加所致。 2. 資本公積較 103 年度期末增加，主要係執行員工認股權所致。 				

二、財務績效

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

(一) 財務績效比較表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	103 年度	102 年度	增(減)金額	變 動 比 例 %
營業收入淨額	3,930,519	3,894,361	36,158	0.93
營業成本	2,041,772	2,071,023	(29,251)	(1.41)
營業毛利	1,888,747	1,823,338	65,409	3.59
減:未實現銷貨利益之變動	4,815	20,115	(15,300)	(76.00)
已實現營業毛利	1,883,932	1,803,223	80,709	4.48
營業費用	1,066,437	1,047,634	18,803	1.79
營業利益	817,495	755,589	61,906	8.19
營業外收入及利益	121,024	126,443	(5,419)	(4.29)
稅前淨利	938,519	882,032	56,487	6.40
所得稅利益(費用)	(139,935)	(134,232)	(5,703)	4.24
本期淨利	798,584	747,800	50,784	6.79
其他綜合損益(稅後淨額)	30,596	36,453	(5,857)	(16.07)
本期綜合損益總額	<u>829,180</u>	<u>784,253</u>	<u>44,927</u>	<u>5.73</u>
本期淨利歸屬母公司業主	791,556	744,945	46,611	6.26
本期淨利歸屬非控制權益	7,028	2,855	4,173	146.16
綜合損益歸屬母公司業主	822,225	781,291	40,934	5.24
綜合損益歸屬非控制權益	6,955	2,962	3,993	134.81

增減比例變動分析說明：

1. 103 年度聯屬公司間未實現銷貨毛利減少，主要係出貨至轉投資公司，而轉投資公司未出貨至終端客戶之未實現利益減少所致。
2. 103 年度其他綜合損益減少，主要係國外營運機構財務報告換算之兌換差額（稅後淨額）較 102 年度減少所致。

三、現金流量

最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析

(一) 103 年度現金流量變動分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流入量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
1,050,620	979,171	(850,556)	1,179,235	—	—
103 年度現金流量變動情形分析：					
1. 營業活動：係營運持續獲利，致使營業活動淨現金流入。					
2. 投資活動：存放三個月以上定存增加，致產生投資活動淨現金流出。					
3. 融資活動：發放股東現金紅利，致產生融資活動淨現金流出。					

(二) 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流入量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
1,179,235	995,000	(875,000)	1,299,235	—	—
104 年現金流量情形分析：					
1. 營業活動：係預期營運持續成長、獲利增加，致使營業活動淨現金流入。					
2. 融資活動：係預期盈餘分派現金股息紅利增加，致產生融資活動淨現金流出。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一) 重大資本支出之運用情形及資金來源

單位：新台幣仟元

計畫項目	實際或預期之資金來源	實際或預期完工日期	所需資金總額	實際或預定資金運用情形			
				100 年度	101 年度	102 年度	103 年度
固定資產	自有資金	100 年度	125,606	125,606	—	—	—
長期投資	自有資金	100 年度	61,672	61,672	—	—	—
固定資產	自有資金	101 年度	224,965	—	224,965	—	—

(二) 預期可能產生效益：預期可拓展海內外市場業務之發展機會。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

本公司轉投資主要係配合公司營運發展所需，建立完整之銷售及技術服務體系，103年度依權益法認列之投資收益淨額為 57,440 仟元，轉投資狀況請參閱財務報告第 142 頁至第 145 頁附註十三之(二)說明。

- 1.轉投資公司之獲利或虧損主要原因係與營收金額相關，本公司將致力於提昇轉投資公司之營收成長並控制成本費用，以改善其獲利狀況。
- 2.未來之投資計劃仍以業務發展需求考量，於適當時機評估各項投資計畫。

六、風險事項分析：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

- 1.利率：本公司並無因利率變動，而對本公司損益有重大影響情事。本公司約當現金部位主要以投資銀行定存及貨幣型基金為主，往來之金融單位皆是國內外具有一定評比及規模之機構，以獲取穩定、安全之資金投資報酬。
- 2.匯率：為避免因匯率波動對本公司之營收及獲利造成重大影響，本公司除有專責人員每日觀察外匯市場變化及蒐集相關資訊外，並採取下列具體因應措施：
 - (1) 業務單位向客戶報價前，先行對匯率走勢進行審慎評估，並綜合考量影響匯率升貶之各項因素，採取較合理穩健之匯率作為業務報價之基礎，以降低匯率變動對公司營收及獲利之影響。
 - (2) 除與往來銀行與專業金融機構保持密切聯繫，期充分掌握國際匯率之走勢外，內部並定期檢討匯率走勢，針對外幣資金部位規範操作策略，另依避險需求採預售遠期外匯等方式，以降低匯率變動之衝擊。
 - (3) 開立多種外幣帳戶，視實際資金需求或匯率走勢，調節所持之外幣部位，並盡量以同幣別之銷貨收入支應應付帳款，利用自動避險之特性已規避大部分之匯兌風險。

3.通貨膨脹：對本公司損益並無重大影響。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

- 1.本公司最近年度並無從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人及背書保證業務，而若從事之衍生性商品交易，主要係為規避外幣存款、外幣應收及應付帳款匯率波動之變動風險，因係避險性質，並未對公司損益造成重大影響之虞。
- 2.本公司訂有「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」，所有程序均嚴格規範作業程序及風險控管，並責成相關單位依程序規定辦理，並未發生重大虧損之情事。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司以微控制器為產品發展主軸，聚焦在家電產品、醫療保健、安防監控、電腦週邊、工業控制、車用電子、儀表顯示等領域之市場應用，每年以投入約營業額之 15%~20% 作為研發經費，並結合上、中、下游資源進行策略聯盟，以維持公司之產品競爭力。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司對於最近年度國內外重要政策及法律變動皆已採取適當之因應措施，故相關政策及法律變動對於本公司財務及業務並無重大影響。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

面對半導體產業技術不斷提升，本公司除每年投入約營業額的 15%~20% 作為研發經費，更因應 IC 設計產業分工日異明顯之趨勢，專注於微控制器 IC 及微控制器週邊 IC 之產品研發與市場開發，並與上游廠商配合使用先進技術，有充分能力因應科技改變及產業變化，為本公司財務及業務帶來正面挹注。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司秉持穩健經營之企業精神，致力於維持本公司既有之良好企業形象，並且經由嚴格的內部控制及危機管理機制，有效防患於未然，確保企業永續經營。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 本公司自成立以來營運狀況良好，且由於營運規模較大，代工廠會優先提供足夠產能。另為進一步分散進貨風險及在產能、製程技術、品質良率及交期掌握等綜合因素考量下，本公司亦積極尋找不同之代工產能，目前與數家晶圓大廠及封裝測試之代工廠商合作，並無進貨過度集中之情形。
2. 本公司多年來積極開拓市場，客戶群遍佈國內外包含大陸在內之全球各主要市場，充分達到分散風險，避免銷售過度集中之虞。另加強授信管理及要求提供相當之擔保品，持續追蹤帳款收款情形，以期維持穩健的經營結果。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：不適用。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：不適用。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處置情形：不適用。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

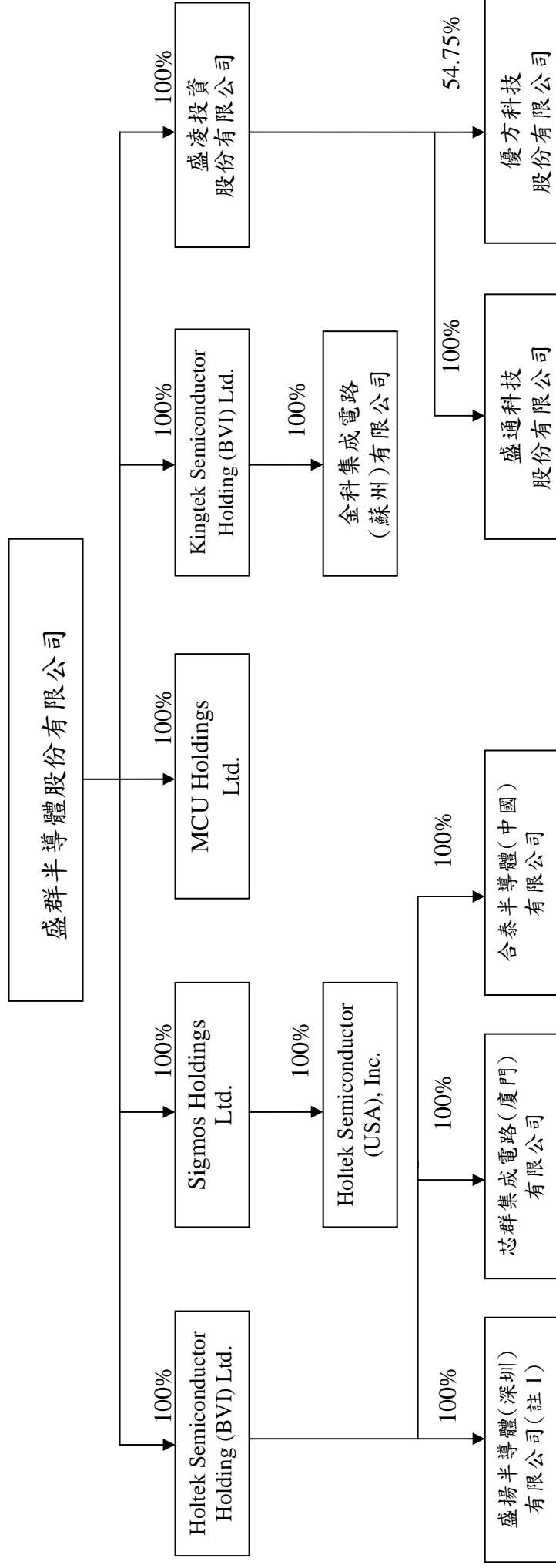
七、其他重要事項：無。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業組織概況

1. 關係企業組織圖



註1：盛揚已於民國一〇三年八月完成清算各項權利義務及註銷登記。

(二)關係企業基本資料

日期：104 年 3 月 31 日

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業項目
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	88.10	TrustNet Chambers P.O. Box 3444 Road Town, Tortola BVI	US\$17,253,360	投資海外各項事業
Sigmos Holdings Ltd.	89.12	TrustNet Chambers P.O. Box 3444 Road Town, Tortola BVI	US\$200,000	投資海外各項事業
盛揚半導體(深圳)有限公司(註 1)	90.03	中國深圳市南山區高新中二道 5 號生產力大樓 A、B 單元五樓 503 室	US\$2,000,000	積體電路買賣及技術服務
Holtek Semiconductor (USA), Inc.	90.05	46729 Fremont Blvd., Fremont CA 94538, USA	US\$200,000	積體電路買賣及技術服務
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	91.01	TrustNet Chambers P.O. Box 3444 Road Town, Tortola BVI	US\$2,000,000	投資海外各項事業
金科集成電路(蘇州)有限公司	91.04	中國蘇州市蘇州工業園區金雞湖大道 1355 號國際科技園 122A 室	US\$2,000,000	積體電路買賣及技術服務
MCU Holdings Ltd.	91.05	TrustNet Chambers P.O. Box 3444 Road Town, Tortola BVI	US\$2,277,440	投資海外各項事業
盛凌投資股份有限公司	92.03	新竹市大同路 136 號 2 樓	NT\$400,000,000	專營投資業務
芯群集成電路(廈門)有限公司	97.02	中國廈門市軟件園二期觀日路 34 號 202 室	US\$3,500,000	單片機芯片及其應用工具的技術服務
優方科技股份有限公司	97.05	臺北市南港區三重里園區街 3-2 號 4 樓之 2	NT\$40,000,000	觸控應用 IC 銷售及設計業務
合泰半導體(中國)有限公司	101.07	中國東莞市松山湖新竹路 4 號新竹苑 10 幢(辦公 101 號房)	US\$9,764,280	積體電路買賣及技術服務
盛通科技股份有限公司	103.01	新竹市大同路 136 號 2 樓	NT\$20,000,000	RF 應用 IC 銷售及設計業務

註 1：盛揚已於民國一〇三年八月完成清算各項權利義務及註銷登記。

(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

(四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

行業別	關係企業名稱	與他關係企業經營業務之關聯
對各種事業之投資	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	投資盛揚半導體(深圳)(註 1)、芯群集成電路(廈門)及合泰半導體(中國)等公司。
	Sigmos Holdings Ltd.	投資 Holtek Semiconductor (USA), Inc.。
	MCU Holdings Ltd.	為本公司投資業務。
	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	投資金科集成電路(蘇州)有限公司。
	盛凌投資股份有限公司	為本公司投資業務。
積體電路之買賣及技術服務	盛揚半導體(深圳)有限公司(註 1)	為本公司推廣產品，建立大陸地區銷售網路及開拓市場，並協助客戶產品之應用及提供產品之售後服務。
	合泰半導體(中國)有限公司	
	Holtek Semiconductor (USA), Inc.	
	金科集成電路(蘇州)有限公司	
單片機芯片及其應用工具的技術服務	芯群集成電路(廈門)有限公司	為本公司推廣 MCU 產品，建立中國地區 MCU 發展工具之銷售網路及開拓市場，並提供相關技術服務。
觸控應用 IC 銷售及設計業務	優方科技股份有限公司	提供本公司觸控方案系列產品，包括標準觸控 IC、微控制器觸控 IC 以及各式高整合 SoC 微控制器觸控 IC。
RF 應用 IC 銷售及設計業務	盛通科技股份有限公司	提供本公司 RF 無線方案系列產品，包括 RF IC 及 RF+MCU 整合型 SoC。

註 1：盛揚已於民國一〇三年八月完成清算各項權利義務及註銷登記。

(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料

日期：104 年 3 月 31 日

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比例
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	董 事	盛群半導體股份有限公司 代表人：吳啟勇	17,253,360	100%
	董 事	盛群半導體股份有限公司 代表人：李佩縈	17,253,360	100%
盛揚半導體(深圳)有限公司(註 1)	董 事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：吳啟勇	--	100%
	董 事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：高國棟	--	100%
	董 事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：鄒平方	--	100%
	總經理	蔡榮宗	--	--
芯群集成電路(廈門)有限公司	董事長	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：吳啟勇	--	100%
	董 事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：高國棟	--	100%
	董 事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：張治	--	100%
	監察人	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：李佩縈	--	100%
	總經理	張家志	--	--
合泰半導體(中國)有限公司	董事長	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：吳啟勇	--	100%
	董 事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：高國棟	--	100%
	董 事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：李佩縈	--	100%
	監察人	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：廖明通	--	100%
	總經理	蔡榮宗	--	--
Sigmos Holdings Ltd.	董 事	盛群半導體股份有限公司 代表人：林正鋒	200,000	100%
	董 事	盛群半導體股份有限公司 代表人：李佩縈	200,000	100%

註 1：盛揚已於民國一〇三年八月完成清算各項權利義務及註銷登記。

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比例
Holtek Semiconductor (USA), Inc.	董 事	Sigmos Holdings Ltd. 代表人：連文德	2,000,000	100%
	總經理	連文德	--	--
MCU Holdings Ltd.	董 事	盛群半導體股份有限公司 代表人：林正鋒	2,277,440	100%
	董 事	盛群半導體股份有限公司 代表人：李佩縈	2,277,440	100%
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	董 事	盛群半導體股份有限公司 代表人：吳啟勇	2,000,000	100%
	董 事	盛群半導體股份有限公司 代表人：高國棟	2,000,000	100%
金科集成電路(蘇州)有限公司	董事長	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：高國棟	--	100%
	董 事	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：張治	--	100%
	董 事	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：李佩縈	--	100%
	總經理	李佩縈	--	--
盛凌投資股份有限公司	董事長	盛群半導體股份有限公司 代表人：吳啟勇	40,000,000	100%
	董 事	盛群半導體股份有限公司 代表人：高國棟	40,000,000	100%
	董 事	盛群半導體股份有限公司 代表人：李佩縈	40,000,000	100%
	監察人	盛群半導體股份有限公司 代表人：李文德	40,000,000	100%
優方科技股份有限公司	董事長	盛凌投資股份有限公司 代表人：吳啟勇	1,600,000	40%
	董 事	盛凌投資股份有限公司 代表人：李佩縈	1,600,000	40%
	董 事	欣宏電子股份有限公司 代表人：林既貴	1,475,000	36.875%
	監察人	新耕投資有限公司 代表人：周玲娜	1,475,000	36.875%
	總經理	樂正平	250,000	6.25%

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比例
盛通科技股份有限公司	董事長	盛凌投資股份有限公司 代表人：吳啟勇	2,000,000	100%
	董 事	盛凌投資股份有限公司 代表人：高國棟	2,000,000	100%
	董 事	盛凌投資股份有限公司 代表人：李佩縈	2,000,000	100%
	監察人	盛凌投資股份有限公司 代表人：李文德	2,000,000	100%
	總經理	李文義	--	--

(六)關係企業營運概況

日期：103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元(除每股損益為新台幣元外)

企業名稱	資本額	資產 總值	負債 總額	淨 值	營業 收入	營業利益 (損失)	本期(損)益 (稅後)	每股(損)益 (稅後)
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	475,831	692,646	196,567	496,079	369,679	(5,313)	(6,071)	(0.40)
盛揚半導體(深圳)有限公司 (註 3)	0	0	0	0	0	(29)	700	註 2
芯群集成電路(廈門)有限公司	113,551	138,706	18,104	120,602	134,673	2,336	2,697	註 2
合泰半導體(中國)有限公司	292,423	504,455	224,210	280,245	450,197	(9,728)	(9,662)	註 2
Sigmos Holdings Ltd.	6,898	16,193	0	16,193	0	0	2,286	11.43
Holtek Semiconductor (USA), Inc.	6,898	26,744	10,551	16,193	63,929	3,355	2,286	1.14
MCU Holdings Ltd.	74,393	419,144	0	419,144	0	(88)	66,010	28.98
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	69,542	125,531	0	125,531	0	0	3,991	2.00
金科集成電路(蘇州)有限公司	69,712	183,774	58,284	125,490	214,209	4,263	3,989	註 2
盛凌投資股份有限公司	400,000	391,433	20	391,413	0	(40)	17,913	0.45
優方科技股份有限公司	40,000	74,710	32,777	41,933	183,068	15,478	15,723	3.93
盛通科技股份有限公司	20,000	17,870	1,095	16,775	1,501	(3,525)	(3,225)	(1.61)

註 1：關係企業如為外國公司，相關數字係以報表日期之兌換匯率換算為新台幣列示，103.12.31 兌換美元 31.65；人民幣 5.092。

註 2：係為有限公司，並未發行股份，故不列示每股損益。

註 3：盛揚已於民國一〇三年八月完成清算各項權利義務及註銷登記。

(七)關係企業合併財務報表：

聲 明 書

本公司民國一〇三年度(自民國一〇三年一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際會計準則第二十七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：盛群半導體股份有限公司



董 事 長：吳 啟 勇



中 華 民 國 一 〇 四 年 一 月 二 十 六 日

(八)關係企業報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

五、依證券交易法第 36 條第三項第二款規定應揭露事項：無。

盛群半導體股份有限公司



負責人： 吳啟勇

